

# 志聖工業股份有限公司

## C SUN MFG. LTD

一一三年



本年報查詢網址：  
公開資訊觀測站 <https://mops.twse.com.tw> ■  
證期局指定之資訊申報網址：同上  
公司網址 <https://www.csun.com.tw>

年報刊印日：中華民國一一四年三月三十一日

**一、本公司發言人 / 代理發言人：**

發言人：吳晏城

職稱：協理

聯絡電話：(02)2601-0700

電子郵件信箱：[jamie@csun.com.tw](mailto:jamie@csun.com.tw)

代理發言人：林彥亨

職稱：特助

聯絡電話：(02)2601-0700

電子郵件信箱：[henrylin@csun.com.tw](mailto:henrylin@csun.com.tw)

**二、總公司、工廠之地址及電話**

總公司：新北市林口區文化二路一段二六六號七樓之一

電話：(02)2601-0700

台北廠：新北市林口區工二工業區工八路二之一號

電話：(02)2601-7706

台中廠：台中市南屯區精科二路 11 號

電話：(04)2359-1651

**三、辦理股票過戶機構：**

名稱：統一綜合證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市東興路八號地下一樓

網址：<https://www.pscnet.com.tw/>

電話：(02)2746-3797

**四、最近年度財務報告會計師：**

會計師姓名：李典易、吳偉豪

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

地址：台北市信義區基隆路一段 333 號 27 樓

網址：<https://www.pwc.tw/>

電話：(02)2729-6666

**五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價**

**證券方式：無**

**六、公司網址：<https://www.csun.con.tw/>**

## 目 錄

<b>壹、致股東報告書</b> .....	<b>1</b>
一、民國 113 年度營業報告 .....	1
二、民國 114 年度營業計劃概要 .....	2
三、未來公司發展策略 .....	4
四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響 .....	4
<b>貳、公司治理報告</b> .....	<b>7</b>
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 .....	7
(一)董事及監察人資料 .....	7
(二)董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露 .....	11
(三)董事及獨立董事進修情形 .....	15
(四)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 .....	17
(五)最近年度支付董事、獨立董事、總經理及副總經理之酬金 .....	19
二、公司治理運作情形 .....	28
(一)董事會運作情形 .....	28
(二)審計委員會運作情形 .....	34
(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 .....	37
(四)公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形 .....	42
(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 .....	45
(六)上市上櫃公司氣候相關資訊 .....	50
(七)公司履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 .....	57
(八)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式 .....	61
(九)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊 .....	61
(十)內部控制制度執行狀況 .....	62
(十一)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議 .....	63
(十二)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者，其主要內容 .....	65
三、簽證會計師公費資訊 .....	65
四、更換會計師資訊 .....	65
五、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間 .....	65
六、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 .....	66
七、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊 .....	66
八、公司、公司董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 .....	67
<b>參、募資情形</b> .....	<b>68</b>
一、公司資本及股份 .....	68
(一)股本與來源 .....	68
(二)資本及股份 .....	70
(三)總括申報制度相關資訊 .....	70
(四)主要股東名單 .....	70
(五)公司股利政策及執行狀況 .....	71
(六)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響 .....	72

(七)員工酬勞及董事酬勞 .....	72
(八)公司買回本公司股份情形 .....	73
<b>二、公司債／特別股／海外存託憑證辦理情形 .....</b>	<b>74</b>
(一)公司債辦理情形 .....	74
(二)特別股／海外存託憑證辦理情形 .....	74
<b>三、員工認股權憑證辦理情形 .....</b>	<b>74</b>
(一)尚未屆期之員工認股權憑證辦理情形及對股東權益之影響 .....	74
(二)取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大且得認購金額達新台幣三千萬元以上員工之姓名、取得及認購情形 .....	74
<b>四、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 73</b>	
(一)最近年度及截至年報刊印日止已完成併購或受讓他公司股份發行新股票者 .....	74
(二)最近年度及截至年報刊印日止已經董事會決議通過併購或受讓他公司股份發行新股票者 .....	74
<b>五、資金運用計畫執行情形 .....</b>	<b>74</b>
(一)計畫內容 .....	74
(二)執行情形 .....	74
 <b>肆、營運概況 .....</b>	<b>75</b>
<b>一、業務內容 .....</b>	<b>75</b>
1.業務範圍 .....	75
2.產業概況 .....	76
3.技術及研發概況 .....	89
4.長、短期業務發展計畫 .....	89
<b>二、市場及產銷概況 .....</b>	<b>91</b>
1.市場分析 .....	91
2.主要產品重要用途及產製過程 .....	103
3.主要原料之供應狀況 .....	105
4.最近二年度任一年度中曾佔進(銷)貨總額百分之十以上之客戶及供應商名稱 .....	105
<b>三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料 .....</b>	<b>106</b>
(一)從業員工結構 .....	106
(二)員工行為或倫理守則 .....	106
(三)工作環境與人身安全的保護措施 .....	106
<b>四、環保支出資訊 .....</b>	<b>113</b>
<b>五、勞資關係 .....</b>	<b>113</b>
<b>六、資通安全管理 .....</b>	<b>116</b>
<b>七、社會責任 .....</b>	<b>119</b>
<b>八、重要契約 .....</b>	<b>125</b>
 <b>伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險管理 .....</b>	<b>126</b>
<b>一、財務狀況比較分析 .....</b>	<b>126</b>
<b>二、經營結果分析 .....</b>	<b>127</b>
<b>三、現金流量 .....</b>	<b>127</b>
<b>四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 .....</b>	<b>128</b>
<b>五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫 .....</b>	<b>128</b>
<b>六、風險管理及評估 .....</b>	<b>128</b>
(一)風險管理之組織架構 .....	128
(二)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施 .....	128
(三)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施 .....	129

(四) 未來研發計畫及預計投入之研發費用 .....	129
(五) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施 .....	129
(六) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施 .....	130
(七) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施 .....	130
(八) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施 .....	130
(九) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施 .....	130
(十) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施 .....	130
(十一) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施 .....	130
(十二) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施 .....	130
(十三) 訴訟或非訴事件處理情形 .....	130
(十四) 資安風險評估分析及其因應措施等重要風險評估之事項 .....	130
(十五) 其他重要風險及因應措施 .....	130
<b>七、其他重要事項 .....</b>	<b>130</b>
<b>陸、特別記載事項 .....</b>	<b>131</b>
一、關係企業相關資料 .....	131
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 .....	131
三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形 .....	131
四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定 對股東權益或證券價格有重大影響事項 .....	131
五、其他必要補充說明事項 .....	131

# 壹、致股東報告書

## 一、民國 113 年度營業報告

各位股東女士、先生 大家好：

首先感謝各位股東長期以來對志聖的支持，為各位股東報告 113 年度營業狀況：

### (一) 營業成果：

單位：新台幣 / 仟元

項目	113 年	112 年	增(減)比例
營業收入淨額	4,818,209	3,625,801	32.9%
營業毛利	1,983,100	1,506,158	31.7%
營業費用	1,347,104	1,103,502	22.1%
營業利益	635,996	402,656	58.0%
營業外收(支)	343,568	181,376	89.4%
稅後淨利	756,575	530,121	42.7%
歸屬於母公司淨利	719,160	486,324	47.9%

### (二) 財務收支及獲利能力的概況：

#### 1. 財務結構：

股東權益與資產比率 = 48.74%

負債與資產比率 = 51.26%

#### 2. 優債能力：

流動比率 = 198.76%

速動比率 = 162.32%

#### 3. 獲利能力：

資產報酬率 = 7.66%

股東權益報酬率 (ROE) = 16.60%

純益率 = 14.93%

每股盈餘 (EPS) = 4.80

### 113 年度研發狀況：

行業別	項目
半導體製程設備	面板級真空加壓烘箱、半導體設備開發專案、PLP 滾輪壓膜模組開發、WTW Bonder 專案、半導體科專計畫
印刷電路板製程設備	RCC 預貼機、高階滾輪壓膜機、ABF 撕膜機、外層撕膜機
前瞻製程與其他電子應用設備	石英震盪器黃光製程設備、面板級電漿去殘膠設備

## 二、民國 114 年度營運計劃概要

### (一) 當年度經營方針

#### 1. 營業方面

- (1) 掌握 2.5D, 3D IC 封裝、FoPLP、Micro LED, 8K4K TV、OLED、LTPS、IGZO 及類載板 HDI/MSAP、RCC 製程、ABF/BT 載板等先進前瞻製程資本支出商機。
- (2) 拓展至泰國、馬來西亞、新加坡、印度、美國及日本市場。
2. 關注節能環保與循環經濟的訴求：加強烤箱及各機種的節能，並於營運上節能再利用及促進環保永續。
3. 研發方面：增加內部核心技術與交流，強化與外部策略夥伴的研發與市場合作關係，使產品組合更加完整。

114 年度計劃開發之產品技術：

行業別	項目
半導體製程設備	面板級高精度熱板烘箱、面板級真空加壓烘箱、Panel bonder/anneal 模組開發、Panel 半導體真空壓膜 / 滾輪壓膜模組開發
印刷電路板製程設備	RCC 預貼機、高階滾輪壓膜機、ABF 撕膜機、外層撕膜機
前瞻製程與其他電子應用設備	面板級 ICP 電漿蝕刻設備

#### 4. 管理方面

##### (1) 組織

建立以產業別及核心技術為基礎之營運中心組織結構。  
各營運中心以相關核心技術為基礎，發揮製程專業優勢，同時在集團管理平台上發展跨產業整合創新研發機制及發揮通路的規模優勢。

##### (2) 人才培育

引進優秀人才、國際級產學合作及外界顧問，高階主管擔任內部講師並配合問題分析與結論系統 (PAC, Problem Analysis & Conclusions) 及基層作業須知系統 (YSK, You Should Know)、內部知識管理系統及數位化轉型管理，系統性的循序培育核心技術研發團隊及具管理能力及整合能力的複合型 PARPRO (專業夥伴)，進而有機延展 志聖成為具核心競爭力學習型組織。

##### (3) 資產管理

強化現金流量及水位之風險控管；加強應收帳款及新舊呆滯品的去化。

##### (4) 生產管理

提昇品管系統由 QC 至 QA 至品質保證，引進問題分析與結

論系統 (PAC，Problem Analysis & Conclusions) 及基層作業須知系統 (YSK，You Should Know)，全面提昇產品可靠度。快速反應市場之需求，兩岸有效分工，精實營運，注入永續發展概念及企業社會責任的實踐。

## (二) 預期銷售數量及其依據：

單位：台

行業別	數量
半導體製程設備	177
印刷電路板製程設備	306
前瞻製程與其他電子應用設備	775
合計	1,258

註：參酌目前已接訂單、生產排程、出貨日期及產業景氣等因素所編製。

## (三) 重要產銷政策

為了更佳滿足半導體先進封裝製程與未來 AI 晶片的需求趨勢，同時考慮到廣州與昆山廠在其他產業製程設備的規劃，我們將進行以下產銷政策的定位：

1. 針對性生產分工與彈性應變：台灣林口與台中廠將擴充發展半導體先進封裝製程與未來 AI 晶片的生產設備和產能準備，以滿足高端半導體市場的需求。同時，廣州與昆山廠將著重於服務於 PCB、FPD、Touch Panel、LED 等其他電子產業的製程技術與設備開發，確保各基地根據市場需求與經濟局勢靈活調整產能和技術方向。
2. 全方位解決方案提供者：強化台灣林口與台中廠在提供整合材料、設備及製程技術的 Total Solution 方面的能力，專注於滿足前瞻製程和 AI 晶片製造相關設備的特殊需求。廣州與昆山廠則將持續提升在其他電子製程技術方面的整合與創新能力。
3. 區域領導地位的鞏固與拓展：台灣林口與台中廠將致力於成為半導體先進封裝製程設備的領導者，而廣州與昆山廠則專注於鞏固和拓展在大中華區其他 PCB、電子產業光熱製程設備的市場領先地位。
4. 高效能、高節能、高精度的生產解決方案：台灣林口與台中廠將開發專為半導體先進封裝、IC 載板與 HBM 高效能、高節能、高精度生產技術和設備。
5. 積極參與創新與可持續發展：所有基地將積極切入智動化、節能再利用與環保永續技術的研發和應用，各廠區探索和實踐更多創新技術與環保解決方案，引領產業向著更高效、更綠色的未來發展。

透過這些策略性的調整，我們旨在更精確地滿足半導體先進封裝設備市場需求，加強技術創新，並在全球半導體及電子產業設備中積極佔據領導地位，推動公司的長期發展和行業進步。

### 三、未來公司發展策略

秉持著公司一貫的經營理念，我們專注於提供壓合（Bonding）、貼合（Lamination）、撕離（Peeling）、熱處理（Thermal）、紫外線（UV）、濕式加工（Wet Process）及電漿（Plasma）技術等設備。隨著AI技術及其應用，如雲端計算伺服器、大數據分析、AI模型的訓練與推理、自動駕駛等領域展現出巨大的成長潛力，半導體先進封裝技術—特別是利用2.5D/3D晶片堆疊技術—已成為滿足這些需求的關鍵。這些技術通過將多種晶片整合封裝到一個基板上，不僅縮小了晶片之間的線路間距，還實現了更小的尺寸、更低的功耗、成本節省及性能提升等優勢。

作為全球半導體領域領先廠商的重要設備供應商，我們計劃將創新技術應用到這些先進封裝領域中，以支持AI技術的迅速發展和新興需求，並與G2C+策略夥伴技術與市場連結，將過去幾十年來累積的設備核心技術，作為營運上堅實的基礎，將創新技術延伸應用到其他產業，擴大營業與海外觸角，期望深化並擴展核心技術及智動化AI，提供客戶更完整全面的產品及服務。

### 四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

#### （一）外部競爭環境：

外部競爭環境顯示，我們的TFT LCD/Touch Panel製程設備，在兩岸市場已有顯著實績，且正向著AR/VR，車載應用、MicroLED與FoPLP製程領域積極轉型。

我們是目前唯一能夠提供大尺寸TFT前段製程—多層爐設備的廠商，這不僅凸顯了我們的市場獨特性，也為我們在未來的技術革新與市場拓展上提供了堅實的基礎。隨著半導體行業的不斷進步，台灣在先進封裝技術方面的領先地位尤為關鍵，尤其在CoWoS（晶片上晶片）和HBM（高頻寬記憶體）等領域。

這些技術為AI、大數據、高性能計算等前沿應用提供了強大的支持。做為這一進程的核心參與者，我們公司在印刷電路板ABF/BT載板製程的壓膜機與剝膜機、IC封裝烤箱等關鍵設備方面已經取得了全球領導地位。在持續的技術創新引領下，我們計畫在台灣、東南亞及歐美日市場進一步深耕，特別是在CoWoS與HBM等先進封裝技術領域，我們將持續加強研發投入，並與G2C+合作夥伴攜手，共同推動半導體行業向更高效、更環保、更創新的方向發展。

隨著全球對高性能計算能力需求的不斷提高，我們相信，透過不斷的技術創新與市場策略調整，我們將能夠在激烈的全球競爭中保持領先，為全球領先客戶提供更多元、更高質的產品與服務，共同開創IC載板、半導體先進封裝與HBM記憶體產業的新未來。

(二) 法規環境：

志聖本著合法經營、善盡社會責任為主，對於法規環境的變化也因專業經理人的應變及法律專家的諮詢而得以合法遵循。

(三) 總體經營環境：

志聖經營設備產業面廣泛，橫跨 PCB、FPD、Touch Panel、SEMI、PV、Printing & Coating 等產業。隨著客戶策略的變動更突顯核心競爭力的重要。

2024 年是志聖工業（2467）在半導體先進封裝領域大放光芒的一年。在 2023 年 ChatGpt 進入全球視野之後，AI 基礎建設開始加速，我們也藉由持續在先進封裝製程中耕耘多年的壓合、貼膜、烘烤技術得到客戶的認同，也在 2023 年 12 月 7 日獲得台積電頒發的量產支援獎，這是 10 年來第一次有台灣設備商獲此殊榮。我們更在 2024 年在務獲得台積電頒發精進獎。也是至今為止唯一連續兩年獲獎的台灣設備商。相信在 2025 年也會看到持續擴大半導體營收占比。

志聖跨足 PCB、FPD、SEMI、電子應用等四大產業，2024 年因受全球景氣影響，FPD 產業呈現退狀況。PCB 產業歷經多年快速擴產 IC 載板，載板擴廠減緩，但受 china+1 的議題影響，PCB 產業有產地移轉的動作，志聖也在 2024 年於泰國設立子公司，掌握到市場轉移的商機，讓 PCB 營收不受影響。

2024 AI 一枝獨秀，重要客戶快速擴產加上我們是先進封裝的主要設備商，半導體產業佔營收比相較 2023 年成長一倍，達到 35% 的營收占比。

展望 2025 年，AI 軍備競賽維持持續擴充的方向，G2C+ 聯盟的綜效將持續擴大，除了既有 CoWoS 製程外持續受惠於客戶擴產外，oS 製程從 tsmc 外溢到 OSAT 客戶端。志聖也是 OSAT 的重要合作夥伴，預期會有耕耘多年的新站點設備產生效益。相信 25 年也是倍增半導體設備的營收比重，配合 ESG 與 AI 趨勢開拓新行業與新應用；

志聖也在 2025 年轉投資樂林科技，藉由樂林擴展台日代理事業，期待未來新的事業模式可以創造更多營收。

落實「合力共創、同行致遠」的精神，為顧客、股東及員工創造更大的價值，同時善盡企業社會責任。

最後 敬祝各位股東女士、先生

身體健康 萬事如意

董事長 梁茂生



## 貳、公司治理報告

### 一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

(一) 董事及監察人資料：

職稱 國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選任日期	任期 日期	初次選任 日期	選任時 持有股分 (註2)	現在持有股數 (註2)	配偶、未成年子女 現在持有股份 比率	利用他人名義 持有股份 比率	主要經營(學)歷	目前兼任 本公司及其他公司 之職務	具配偶或 二親等以 內關係 之其他主 管、董事人 或監察人 關係	職稱 姓名	
董事長 中華民國	梁茂生	男 77	67.4.18	3,963,215	2.60%	2,377,866	1.52%	3,46,222	0.22%	—	台灣大學化工系學士 政大企業家班第七期 結業 電子設備協會(TEEA) 副理事長 台日產業技術合作促進會(TICCT)監事 電路板環境公益基金 會(TPCF)副董事長 台灣顯示產業總會 (TDUA)理事	本公司執行長 擎邦國際科技工 程(股)公司獨 立董事 會(TPCF)副董事 長 台灣顯示產業總會 (TDUA)理事	梁茂忠 兄弟 註1、 2	梁茂忠 兄弟 註2
副董事長 中華民國	梁茂忠	男 72	67.4.18	2,410,045	1.58%	3,192,949	2.04%	1,137,260	0.73%	—	成洲園中 廣州花都台商協會榮 譽會長 廣東省海峽兩岸交流 促進會副會長	本公司副執行長 志聖科技(廣州) 有限公司董事長	梁茂生 兄弟 註2	
董事 中華民國	沈顯和	男 71	108.6.13	—	—	—	—	—	—	—	台灣表面黏著科 技(股)公司董 事 士	臺灣表面黏著科 技(股)公司董 事 士	—	
董事 中華民國										皇威科技(股) 組營資材(股)公司模 具總經理 聯華電子(股)公司資 本部經理 / 廉長 蔭天科技(股) 獨立董事	皇威科技(股) 公司監察人 富采投資控股 (股)公司獨立 董事 / 新酬委員 會委員 蔭天科技(股)	—		

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	年齡	任期	初次選任日期	選任時 持有股份 (註2)	現在持有股數 (註2)	配偶、未成年子女現在持有股份	利用他人名義 持有股份	主要經(學)歷	目前兼任 本公司及 其他公司 之職務	備註			
													職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	陳政興	男	60	111.3.9	108.6.13	15,301	0.01%	15,760	0.01%	—	無	中山大學機械所碩士 華映精機廠設計處處長 均豪精密工業（股）公司副總經理 均華工業（股）公司法人董事代表人	Gallani-Rapid Corporation Limited C. Corporation Limited 均豪精密工業（股）公司副總經理 均華工業（股）公司法人董事代表人	—	—
董事	中華民國	楊賢增	男	69	111.6.9	111.6.9	—	—	—	—	—	—	日本國立愛媛大學法 學碩士 微端科技（股）董事 臺灣電路板協會 電路板環境公益基金 會(TPCA)監事 臺灣電路板協會 電路板環境公益基金 會(TPCA)監察人	—	—	—

國籍 或註冊地 址	職稱 姓名	性別 年齡	選任日期	任期	初次選任日期	選任時 持有股份 (註2)	現在持有股數 (註2)	配偶、未成年子女現在持有股份			利用他人名義 持有股份	目前兼任 本公司及 其他公司 之職務	主要經（學）歷	具配偶或 二親等以 內關係 之其他主 管、董事 或監察人	備注		
								股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	職稱	姓名	關係	
獨立董事	中華民國 林明杰	男 75	111.3 年	105.6.14	32,343	0.02%	33,313	0.02%	—	—	無	—	國立政治大學企研所 博士	群光電子(股)公司 獨立董事 / 審計委員 財團法人金融聯合徵信中心董事 財團法人證券櫃台買賣中心監察人 國立中央大學企管系 教授	—	—	—
獨立董事	中華民國 未知遠	男 77	111.6.9	105.6.14	—	—	—	—	—	—	無	—	中原大學 EMBA 結業 台達電子工業(股) 公司資深副總裁暨總 財務長	—	—	—	
獨立董事	中華民國 林書賢	男 55	111.6.9	108.6.13	—	—	—	—	—	—	無	—	淡江大學化 工系失傳系統(股)公 司董事 捷科技(股)公司 法人代表董事 達創業投資(股)公 司董事 上海公司董事 東玲冷凍(股)公司 董事	—	—	—	
獨立董事	中華民國 鄭嘉峻 (註5)	男 59	111.6.9	111.6.9	—	—	—	—	—	—	無	—	由甲新技(股)公司 董事長 UTECHZONE GLOBAL CORP.董 事會 EVISION GLOBAL(SAMOA) CO.,LTD.董事 科士凱亞(股)公司 董事長	—	—	—	

職稱 或註冊地	姓名	性別 年齡	選任 日期	初次選 任日期	選任時 持有股份 (註 2)	現在持有股數 (註 2)	配偶、未成年子 女現在持有股份			利用他人名義 持有股份	主要經（學）歷	目前兼任 本公司及 其他公司 之職務	具配偶或 二親等以 內關係 之其他主 管、董事 或監察人 備註	
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率		

※法人股東之主要股東：無。

註 1：董事長與總經理或相當等級者（最高經理人）為同一人，五為配偶或一親等關係屬時，應說明其原因、合理性、必要性及未來改善措施（例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式）之相關資訊；本公司董事長與總經理互為一親等，係為提升經營效率與決策執行力，惟為強化董事會之獨立性；此外，董事長及總經理平時亦密切與各董事充分溝通公司營運近況與計劃方針以落實公司治理。目前本公司已有下列具體措施：

1. 現任三席獨立董事分別在產業領域學有專精，能有效發揮其監督職能。
  2. 每年度安排各董事參加外部機構委員會，以增進董事會之運作效能。
  3. 獨立董事在各功能性委員會皆可充分討論並提出建議供董事會參考，以落實公司治理。
  4. 董事會成員中過半數董事並未兼任員工或經理人。
- 註 2：梁茂生董事長 2,200,000 股、梁茂忠副董事長、梁茂生、梁茂忠、沈顯和、陳政興、楊賢增、朱知遠、林明杰、林書賢及鄧嘉駿 111/6/9 選任生效。
- 註 3：本公司於 111/6/9 董事改選；新任董事梁茂生、梁茂忠、沈顯和、陳政興、楊賢增已於民國 112 年 12 月 4 日辭任。
- 註 4：董事楊賢增已於民國 113 年 11 月 4 日辭任。
- 註 5：獨立董事鄧嘉駿已於民國 113 年 11 月 4 日辭任。

(二) 董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

1. 董事及監察人專業資格

	專業資格 與經驗 (註 1)	獨立性情形 (註 2)	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
梁茂生 梁茂忠 沈顯和 陳政興 楊賢增 (註 3)	董事專業資格與經驗 請參閱本年報「參、 二、(一) 董事及監 察人資料」(第 10-12 頁)	不適用	1 - 2 1 -
林明杰 朱知遠 林書賢 鄒嘉駿 (註 4)	所有董事皆未有公司 法第三十條各款情事 (註 1)	所有獨立董事皆符合下述情形： 1. 符合金融監督管理委員會頒訂之證券交 易法第十四條之二暨「公開發行公司獨立 董事設置及應遵循事項辦法」(註 2)相關 規定 2. 本人(或利用他人名義)、配偶及未成 年子女無持有公司股份 3. 最近二年無提供本公司或其關係企業商 務、法務、財務、會計等服務所取得之報 酬金額	2 - - -

註 1：有下列情事之一者，不得充任經理人，其已充任者，當然解任：

1. 曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾五年。
2. 曾犯詐欺、背信、侵占罪經宣告有期徒刑一年以上之刑確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年。
3. 曾犯貪污治罪條例之罪，經判決有罪確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年者。
4. 受破產之宣告或經法院裁定開始清算程序，尚未復權者。
5. 使用票據經拒絕往來尚未期滿者。
6. 無行為能力或限制行為能力者。
7. 受輔助宣告尚未撤銷。

註 2：

1. 非公司法第二十七條規定之政府、法人或其代表人。
2. 兼任其他公開發行公司之獨立董事，未逾三家。
3. 選任前二年及任職期間無下列情事之一：
  - (1) 公司或其關係企業之受僱人。
  - (2) 公司或其關係企業之董事、監察人。
  - (3) 本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1% 以上或持股前十名之自然人股東。
  - (4)(1) 所列之經理人或(2)、(3) 所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
  - (5) 直接持有公司已發行股份總數 5% 以上、持股市前五名或依公司法第二十七條指派代表人擔任公司董事之法人股東之董事、監察人或受僱人。
  - (6) 與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。

- (7) 與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。
- (8) 與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東。
- (9) 為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新台幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但擔任本公司薪酬委員會成員者，不在此限。

註3：董事楊賢增已於民國112年12月4日辭任。

註4：獨立董事鄒嘉駿已於民國113年11月4日辭任。

## 2. 董事會多元化及獨立性：

- (1) 本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。
- (2) 本公司持續進行之董事繼任計畫，依以下標準建置董事人選資料庫：
  - I. 誠信、負責、創新並具決策力，與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。
  - II. 具有與本公司所營業務相關的產業經驗。
  - III. 預期該成員之加入，能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。並積極遴選1席女性董事，及整體董事會專長面向需包含企業策略、會計與稅務、財務金融、法律、行政管理及生產管理。本公司訂定董事候選人名單之甄選過程皆需符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。
- (3) 落實定期委託外部專業獨立機構進行董事會績效評估，本公司於2024年委託臺灣誠正經營學會，提供外部專業評估報告，反饋改善建議，作為後續遴選成員參考。
- (4) 本公司訂定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括董事會議運作效率、內部關係經營與溝通、成員組成及能力、董事自評等，以確認董事會有效運作，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。

## 董事會成員多元化政策：

- 1. 本公司依據所制定之【公司治理實務守則】第三章第二十條所示強化董事會職能規範，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，其包括但不限於以下二大面向之標準：
  - (1) 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
  - (2) 專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
- 2. 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體須具備之能力如下：
  - (1) 營運判斷能力。
  - (2) 會計及財務分析能力。
  - (3) 經營管理能力。

- (4) 危機處理能力。
- (5) 產業知識。
- (6) 國際市場觀。
- (7) 決策能力。

#### **董事會成員多元化具體管理目標：**

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層，對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。具體管理目標如下：

1. 本公司董事會亦注重成員性別平等，董事成員至少應包含一位女性董事。
2. 本公司董事會著重於營運判斷、經營管理及危機處理能力，應有 2/3 以上董事成員具備相關核心項目之能力。
3. 獨立董事不得連任超過 3 屆，以保持其獨立性。
4. 董事成員中，具本公司、母、子或兄弟公司員工身分之人數，應低於（含）董事席次 1/3，以達監督目的。

#### **董事會成員多元化達成情形：**

為強化公司治理並促進董事會組織之健全，本公司董事成員考量多元化，並就營運型態及發展需求，遵行以適當多元方針選任董事成員。公司董事成員均具備執行業務所必須之知識、技能、素養及產業決策與管理等各項能力，本公司亦持續為董事成員安排多元的進修課程，俾提升其決策品質、善盡督導責任，進而強化董事會職能。

本公司現任董事成員共 7 位，其中包含獨立董事 3 席，占比為 42.9%，3 位獨立董事任期皆未連任超過 3 屆以上，以確保董事會之獨立性；兼任員工身分有 2 位，占比為 28.6%。

本公司董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施：

1. 原因說明：本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以不同性別董事至少 1 席為目標，目前董事會成員男性占 100%(7 位)，尚無女性董事之選任，係因產業特性，短時間尋求人才不易。
2. 採行措施：俟董事會屆滿進行改選時，尋求產業或學校等多方管道人才舉薦增加女性董事席次，預計在未來增加 1~2 名女性董事，並以不同性別董事席次至三分之一以上為目標，以利提升公司治理效能並落實董事成員多元化政策。

目前本公司董事會七位成員具備多元背景，包括不同產業、學術及法律等專業背景。董事會成員多元化政策落實情形如下表：

董事會成員多元化政策落實情形									
職稱	董事長	副董事長	董事	董事	董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事
姓名	梁茂生	梁茂忠	沈顯和	陳政興	楊賢增 (註1)	林明杰	朱知遠	林書賢	鄒嘉駿 (註2)
年齡 70 以上	V	V				V	V		
年齡 55~70			V	V	V				V
年齡 55 以下								V	
兼任 本公司員工	V	V							
專業知識及才能									
商務	V	V	V	V	V	V	V	V	V
科技	V	V	V	V	V	V	V	V	V
財務 / 會計							V		
行銷	V	V	V	V	V				
能力與經驗									
領導力	V	V	V	V	V	V	V	V	V
決策力	V	V	V	V	V	V	V	V	V
國際觀	V	V	V	V	V	V	V	V	V
產業知識	V	V	V	V	V	V	V	V	V
財務管理 能力	V		V				V		
營運及製造	V	V	V	V	V	V		V	V
業務開發	V	V	V	V	V	V	V	V	V
風險管理 / 危機處理	V	V	V	V	V	V	V	V	V
環境永續	V	V							
社會參與	V	V	V	V	V				V

註 1：董事楊賢增已於民國 112 年 12 月 4 日辭任。

註 2：獨立董事鄒嘉駿已於民國 113 年 11 月 4 日辭任。

(三) 董事及獨立董事進修情形

職稱	姓名	起	迄	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事 梁茂生		113/11/04	113/11/04	社團法人中華 公司治理協會	企業永續經營不二法門 - 外部創新	3	
		113/10/31	113/10/31	社團法人中華 公司治理協會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3	
		113/05/06	113/05/06	社團法人中華 公司治理協會	AI 之應用、法律與稽核	3	
董事 陳政興		113/10/31	113/10/31	社團法人中華 公司治理協會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3	
		113/06/19	113/06/19	社團法人台 灣董事學會	全球競局勢下發掘台灣企業國際競爭力	3	
		113/05/02	113/05/02	社團法人台 灣董事學會	如何透過策略併購實現企業成長	3	
董事 沈顯和		113/03/08	113/03/08	社團法人台灣 數位治理協會	2024 董事會運作趨勢及策略	3	
		113/11/06	113/11/06	財團法人中華民國證券 暨期貨市場發展基金會	議題管理在公司治理中應有的策略思維	3	
		113/10/31	113/10/31	社團法人中華 公司治理協會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3	

職稱	姓名	進修日期 起	進修日期 迄	主辦單位	課程名稱	進修時數
獨立董事 林書賢	113/10/31	113/10/31	社團法人中華 公司治理協會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3	
	113/05/22	113/05/22	社團法人中華 公司治理協會	共建綠色生態系的趨勢與願景 - 碳交易業務 與展望	3	
	113/05/14	113/05/14	社團法人中華 公司治理協會	再生能源憑證制度及綠電交易解析	3	
獨立董事 林明杰	113/10/31	113/10/31	社團法人中華 公司治理協會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3	
	113/08/07	113/08/07	社團法人中華 公司治理協會	資訊安全治理的趨勢與挑戰（上）	3	
	113/08/07	113/08/07	社團法人中華 公司治理協會	資訊安全治理的趨勢與挑戰（下）	3	
獨立董事 朱知遠	113/12/10	113/12/10	社團法人中華 公司治理協會	非合意併購之攻防策略與相關公司治理議題	3	
	113/10/31	113/10/31	社團法人中華 公司治理協會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3	
獨立董事 鄒嘉駿	113/07/03	113/07/03	台灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	

註：係指符合『上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點』所規定之進修時數、進修範圍、進修體系、進修之安排與資訊揭露

(四) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份(註1)		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份持股比率	主要經營(學)歷(註2)	目前兼任其他公司之職務	本公司董事長 擎邦國際科技股份有限公司 獨立董事	副執行長	梁茂忠	兄弟關係	備註
					股數	持股比率	股數	持股比率								
執行長	中華民國	梁茂生	男	96.06.15	2,377,866	1.52%	346,222	0.22%	無	—	台灣大學化系畢業 政大企系班 第七期結業	本公司董事長 擎邦國際科技股份有限公司 獨立董事	副執行長	梁茂忠	兄弟	
副執行長	中華民國	梁茂忠	男	96.06.15	3,192,949	2.04%	1,137,260	0.73%	無	—	成測國中畢 廣州花都台商協會會長	本公司副董事長	執行長	梁茂生	兄弟	
總經理	中華民國	梁又文	男	111.06.17	1,922,647	1.23%	—	—	無	均華精密工業 暨執行長 祁昌(股)公司 均華精密工業股 份有限公司 董事代表人 創峰光電科技(股)公司 董事長 蘇州創峰光電 董事長 程培業 視動自動化科技(股) 南通創業投資(股)公司 董事 廣信創業投資(股)公司 董事 精密工業(股)公司 監察人 捷科技(股)公司 獨立董事 樂林科技(股)公司 董事長 志聖 工業(股)公司 董事 均華精密工業(股)公司 副董事 長暨執行長	均華精密工業(股)公司 董事長 祁昌(股)公司 均華精密工業股 份有限公司 董事代表人 創峰光電科技(股)公司 董事長 蘇州創峰光電 董事長 程培業 視動自動化科技(股) 南通創業投資(股)公司 董事 廣信創業投資(股)公司 董事 精密工業(股)公司 監察人 捷科技(股)公司 獨立董事 樂林科技(股)公司 董事長 志聖 工業(股)公司 董事 均華精密工業(股)公司 副董事 長暨執行長	執行長	梁茂生	父子	於 111/06 就任	

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份(註1)		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經營(學)歷 (註2)	目前兼任其他 公司之職務	具配偶或二親等 以內關係之經理 人	備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率				
副總經理	中華民國	汪建宏	男	109.08.01	75,036	0.05%	664	0.00%	無	—	黎明技術學院 / 機械工程	志聖科技(廣州)有限公司董事長	無	無
協理	中華民國	袁開春	男	107.10.05	11,121	0.01%	—	—	無	—	彰化師範大學 / 機電與系統管理	無	無	無
協理	中華民國	吳晏城	男	107.10.05	62,709	0.04%	—	—	無	—	逢甲大學 / 工業工程	無	無	無
協理	中華民國	童寶烽	男	110.01.21	92,777	0.06%	—	—	無	—	東海大學 / 企業管理	無	無	無

註 1：梁茂生董事長 2,200,000 股、梁茂忠副董事長 4,100,000 股係信託股票，屬於「保留運用決定權之交付信託股份」。

註 2：應包括總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資深，以及凡職位相當於總經理、副總經理或協理者，不論職稱，亦均應予揭露。

註 3：與擔任目前職位相關之經歷，如目前所擔任職務或前一職務會計師事務所或一親等關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

註 4：總經理或相當任務者（最高經理人）與董事長為同一人、五為配偶或一親等關係成員時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施（例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式）；本公司董事長與總經理互為一親等，係為提升營運效率與決策執行力，惟為強化董事會之獨立性；此外，董事長及總經理平時亦密切與各董事分別在產業領域專事課程，能有效發揮其監督職能。

1. 現任獨立董事分別在產業領域專事課程，能有效發揮其監督職能。

2. 每年度安排各董事參加外部機構專業事務課程，以增進董事會參考，以落實公司治理。

3. 獨立董事在各功能性委員會皆可充分討論並提出建議供董事會參考，以落實公司治理。

4. 董事會成員中過半數董事並未兼任員工或經理人。

(五) 最近年度支付董事、獨立董事、總經理及副總經理之酬金

(1) 一般董事及獨立董事之酬金（個別揭露姓名及酬金方式）：

單位：新台幣 / 仟元

職稱 姓名	董事酬金				兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、 F 及 G 等七項總 額及占總額 之比例 (註 10)	領取 來自 子公司 以 外轉 投資 事業 或母 公司 酬金 (註 11)											
	報酬(A) (註 2)	退職退休金 (B)	董事酬勞(C) (註 3)	業務執行費用 (D)(註 4)	薪資、獎金及特 支費等(E)(註 5)		退職退休金 (F)	員工酬勞(G) (註 6)													
			財務報告內所 有公司(註 7)	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司													
董事長 梁茂生	—	—	3,310	3,310	—	3,310	3,310	0.46%	8,483	10,149	90	281	—	1,69%	12,164	13,830	1.92%	—			
副董事長 梁茂忠	—	—	2,272	2,272	—	2,272	2,272	0.32%	8,486	92	92	278	—	—	—	—	11,128	11,128	1.55%	—	
董事 沈顯和	—	—	2,310	2,310	70	70	2,380	0.33%	—	—	—	—	—	—	—	—	2,380	2,380	0.33%	—	
董事 隆政興	—	—	2,310	2,310	70	70	2,380	0.33%	—	—	—	—	—	—	—	—	2,380	2,380	0.33%	—	
董事 楊賢增 (註)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
獨立董事 董事 朱知遠	—	—	—	—	2,348	2,348	70	70	0.34%	—	—	—	—	—	—	—	—	2,418	2,418	0.34%	—

單位：新台幣 / 仟元

職稱 姓名	董事酬金			兼任員工領取相關酬金			A、B、C 及 D 等 四項總額及占 稅後純益 之比例 (註 10)			F 及 G 等七項總 額及占稅後純益 之比例 (註 10)		
	報酬 (A) (註 2)	退職退休金 (B)	董事酬勞 (C) (註 3)	業務執行費用 (D)(註 4)	薪資、獎金及特 支費等 (E)(註 5)	退職退休金 (F)	員工酬勞 (G) (註 6)	本公司	財務報告內所 有公司 (註 7)	本公司	財務報告內所 有公司 (註 7)	本公司
	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	
獨立董事 林明杰	—	—	—	2,348	2,348	70	70	2,418 0.34%	2,418 0.34%	—	—	
獨立董事 林書賢	—	—	—	2,329	2,329	60	60	2,389 0.33%	2,389 0.33%	—	—	
獨立董事 鄧嘉驥 (註)	—	—	—	2,291	2,291	40	40	2,331 0.32%	2,331 0.32%	—	—	

註：董事楊賢增已於民國 112 年 12 月 4 日辭任；獨立董事鄧嘉驥已於民國 113 年 11 月 4 日辭任。

1. 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

(1) 本公司董事酬金包括薪酬及業務執行費用。

(2) 董事之報酬依本公司章程規定，依其對公司營參與之程度、貢獻之價值，並參動國內外業界水準，授權董事會議定之。

(3) 公司章程中亦明訂不高於年度獲利之 2.25% 作為董事酬勞，董事酬金給付原則：

1) 獨立董事皆擔任審計委員及薪酬委員，考量其所負職責、承循風險及投入時間，另訂合理酬金。

2) 業務執行費用為車馬費，依出席次數給付。

除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務（如擔任母公司／轉投資事業非屬員工之顧問等）領取之酬金：無。  
\* 應請分別列示董事（非獨立董事之一般董事）及獨立董事相關資訊。

(2) 酬金級距表：

給付本公司各個董事 酬金級距	民國 113 年度			
	前四項酬金總額 (A+B+C+D)		前七項酬金總額 (A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司 (註 8)	財務報告內 所有公司 (註 9) H	本公司 (註 8)	財務報告內所 有公司 (註 9) I
低於 1,000,000 元	—	—	—	—
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	梁茂生、梁茂忠、沈顯和、陳政興、朱知遠、林明杰、林書賢、鄒嘉駿	梁茂生、梁茂忠、沈顯和、陳政興、朱知遠、林明杰、林書賢、鄒嘉駿	梁茂生、梁茂忠、沈顯和、陳政興、朱知遠、林明杰、林書賢、鄒嘉駿	梁茂生、梁茂忠、沈顯和、陳政興、朱知遠、林明杰、林書賢、鄒嘉駿
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	—	—	梁茂生、梁茂忠	梁茂生、梁茂忠
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不 含)	—	—	—	—
100,000,000 元以上	—	—	—	—
總計	8	8	8	8

註 1：董事姓名應分別列示（法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示），並分別列示一般董事及獨立董事，以彙總方式揭露各項給付金額。

註 2：係指最近年度董事之報酬（包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等）。

註 3：係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。

註 4：係指最近年度董事之相關業務執行費用（包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等）。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註 5：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明

公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註 6：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工酬勞（含股票及現金）者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。

註 7：應揭露合併報告內所有公司（包括本公司）給付本公司董事各項酬金之總額。

註 8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註 9：應揭露合併報告內所有公司（包括本公司）給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註 10：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 11：

a. 本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額（若無者，則請填「無」）。

b. 公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之 I 欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

c. 酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞（包括員工、董事及監察人酬勞）及業務執行費用等相關酬金。

\* 本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

(3) 總經理及副總經理之酬金（個別揭露姓名及酬金方式）：

單位：新台幣 / 仟元

職稱	姓名	薪資(A) (註 2)	退職退休金(B)	特支費等(C) (註 3)	員工酬勞金額(D)(註 4)	A、B、C 及 D 等四項總額及占 稅後純益之比例 (%) (註 8)		領取來自子公 司以外轉投資 事業或母公司 酬金(註 9)
						財務報 告內所 有公司 (註 5)	本公司	
執行長	梁茂生	2,302	92	92	6,184	6,184	278	—
副執行長	梁茂忠	2,229	3,896	90	6,254	6,254	281	—
總經理	梁又文	2,702	3,777	108	11,416	11,685	514	—
副總經理	汪建宏	1,846	1,846	108	1,549	1,549	70	—

\*不論職稱，凡職位相當於總經理、副總經理者（例如：總裁、執行長、總監…等等），均應予揭露。

(4) 創金級距表：

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	民國 113 年度	
	前四項酬金總額(A+B+C+D)	財務報告內所有公司 本公司(註 6) (註 7)
低於 1,000,000 元	—	—
1,000,000 元(含) ~ 2,000,000 元(不含)	—	—
2,000,000 元(含) ~ 3,500,000 元(不含)	—	—
3,500,000 元(含) ~ 5,000,000 元(不含)	汪建宏	汪建宏
5,000,000 元(含) ~ 10,000,000 元(不含)	梁茂生、梁茂忠	梁茂生
10,000,000 元(含) ~ 15,000,000 元(不含)	梁又文	梁茂忠
15,000,000 元(含) ~ 30,000,000 元(不含)	梁又文	梁又文
30,000,000 元(含) ~ 50,000,000 元(不含)	—	—
50,000,000 元(含) ~ 100,000,000 元(不含)	—	—
100,000,000 元以上	—	—
<b>總計</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

註 1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。

註 2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註 3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提

供房屋、汽車及其交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請

附註說明公司付該司機之相關報酬，但不計入創金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新

股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註 4：係填列最近年度董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額（含股票及現金）。

註 5：應揭露合併報告內所有公司（包括本公司）給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註 6：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 7：應揭露合併報告內所有公司（包括本公司）給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經

理姓名。

註 8：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 9：a. 本欄應明確填列本公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額（若無者，則請填「無」）。  
b. 公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表 E 欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

c. 酬金係指本公司總經理擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞（包括員工、董事及監察人酬勞）及業務執行費用等相關酬金。

\* 本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

(5) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

單位：新台幣／仟元

職稱（註 1）	姓名（註 1）	股票 金額	現金 金額	總計	總額占稅後 純益之比例 (%)
經理人	執行長	梁茂生	—	1,501	0.21%
	副執行長	梁茂忠			
	總經理	梁又文			
	副總經理	汪建宏			
	協理	童寶煒			
	協理	吳晏城			
	協理	袁開春			
	財務主管	張瓊瑤			
	會計主管	賴秋燕			

註 1： 應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露獲利分派情形。

註 2： 係填列最近年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額（含股票及現金），若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 3： 經理人之適用範圍，依據本會 92 年 3 月 27 日台財證三字第 0920001301 號函令規定，其範圍如下：

- (1) 總經理及相當等級者
- (2) 副總經理及相當等級者
- (3) 理及相當等級者
- (4) 財務部門主管
- (5) 會計部門主管
- (6) 其他有為公司管理事務及簽名權利之人

(六) 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年  
度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金佔稅  
後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、  
訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性：

1. 最近二年度支付本公司五董事、監察人、總經理及副總經理酬金佔稅後純益  
比例之分析：

項目	本公司				合併報表所有公司			
	112 年		113 年		112 年		113 年	
	總額	占比後純 益比例	總額	占比後純 益比例	總額	占比後純 益比例	總額	占比後純 益比例
董事酬金	25,233	5.19%	37,608	5.23%	26,840	5.52%	39,274	5.46%
總經理及副 總經理酬金	30,244	6.22%	36,023	7.41%	33,457	6.88%	39,034	8.03%
稅後純益	486,324	—	719,160	—	486,324	—	719,160	—

2. 紿付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及經營績效之關聯性：

### (1) 董事及經理人績效評估與酬金政策如下：

志聖參考市場薪資報酬標準及同業通常水準，訂定董事及經理人的薪資報酬方案。在薪酬決策過程中，綜合考量以下因素，以確保公平性與競爭力：

- 所擔負的職責與投入的時間
- 目標達成情況與個人績效表現
- 在其他職位的整體表現
- 公司近年來對同等職位的薪資報酬標準

此外，志聖評估個人績效與公司經營成果及未來風險之間的合理關聯，兼顧公司短期與長期業務目標及財務狀況，以確保薪酬機制的合理性與穩定性。

### (2) 薪酬政策

根據本公司章程第31條規定，本公司年度如有獲利，應提撥1%~9%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；

本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不超過2.25%為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

### (3) 經理人薪酬政策

志聖的高階經理人薪酬制度與公司經營績效緊密連結，目標在於強化經營效率並創造長期股東價值。薪酬架構包括：

- **固定薪資**：提供穩定報酬，以吸引及留任優秀人才。
- **變動獎金**：依據個人績效與公司經營成果進行發放，以激勵管理團隊提升績效。

為確保薪酬制度與公司營運績效及永續發展策略相符，自2023年起，變動薪酬與永續發展策略及目標掛鉤，以推動企業長遠經營。此外，在核定高階經理人薪酬時，薪資報酬委員會亦與外部專業薪資顧問合作，以確保薪酬具市場競爭力，並符合市場趨勢。

### (4) 薪資報酬委員會職責與運作

薪資報酬委員會負責定期檢討董事及經理人的績效評估標準、薪酬政策及制度，確保其符合公司發展策略與市場水準。當年度的績效目標檢視及酬勞分配內容，皆需經薪資報酬委員會確認通過。

2024年，薪資報酬委員會出席率達100%，董事會亦完全採納薪資報酬委員會之建議，無修改或駁回情事。透過薪資報酬委員會的完善運作，志聖確保董事及經理人的績效評估與薪資決策符合合理標準，維護公司利益，並展現對薪酬制度的透明性與定期檢討之重視。

## 二、公司治理運作情形：

### (一) 董事會運作情形：

(1) 最近年度董事會開會 5 次 (A)，董事、獨立董事出 (列) 席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列) 席次數(B)	委託出席 次數	實際出(列) 席率 %【B/A】	備註
董事長	梁茂生	5	0	100%	
副董事長	梁茂忠	4	1	80%	
董事	沈顯和	5	0	100%	
董事	陳政興	5	0	100%	
董事	楊賢增				112.12.4 辭任
獨立董事	林明杰	5	0	100%	
獨立董事	朱知遠	5	0	100%	
獨立董事	林書賢	4	0	80%	
獨立董事	鄒嘉駿	3	1	60%	113.11.4 辭任

屆數	第 18 屆						備註
	日期	2024/3/5	2024/5/9	2024/8/1	2024/10/31	2024/12/17	
梁茂生	V	V	V	V	V		
梁茂忠	V	V		V	V		
沈顯和	V	V	V	V	V		
陳政興	V	V	V	V	V		
楊賢增							112.12.4 辭任
林明杰	V	V	V	V	V		
朱知遠	V	V	V	V	V		
林書賢	V	V		V	V		
鄒嘉駿	V	V	V				113.11.4 辭任

#### 其他應記載事項：

一、 董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設置審計委員會，不適用證券交易法第 14 條之 3 規定，有關證券交易法第 14 條之 5 所列事項之說明，請參閱本年報審計委員會運作情形。

(二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。

二、 董事對利害關係議案迴避之執行情形：

姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
梁茂生、梁茂忠	董事酬勞分配案	與董事自身有利害關係	不參與表決

三、 當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、  
提昇資訊透明度等)與執行情形評估：

- (1) 規劃策略經營議案之討論方式。
- (2) 本公司致力提升資訊透明度，相關資訊皆於公開資訊觀測站公告，  
以維護股東權益。
- (3) 本公司設置薪資報酬委員會，負責協助董事會定期評估及檢討董  
事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (4) 本公司於 106 年 12 月成立企業永續委員會，負責推動企業永續經  
營、誠信經營及公司治理相關事宜，每年定期向董事會報告執行  
情形。

註 1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

註 2：

- (1) 年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)  
席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
- (2) 年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人~~均~~予以填列，  
並於備註欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)  
席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

(2) 董事會評鑑執行情形：

評估 週期 (註 1)	評估期間 (註 2)	評估範圍 (註 3)	評估方式 (註 4)	評估內容(註 5)
每年 執行 一次	113.1.1~ 113.12.31	董事會績效 評估、個別 董事會績效 評估、審計 委員會績效 評估、薪資 報酬委員會 績效評估	董事成員自評	<p>董事會績效評估：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 對公司營運之參與程度</li> <li>2. 提升董事會決策品質</li> <li>3. 董事會組成與結構</li> <li>4. 董事之選任及持續進修</li> <li>5. 內部控制</li> </ol> <p>個別董事會績效評估：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 對公司目標與任務之掌握</li> <li>2. 董事職責認知</li> <li>3. 對公司營運之參與程度</li> <li>4. 內部關係經營與溝通</li> <li>5. 董事之專業及持續進修</li> <li>6. 內部控制</li> </ol> <p>審計委員會績效評估：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 對公司營運之參與程度</li> <li>2. 審計委員會職責認知</li> <li>3. 提升審計委員會決策品質</li> <li>4. 內部控制</li> </ol> <p>薪資報酬委員會績效評估：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 對公司營運之參與程度</li> <li>2. 薪資報酬委員會職責認知</li> <li>3. 提升薪資報酬委員會決策品質</li> <li>4. 薪資報酬委員會組成及成員選任</li> </ol>
每三 年執 行一 次	113.1.1~ 113.12.31	董事會績效 評估	委任外部專業 機構評估	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 董事會專業職能</li> <li>2. 董事會決策效能</li> <li>3. 董事會對於企業內部控制之監督</li> <li>4. 對永續經營之態度</li> </ol>

## 2024 年度董事會及功能性委員會績效評估報告

### 2024 年度董事會及成員績效評估報告

董事會評估問券 \_ 綜合評分 4.89 分

五大面向，18 項評估：

評估項目		綜合評分	4.89
A.	對公司營運之參與程度	A 項 4 題，平均得分	4.96
B.	提升董事會決策品質	B 項 4 題，平均得分	4.50
C.	董事會組成與結構	C 項 3 題，平均得分	5.00
D.	董事之選任及持續進修	D 項 4 題，平均得分	5.00
E.	內部控制	E 項 3 題，平均得分	5.00

董事成員評估問券 \_ 綜合評分 5.00 分

六大面向，19 項評估：

評估項目		綜合評分	5.00
A.	公司目標與任務之掌握	A 項 3 題，平均得分	5.00
B.	董事職責認知	B 項 3 題，平均得分	5.00
C.	對公司營運之參與程度	C 項 4 題，平均得分	5.00
D.	內部關係經營與溝通	D 項 3 題，平均得分	5.00
E.	董事之專業及持續進修	E 項 3 題，平均得分	5.00
F.	內部控制	F 項 3 題，平均得分	5.00

### 2024 年度功能性委員會績效評估報告

審計委員會評估問券 \_ 綜合評分 5.00 分

四大面向 15 項評估：

評估項目		綜合評分	5.00
A.	對公司營運之參與程度	A 項 3 題，平均得分	5.00
B.	審計委員會職責認知	B 項 4 題，平均得分	5.00
C.	提升審計委員會決策品質	C 項 6 題，平均得分	5.00
D.	內部控制	D 項 2 題，平均得分	5.00

**薪資報酬委員會評估問券\_綜合評分 99.33 分  
四大面向 15 項評估：**

評估項目		綜合評分	5.00
A.	對公司營運之參與程度	A 項 3 題，平均得分	5.00
B.	薪資報酬委員會職責認知	B 項 4 題，平均得分	5.00
C.	提升薪資報酬委員會決策品質	C 項 6 題，平均得分	5.00
D.	薪資報酬委員會組成及成員選任	D 項 2 題，平均得分	5.00

註 1：係填列董事會評鑑之執行週期，例如：每年執行一次。

註 2：係填列董事會評鑑之涵蓋期間，例如：對董事會 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日之績效進行評估。

註 3：評估之範圍包括董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

註 4：評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。

註 5：評估內容依評估範圍至少包括下列項目：

- (1) 董事會績效評估：至少包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。
- (2) 個別董事成員績效評估：至少包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。
- (3) 功能性委員會績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。

## **2024 年度董事會績效外部評估報告**

本公司於 113 年 10 月委由外部專業獨立機構「社團法人臺灣誠正經營學會」執行董事會效能評估（執行年度為 113 年，受評年度為 113 年度），該機構委派三位執行委員進行評估，該機構及執行專家與本公司無業務往來具備獨立性並出具獨立性聲明。以四大構面進行董事會效能評估：董事會專業效能、董事會決策效能、董事會對內部控制之重視程度與監督及董事會對永續經營之態度，透過取得公司內部規範及紀錄、評估問卷及董事個別訪談之方式評核，並於 113 年 12 月 17 日出具董事會效能評估報告向董事會報告。相關建議及改善措施如下：

### **整體觀察結論：**

#### **(一) 董事會專業職能：**

受評企業目前的董事會係由四席非獨立董事及三席獨立董事組成，專業背景則涵蓋有商務、科技、財務、會計及行銷等層面，董事組成堪稱多元，能就各自不同角度提供專業意見。

#### **(二) 董事會決策效能：**

董事可透過多元管道獲取資訊，從中瞭解公司營運狀況，如遇重大業務發展決策，董事會成員與經理人亦會進行深入討論，進而在獲

得充分資訊的情況下做出適當決策。

(三)

董事會對於企業內部控制之監督：

受評企業設置隸屬董事會之專責內部稽核單位，定期進行內控自評並向董事會報告稽核結果，確保稽核執行效能。企業亦設立資訊安全政策，積極推動資訊風險管理，保障內部控制與資訊安全。

(四)

對永續經營之態度：

受評企業持續強化公司治理，並設立永續經營委員會以落實公司永續發展及強化風險評估，各董事對永續議題高度重視，惟受評企業目前在接班梯隊及系統性的人才繼任之規畫，應可再精進強化，以利組織長期穩定性與持續發展。

**優化建議：**

(一)

強化董事多元化組成

建議提升董事會性別與年齡多樣性，吸納女性董事及不同背景人才，以增強董事會決策的多元性與風險評估能力。提醒需於明年董事改選時，遵循規定委任至少一名不同性別董事，並儘早補足獨立董事空缺。

(二)

完善董事會議事錄發言記載

建議在董事會議事錄中適當記載討論過程與董事發言摘要，以便回顧決策經驗並應用於未來規劃。

(三)

提升永續經營委員會之層級為功能性委員會

建議將永續經營委員會升級為董事會轄下功能性委員會，以善用董事多元背景及視野，制度化推動永續議題的討論與策略傳承，並強化永續發展實踐。

(四)

強化人才培育與接班規劃

建議建置系統化人才培育與接班計畫，結合在職培訓、輪調及外部學習機會，並設置監督與反饋機制，以確保關鍵職位的延續性及企業長期發展。

(五)

推進企業永續經營目標

建議持續關注國內外永續趨勢，提升 ESG 資訊揭露及董事永續相關培訓，並提前因應溫室氣體盤查與查證時程，以鞏固企業永續發展的基礎並增強市場信任度。

**本公司未來改善計畫與行動：**

(一)

強化董事多元化組成

提升性別與年齡多樣性，吸納女性與不同背景人才，並於 114 年改選時遵循規定委任至少一名不同性別董事。

(二)

完善董事會議事記錄

在會議記錄中摘要記載董事發言與重要討論內容。

(三)

提升永續經營委員會之層級為功能性委員會

將永續經營委員會納入董事會架構，強化其職能與權限，透過制度化運作推進永續議題討論與策略執行。

(四)

強化人才培育與接班規劃

制定系統化培育與接班計畫，結合多元學習途徑與評估機制，確保關鍵職位延續性。

(五) 推進企業永續經營目標

強化 ESG 資訊揭露，提前因應溫室氣體盤查時程，並加強董事永續議題培訓，提升市場信任。

(二) 審計委員會運作情形：

113 年度審計委員會開會 5 次 (A)，獨立董事出席席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (%) (B / A)(註 1、註 2)	備註
獨立董事	林明杰	5	0	100%	—
獨立董事	朱知遠	5	0	100%	—
獨立董事	林書賢	5	0	100%	—
獨立董事	鄒嘉駿	3	1	60%	113.11.4 辭任

- 113 年度召開 5 次：

開會日期	朱知遠	林明杰	林書賢	鄒嘉駿
2024/03/05	V	V	V	V
2024/05/09	V	V	V	V
2024/08/01	V	V		V
2024/10/31	V	V	V	
2024/12/17	V	V	V	

日期	會議名稱	內容
113/03/05	第二屆第十次 審計委員會	<p>1. 擬通過民國 112 年度財務報告及合併報表暨會計師與公司治理單位溝通事項。 決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。</p> <p>2. 擬通過民國 112 年營業報告書。 決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。</p> <p>3. 113 年簽證會計師委任及報酬案。 決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。</p> <p>4. 本公司截至 112 年 12 月 31 日止之逾期應收帳款非屬資金貸與性質案。 決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。</p> <p>5. 擬通過民國 112 內部控制制度有效性考核及聲明書。 決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。</p> <p>6. 擬通過民國 112 年度盈餘分配案。 決議：本案併同第七案一起討論，經全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。</p> <p>7. 擬通過民國 112 年度盈餘轉增資發行新股案。 決議：本案併同第六案一起討論，本次股利分派以現金方式為主，故本次不執行盈餘轉增資發行新股。</p> <p>8. 修訂「112 年第 1 次買回股份轉讓員工辦法」案。 決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。</p> <p>9. 本公司庫藏股轉讓員工案。 決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。</p> <p>10. 擬發行限制員工權利新股予員工案。 決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議</p>

日期	會議名稱	內容
113/05/09	第二屆第十一次 審計委員會	<p>1.擬通過民國 113 年度第一季財務報告及合併報表暨會計師與公司治理單位溝通事項。</p> <p>決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。</p> <p>2.本公司截至 113 年 3 月 31 日止之逾期應收帳款非屬資金貸與性質案，提請 審議。</p> <p>決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。</p>
113/08/01	第二屆第十二次 審計委員會	<p>1.擬通過民國 113 年度第二季財務報告及合併報表暨會計師與公司治理單位溝通事項。</p> <p>決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。</p> <p>2.本公司截至 113 年 6 月 30 日止之逾期應收帳款非屬資金貸與性質案。</p> <p>決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。</p> <p>3.本公司訂定「永續報告書編制與申報管理辦法」案。</p> <p>決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。</p> <p>4.擬請同意泰國子公司購置辦公室案，提請 討論。</p> <p>決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。</p> <p>5.修訂「112 年第 1 次買回股份轉讓員工辦法」案。</p> <p>決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。</p> <p>6.本公司庫藏股轉讓員工案。</p> <p>決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。</p>
113/10/31	第二屆第十三次 審計委員會	<p>1.擬通過民國 113 年度第三季財務報告及合併報表暨會計師與公司治理單位溝通事項。</p> <p>決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。</p> <p>2.本公司截至 113 年 9 月 30 日止之逾期應收帳款非屬資金貸與性質案。</p> <p>決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。</p> <p>3.擬請同意授權購買工一工業區土地案，提請 討論。</p> <p>決議：全體出席委員同意，在新台幣 15 億元額度內，分批取得 191~194 地號工一工業區土地，送董事會決議。</p> <p>4.本公司 113 年第一次買回本公司股份案。</p> <p>決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。</p> <p>5.本公司庫藏股轉讓員工案。</p> <p>決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。</p>
113/12/17	第二屆第十四次 審計委員會	<p>1.2025 年度稽核計畫，提請 通過。</p> <p>決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。</p> <p>2.2025 年度計畫，提請 通過。</p> <p>決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。</p> <p>3.背書保證案。</p> <p>決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。</p> <p>4.現任會計師獨立性及適任性評估案。</p> <p>決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。</p> <p>5.訂定本公司「永續資訊管理作業辦法」案。</p> <p>決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。</p> <p>6.修訂「公司章程」案。</p> <p>決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。</p> <p>7.本公司庫藏股轉讓員工案。</p> <p>決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。</p>

其他應記載事項：

一、一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

(二) 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：

日期	溝通事	建議及指正
第 2 屆第 10 次 113/03/05 (審計委員會)	1.112 年度內部稽核執行報告。 2.112 年內部控制制度聲明書。 3. 報告 112 年度查核報告查核結果。	無
第 2 屆第 11 次 113/05/09 (審計委員會)	1.113 年 Q1 內部稽核執行報告。 2. 報告 113 年 Q1 核閱報告核閱結果。	無
第 2 屆第 12 次 113/08/01 (審計委員會)	1.113 年 Q2 內部稽核執行報告。 2. 報告 113 年 Q2 核閱報告核閱結果。	無
第 2 屆第 13 次 113/10/31 (審計委員會)	1.113 年 Q3 內部稽核執行報告。 2. 報告 113 年 Q3 核閱報告核閱結果。	無
第 2 屆第 14 次 113/12/17 (審計委員會)	1. 內部稽核執行報告。 2.114 年度稽核計畫。	無

註 1：年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註 2：年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(三) 公司治理運作情形及其與上市公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形（註）			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司已訂定公司治理實務守則，並揭露於本公司網站： <a href="https://www.csun.com.tw/investor-relations/">https://www.csun.com.tw/investor-relations/</a> 公司治理	無差異
二、公司股（一）公司是否訂定內部結構及股東作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		本公司已訂定「公司治理實務守則」，並依規定建立發言人制度，由服務單位及服務代理機構處理相關事宜，並於公司網站擲示聯絡窗口。	無差異
（二）公司是否掌握實質控制公司之主要股東及最終控制者名單？	V		本公司每月依規定公告內部人持股情形，並隨時了解其異動情形，以掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單。	無差異
（三）公司是否建立執行關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		本公司訂有「關係人交易作業程序」、「對於子公司經營管理之監理作業辦法」等內部控制辦法，建立與關係企業之風險控管及防火牆機制，每年稽核單位依稽核計畫查核其執行情形。	無差異
（四）公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		本公司已訂定「內部重大資訊處理暨防範內線管理作業程序」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，並可至本公司網站查詢，每年視需要辦理宣導課程。	無差異
三、董事會之組成及職責	V		（一）董事會是否就成員組成擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	本公司訂有「公司治理實務守則」，董事會成員皆具備執行職務所必需之知識、技能及素養，並已設置獨立董事，各獨立董事成員皆具不同產業背景之專長，落實董事會成員多元化。

評估項目	運作情形（註）		
	是	否	摘要說明
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會外，另設有由經營團隊所組成之企業永續委員會，執行狀況及成果可至本公司網站查詢。	V	本公司除依法設置薪資報酬委員會外，另設有由經營團隊所組成之企業永續委員會，執行狀況及成果可至本公司網站查詢。	
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法，每年定期進行評量方式，並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V	本公司已訂定董事會績效評估暨酬勞與報酬給付辦法，每年定期對董事會之績效進行評估，每年年度結束後，就公司目標、董事職責、進修等面向，以問卷自我評量方式進行績效評估。評估程序於受評年份結束後至最近一次召開之董事會開會前完成，並將評分結果報告董事會，以提升董事會運作之功能。董事會績效評估辦法及結果已揭露於本公司網站，並於 114 年 2 月 25 日董事會報告。	
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V	本公司董事會執行評估一次。本公司委任「社團法人臺灣誠正經營學會」執行董事會，並透過得公司內部規範及紀錄、評估問卷及董事個別訪談之方式評核，並於 113 年 12 月 17 日出具董事會效能評估報告。	每年由審計委員會及董事會評核現任會計師之獨立性及適任性；於審查會計師前，除要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」外，並依據與 13 項 AQI 指標進行評估。經確認簽證會計師與本公司除簽證及財稅案件之外，無其他財務利益及業務關係，會計師家庭成員亦不違反獨立性要求，以及參考 AQI 指標資訊，確認會計師及事務所，在查核經驗與受訓時數均優於同業平均水準，另於最近 3 年也將持續導入數位審計工作，提高審計品質。另函請本公司服務代理機構確認其持股情形，經本公司財會單位審查會計師獨立性及適任性後，送請審計委員會進行審議，提報董事會決議；民國 113 年度會計師審查評核表業已於民國 113 年 12 月 17 日提報審計委員會及董事會通過。本公司評查會計師獨立性要件審查、運作及適任性檢查

評估項目	運作情形（註）		
	是	否	摘要說明
與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因			<p>重要標準項目列舉如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 會計師本人或其配偶、未成年子女並無與本公司有投資或分享財務利益之關係。</li> <li>• 會計師本人或其配偶、未成年子女並無與本公司有資金借貸。</li> <li>• 會計師或審計服務小組成員並無宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券。</li> <li>• 會計師最近二年並無會計師懲戒委員會懲戒紀錄。</li> <li>• 會計師或審計服務小組成員目前或最近二年內並無擔任本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。</li> <li>• 會計師或審計服務小組成員並無與本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務之關係。</li> <li>• 會計師並無現受委託人或受查人之聘僱擔任經常工作，支領固定薪給或擔任董事、監察人。</li> <li>• 會計師提供財務報表之查核、核閱、複核或專案審查並作成意見書時，除維持實質上之獨立性外，是否亦維持形式上之獨立性。</li> </ul>
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務（包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會議事錄等）？	V		<p>本公司由企業永續委員會負責推動公司治理相關事務，由財務處最高主管負責督導公司治理相關事宜，依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會會議記錄、辦理公司登記及變更登記、安排董事進修課程等。</p>
五、公司是否建立與利害關係人（包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等）溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		<p>本公司設有發言人制度，與利害關係人均保持暢通之溝通管道，並於公司網站揭露相關業務人員之聯絡資訊及設置利害關係人專區，以妥善回應利害關係人所關切之包括企業永續發展在內之相關議題。</p>
六、公司是否委任專業服務代辦機構辦理股東會事務？	V		<p>本公司已委任專業服務代理機構 - 統一綜合證券服務代理人處理股東會及服務相關服務相關事務。</p>
七、資訊公開	(一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理等相關資訊。 <a href="https://www.csun.com.tw/investor-relations">https://www.csun.com.tw/investor-relations</a>	V	<p>本公司已於網站，揭露相關財務業務及公司治理等相關資訊。</p>

評估項目	運作情形（註）		
	是	否	摘要說明
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	V	本公司依規定定期及不定期於公開資訊叡測站申報各項財務、業務資訊；並定期將產品、業務等最新消息揭示於本公司之網站： <a href="http://www.csun.com.tw">www.csun.com.tw</a>	本公司於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營收情形。
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營收情形？	V	八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任險之情形等）？	本公司訂有「供應商管理程序」來審核供應商與公司的商業行為，避免損害雙方商譽及利益，必要時供應商經審核完成後開始合作前，雙方簽署「保密合約」（NDA）以保障雙方之權利與義務。
			<b>員工權益及僱員關懷</b> 本公司成立職工福利委員會，推動各項補助活動，以確保員工權益。 <b>投資者關係</b> 本公司由專責單位依相關規定於公開資訊叡測站公告及公司網站揭露有關財務、業務等相關訊息，期能達到資訊透明公開。 <b>供應商關係</b> 「供應商管理程序」來審核供應商與公司的商業行為，避免損害雙方商譽及利益，必要時供應商經審核完成後開始合作前，雙方簽署「保密合約」（NDA）以保障雙方之權利與義務。 <b>利害關係人之權利</b> 本公司已於公司網站設置利害關係人專區，提供溝通管道以維護雙方之合法權益。 <b>風險管理政策及風險衡量標準之執行情形</b> 依法訂定各種內部規章，進行各種風險管理及評估。 <b>客戶政策之執行情形</b> 本公司平時與客戶皆保持密切聯繫，並建構專業的客服團隊及完善售服體系提供全方位優質服務，協助客戶提升競爭力並創造更高附加價值自許。

評估項目	運作情形（註）			與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			公司為董事及監察人購買責任保險之情形 本公司已為全體董事購置董監責任險，以降低並分散董事因錯誤或疏失之行為而造成公司及股東重大損害之風險，並已於公開資訊觀測站公告及於董事會報告投保情形。	

九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發佈之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：  
本公司秉持永續經營理念，將企業永續經營、與客戶及社會群體建立長期夥伴關係、善盡企業公民責任，於 106 年成立企業永續委員會，負責推動企業永續發展及誠信經營相關事宜，每年向董事會報告執行情形及結果。

改善項目：

- 1. 新官網持續優化：優化使用介面，提供豐富且公開的企業資料 / 貼近使用者需求，提供更快速且直接的聯絡窗口接洽。  
 2. 於本公司網站設置企業社會責任專區，讓投資人、客戶、供應商及利害關係人了解本公司企業永續發展推動及執行情形。
- 尚未改善優先加強事項與措施：  
 1. 持續優化新官網各項配置，使公司網站內容更符合投資人及相關利害關係人之需求。  
 2. 持續優化本公司網站之企業社會責任專區，讓投資人、客戶、供應商及利害關係人了解本公司企業永續發展推動及執行情形。

**(四) 公司如有設置薪資報酬委員會或提名委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：**

**(1) 薪資報酬委員會成員資料：**

身分別 (註 1)	姓名	條件	專業資格 與經驗 (註 2)	獨立性情形 (註 3)	兼任其他 公開發行 公司薪資 報酬委員 會成員家數
獨立董事 (召集人)	林明杰	本公司薪酬委員會由全體三位獨立董事組成，委員之專業資格與經驗請參閱本年報「貳、一、(一) 董事及監察人資料」	所有薪酬委員會委員皆符合下述情形： 1. 符合金融監督管理委員會頒訂之證券交易法第十四條之六暨「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」(註)相關規定 2. 本人(或利用他人名義)、配偶及未成年子女無持有公司股份 3. 最近二年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額	2	
獨立董事	朱知遠			—	
獨立董事	林書賢			—	
獨立董事	鄒嘉駿 (註 4)			—	

註：選任前二年及任職期間無下列情形之一：

- (1) 公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 公司或其關係企業之董事、監察人。
- (3) 本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1% 以上或持股前十名之自然人股東。
- (4)(1) 所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5) 直接持有公司已發行股份總數 5% 以上、持股前五名或依公司法第二十七條指派代表人擔任公司董事之法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6) 與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。
- (7) 與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。
- (8) 與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5% 以上股東。
- (9) 為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新台幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但擔任本公司薪資報酬委員會成員者，不在此限。

註 1：請於表格內具體敘明各薪資報酬委員會成員之相關工作年資、專業資格與經驗及獨立性情形，如為獨立董事者，可備註敘明各薪資報酬委員會成員之相關工作年資、專業資格與經驗及獨立性情形。

註 2：專業資格與經驗：敘明個別薪資報酬委員會成員之專業資格與經驗。

註 3：符合獨立性情形：敘明薪資報酬委員會成員符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第 6 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人；最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

註 4：獨立董事鄒嘉駿已於民國 113 年 11 月 4 日辭任。

### (2) 薪資報酬委員會職責

本委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

- (A) 訂定並定期檢討董事、獨立董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (B) 定期評估並訂定董事、獨立董事及經理人之薪資報酬。

### (3) 薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計 4 人。

二、本屆委員任期：民國 111 年 6 月 09 日至 114 年 6 月 08 日，最近年度薪資報酬委員會開會 5 次 (A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 ( B )	委託出席次數	實際出席率 (%) ( B / A )(註)	備註
召集人	林明杰	5	0	100%	
委員	朱知遠	5	0	100%	
委員	林書賢	4	0	80%	
委員	鄒嘉駿	3	1	60%	113.11.4 辭任

- 113 年度召開 5 次

開會日期	朱知遠	林明杰	林書賢	鄒嘉駿
2024/03/05	V	V	V	V
2024/05/09	V	V	V	V
2024/08/01	V	V		V
2024/10/31	V	V	V	
2024/12/17	V	V	V	

日期	會議名稱	內容
113/03/05	第五屆第七次薪酬委員會	1. 本公司民國 112 年度董事酬勞及員工酬勞總數案。 決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。 2. 擬提請通過本公司庫藏股轉讓經理人及員工案，提請公決。 決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
113/05/09	第五屆第八次薪酬委員會	本公司 112 年董事酬勞分配內容案。 決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。 2. 本公司 113 年調薪擬議案，提請審議。 決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
113/08/01	第五屆第九次薪酬委員會	1. 本公司 2024 年經理人調薪擬議案，提請審議。 決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。 2. 本公司 2024 年經理人獎酬擬議案，提請審議。 決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。 3. 本公司庫藏股轉讓經理人案，提請審議。 決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

日期	會議名稱	內容
113/10/31	第五屆第十次 薪酬委員會	1. 本公司 2024 年經理人獎酬擬議案，提請審議。 決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。 2. 擬提請通過本公司庫藏股轉讓經理人及員工案。 決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
113/12/17	第五屆第十一 次 薪酬委員會	1. 本公司經理人 2024 年績效評估結果及年終總所得內容案，提請審議。 決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。 2. 本公司庫藏股轉讓經理人及非經理人案，提請審議。 決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理：無。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

註：

- (1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
- (2) 年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因	
	是	否		
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專事（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V	本公司於由2017年成立「永續經營委員會」，由梁又文總經理擔任主席，負責公司永續發展統籌及推動等相關事務，轉下設有公司治理、環安衛、產品/客戶關係與永續供應鏈等5個委員會，有效進行資源整合，將永續策略落實至各部處執行。	永續發展委員會每年至少1次向董事會進行永續策略與專案執行成效報告。董事會定期聽取管理階層報告重大議題執行進度，針對管理階層報告內容評估策略可行性或提供其他建議方向，且追蹤執行進度和敦促管理階層評估調整規劃事項。其討論議題包括：溫室氣體盤查執行進度、ISO14001環境管理系統推動、ISO45001職業安全衛生管理系統執行、TCFD氣候相關財務訊息揭露，2024年召開之5場董事會中，其中4場董事會提及永續發展相關議案，占董事會場次數整體80%。	無重大差異情形
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？(註2)		本公司永續報告書揭露資訊涵蓋公司於113年1月至113年12月間在主要據點之永續發展表現，範圍包括林口總部、台北廠、台中廠營運與生產據點之資訊。	永續發展委員會根據公司產業特性與內部關注主題，並參考GRI準則、國內外永續趨勢、產業標準與同業資訊進行辨識，採收集方式鑑別產業中具共通性之主題。分析調查後，共辨識出8項重大主題，分別為：產品技術創新、公司治理、客戶服務/產品品質與安全、誠信經營、職業安全與衛生、人才吸引與留任、人才發展與培育、氣候變遷因應。並據以辨識之重大主題，訂定監督及管控之風險管理政策及採取具體之行動方案，以降低相關風險之影響。相關風險管理政策詳如永續報告書。	無重大差異情形

推動項目	執行情形（註 1）		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V	本公司依循 ISO 14001 建置環境管理系統及持續通過第三方驗證，維持系統有效性，並依據 ISO 14064-1 規範每年進行溫室氣體盤查，追蹤減排成效並公開揭露於永續報告書及本公司網站。（ <a href="https://csun.com.tw/energy-and-greenhouse-gas/">https://csun.com.tw/energy-and-greenhouse-gas/</a> ）	無重大異情形
(二) 公司是否致力於提升能能源使用效率率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V	1. 本公司於機台設計時，選用較小動力傳動元件讓機台輕量化或選用高效率交換器之電源供應元件，以達節能。 2. 耗材回收及再利用，包括宣導與推動紙類回收 / 耗材再利用。 3. 妥善處理廢棄物，包括宣導與推動垃圾分類與減量，本公司將資源資分類回收，委託合法廠商回收及處理本公司之廢棄物。 4. 與國內外永續標竿企業聯手，進行節能減碳研發專案，精進製造技術開發高節能設備，以目前之產品「熱回收設備」為例，每台設備能協助客戶減少 1.58 公噸二氧化碳當量。 5. 機板從木製機板改用塑膠機板，減少木製垃圾量，塑膠機板重複利用率亦較佳。	無重大異情形
三、環境議題		(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	V
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其廢棄物管理之政策？	V	面對氣候變遷，公司積極推動與改革溫室氣體減量管理措施，包含節能效率提升方案，如： 1. 逐年增加節能車輛之比重。 2. 辦公室內全面禁煙，吸煙者需至戶外指定場所，以符合法規，另定期消毒、滅鼠及除蟲害等。 3. 全公司更換節能燈管 (LED 燈)。	無重大異情形
		本公司為善盡企業社會責任，致力於環境保護，以達到「保護地球、愛地球」之社會責任，擬訂環境保護管理規定，詳細執行情形可參閱本年報貳、公司治理運作情形(六)上市上櫃公司氣候相關資訊。	無重大異情形

推動項目	執行情形（註 1）		與上市櫃公司永續發展異情形及原因
	是	否	
四、社會議題	(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理制度與程序？	V	<p>志聖為善盡企業社會責任、保障全體同仁及利害關係人基本人權、工作遵循相關人權政策及執行相關人權指標，並制定工作規則及相關人權宣言、「聯合國國際勞動組織」等國際公認之人權標準訂定工作會議，除提供員工多元溝通管道讓員工參與管理階層間能直接進行溝通討論，同時宣導公司政策、福利措施及各項活動，使員工意見得以充分表達，並適時給予回應和協助。並於不定期新人教育訓練及每月全公司月會進行人權政策宣導，<b>詳細執行情形請參閱本年報-職運概況一七、社會責任：員工人權保障。</b></p>
	(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假日及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	V	<p>(1) 本公司會定期評估營運成本、獲利能力、內外部薪資公平性與績效管理等，結合社會責任考量，訂立合理薪資報酬政策對全員員工於到任時宣導道德行為為準則及員工倫理相關規範，並將工作規則揭露於員工入口網站，供員工隨時查閱與自我檢視。</p> <p>(2) 依照公司營運目標發放季績效獎金及終獎金：            -本公司導入績效獎金制度，衡量每季 EPS 及各項關鍵指標（如：品質指標、環保排污、減碳、工安指標等），讓員工共享成果（以每季營業利益 19% 為基礎），有效激勵同仁。            -本公司治理與營運管理方針，針對如何確實達成營運成果，更細緻地從經營層指標、部門工作目標及個人績效，充分結合水準指標並以實際企業社會責任為使命。</p> <p>(3) <b>員工薪酬指標並以實踐福利措施詳細執行情形，請參閱本年報-職運概況一五、勞資關係。</b></p>

推動項目	執行情形（註1）		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(三) 公司是否提供員工安全與健康工作環境，並對之定期實施安全與健康教育？	V	<p>1. 每年至少辦理一次以上的全體員工健康檢查，補助員工健康檢查項目。</p> <p>2. 落實防災講座的安排和每月職災宣導。</p> <p>3. 委中興保全所屬立偉電子提供 AED 自動外心臟去顫器，提供給一般非醫護人員，使用於心臟驟停的可攜式急救設備。</p> <p>4. 针對每項因公受傷案例立案控管，統計類型與次數，並每季召開跨廠區高階主管季會及行政季會檢討及提出改善預防方針，打造安全安心的工作環境。</p> <p><b>詳細執行情形可參閱本年報章、營運概況三、(三) 工作環境與人身安全的保護措施。</b></p>	無重大異情形
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V	本公司為員工具備專業素養與發展優勢，不定期舉辦內部訓練課程及派外接受專業訓練。	無重大異情形
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V	本公司於網站上公佈之經營理念第一項：志聖創新改良的產品與服務能使顧客滿意，公司之品質政策為：堅持品質、顧客滿意、事業踏實、企業永續，細則則明訂於品質手冊內處理各項產品與服務之售後客訴申訴處理之程序。此外依據「客戶滿意度調查程序」執行年度客戶滿意度調查回饋，以掌握客戶對產品、技術、品質、交期及服務之滿意度，並加以改善之。	無重大異情形

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務差異情形及原因
	是	否	
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循其實施情形？	V	本公司訂有「環境保護管理規定」，規範供應商在環境保護及安全衛生之要求，增進對社會與環境之責任，與供應商共同致力於綠色環保科技。如有違反，本公司得以立即終止與供應商之合作關係。	無重大差異情形
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		本公司發行之永續報告書主要依循全球永續性報告協會 (Global Reporting Initiative, GRI) 於 2021 年公布之 GRI 適用準則 2021(GRI Standards 2021)、「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」及「上市公司氣候相關資訊」，並參考「氣候相關財務揭露框架 (Task Force on Climate related Financial Disclosures, TCFD)」進行編製。	無重大差異情形
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司已訂有「企業社會責任守則」、「上市公司社會責任實務守則」及「永續資訊管理作業辦法」並無重大差異，可至本公司網站或公開資訊觀測站下載。有關企業社會執行情形，請參閱本年報或公司網站。守則」，並依該守則管理公司對經濟、環境及社會之風險與影響，且據以改進。執行至今尚無差異情形。		報告書資料及數據由永續經營委員會彙整，呈報董事會審議，在發行前取得董事會核准，並委託資誠聯合會計師事務所按照中華民國確信準則 3000 號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」針對所選定指標執行獨立有限確信 (Limited assurance)，確認報告附於本報告書附錄。另針對品質管理系統 (ISO 9001)、職業安全衛生管理系統 (ISO 45001)、環境管理系統 (ISO 14001) 及溫室氣體盤查，每年皆進行內部稽核及請外部機構進行溫室氣體盤查，確保資料及數據之正確性。永續報告書公開於本公司網站： <a href="https://www.csun.com.tw/esg/">https://www.csun.com.tw/esg/</a>	無重大差異情形
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：各項永續發展運作情形，請參考本公司網站或永續報告書。			

## (六) 上市上櫃公司氣候相關資訊

項目	執行情形
1. 氣候相關資訊執行情形	<p>1. 敘明董事會與管理階層對於根據世界經濟論壇（World Economic Forum, 簡稱 WEF）2023 年所發布的《全球風險報告》，「氣候變遷減緩及調適失敗」、「自然災害及極端天氣事件」為長期顯著之風險，極端氣候所帶來的威脅愈趨明顯。志聖為因應氣候變遷對公司造成的潛在衝擊，並落實有效的氣候管理策略，自 2023 年起導入國際金融穩定委員會制定之氣候相關財務揭露建議（Task Force on Climate-related Financial Disclosures Recommendation, TCFD），依循治理、策略、風險管理、指標與目標四大揭露框架，強化志聖對於氣候風險與機會的鑑別與因應，擬訂治理策略及目標，並落實於營運管理流程中，以持續掌握與因應氣候變遷對志聖的衝擊影響。</p> <p>■ 董事會為志聖氣候治理之最高單位，負責推動與監督氣候相關議題策略方向，不定期討論當前氣候風險機會趨勢，並針對關鍵氣候風險決策具體策略、目標，以穩定維持公司之永續經營。董事會轄下設立永續經營委員會由總經理擔任主席，每年至少 1 次向董事會呈報公司永續推動進程與執成效。</p> <p>■ 永續經營委員會為志聖永續發展與氣候治理之事責單位。負責鑑別志聖營運相關之關鍵氣候風險與機會議題，並由總經理定期召集舉辦會議，與各部門單位協商氣候因應策略、目標設定與管理計畫，並將執行成果向上呈報董事會，並協助內部溝通、整合。</p>

項目	執行情形
2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、財務（短期、中期、長期）。	<p>2. 現階段評估無立即性實體風險，然而，以災害潛勢評估的結果，如遇短時間大量降雨等異常天候情況，雖不致直接衝擊到營運場景，但於廠區 500 公尺範圍內有淹水潛勢區，可能直接或間接影響員工出勤、產品銷售出貨等交通運輸。</p> <p>轉型風險的長期發展之評估下，存在有市場風險、技術風險，主要由於全球淨零目標之推動發展，可促進消費者需求轉變，需有低碳技術或產品來因應未來的市場需求轉變。另外，在低碳相關政策及法令的轉型風險，包含國內碳費、總量管制等排碳新制上路，以及出口國外的碳邊境調整機制的影響，將帶來原料成本、產品銷售成本及市場定價的不確定性。</p> <p>在業務策略配合財務規劃，短期(1~5 年)作為營運轉型之籌備期，除了結合供應鏈持續強化動性外，同步觀望市場變化及需求，並開發低碳產品以因應中期(5~15 年)淨零時代過度時期的新市場需求，至於長期(15~30 年)策略則以國家淨零目標為參考方向，逐步擬定排放減量等改善計畫。</p>

項目	執行情形
5.若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之特性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	<p>5. (1) 情境描述：以異常氣候、平均氣溫升高等情境，考量中期、長期的變化以及對營運據點產生的實體風險。</p> <p>(2) 參數和假設：參考 NDC 國家自定貢獻之減碳目標以及 IPCC AR5 第五次評估報告之路徑，並假設長期地球平均升溫超過 2 度 C 的發展下，以 RCP 4.5 及 RCP 8.5 兩種惡化的氣候路徑作為情境分析的參數和未來氣候情況的假設基礎。</p> <p>(3) 分析因子：篩選可能影響公司營運韌性的要素，包含供應鏈、業務銷售、資金週轉等作為評估指標。</p> <p>(4) 主要財務影響：透過資訊蒐集與不同的氣候變遷情境下可能對企業財務狀況產生的影響，包括直接損失、間接成本、市場需求變化等。進而評估其對財務績效的潛在影響。</p> <p>(5) 風險評估：量化財務影響資訊並進一步評估公司目前的韌性水平是否足以應對不同情境下可能出現的風險和挑戰。</p>
6.若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標。	6.本公司尚未訂定重大轉型計畫；
7.若使用內部確定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	7.本公司尚未使用確定價工具；

項目	執行情形
8.若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室升溫氣候變動性，並將各項目標落實於廠區與部門營運管理中。目前志聖針對氣候變遷已設定期程，每年達成透過永續經營委員會監督各據點年度達成情況，滾動式修正氣候目標並每年呈報董事會，逐年確認其有效性和適宜性。	<p>8. (1) 為有效管理氣候風險帶來的威脅並強化志聖因應氣候變遷能力，志聖已設定氣候變遷能力，志聖個體於2022年已依據國際標準完成溫氣體排放範疇、規室氣體盤查，未來將以此作為基準年進行減碳目標設定。目前志聖針對氣候變遷已設定期程，每年達成透過永續經營委員會監督各據點年度達成情況，滾動式修正氣候目標並每年呈報董事會，逐年確認其有效性和適宜性。</p> <p>(2) 本公司無使用碳抵換或再生能源憑證；</p>

**1-1 最近二年公司溫室氣體盤查及確信情形**  
**1-1-1 溫室氣體盤查資訊**

**說明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸CO<sub>2</sub>e)、密集度(公噸CO<sub>2</sub>e/百萬元)及資料涵蓋範圍。**

執行範圍	112 年度		113 年度	
	排放量 (噸 CO <sub>2</sub> e)	密集度 (噸 CO <sub>2</sub> e/營業額 新台幣百萬元)	排放量 (噸 CO <sub>2</sub> e)	密集度 (噸 CO <sub>2</sub> e/ 營業額 新台幣百萬元)
本公司	範疇一 範疇二 範疇三 總計	485.18 1,297.51 413.05 2,195.74	487.31 1,471.65 550.53 2,509.49	
		0.61	0.52	

**資料涵蓋範圍為本公司總部、台北廠、台中廠、南區辦公室彙總資訊。**

**註 1：直接排放量(範疇一，即直接來自於公司所擁有或控制之排放源)、能源間接排放量(範疇二，即來自於輸入電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放)及其他間接排放量(範疇三，即由公司活動產生的，非屬能源間接排放，而係來自於其他公司所擁有或控制之排放源)。**

**註 2：直接排放量及能源間接排放量資料涵蓋範圍，應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理，其他間接排放量資訊得自願揭露。**

**註 3：溫室氣體盤查標準：溫室氣體查證議定書 (Greenhouse Gas Protocol) 或國際標準組織 (International Organization for Standardization, ISO) 發布之 ISO 14064-1。**

**註 4：溫室氣體排放量之密集度得以每單位產品/服務或營業額計算，惟至少應敘明以營業額(新臺幣百萬元)計算之數據。**

**1-1-2 溫室氣體確信資訊**

**說明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。**  
**完整確信資訊將於永續報告書揭露。**

**註 1：應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理，若公司未及於年報刊印日取得完整溫室氣體確信意見，應註明「完整確信資訊將於永續報告書揭露」，若公司未編製永續報告書者，則應註明「完整確信資訊將揭露於公開資訊觀測站」，並於次一年度年報揭露完整之確信資訊。**

**註 2：確信機構應符合臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃買賣中心訂定之永續報告書確信機構相關規定。**

**註 3：揭露內容可參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站最佳實務參考範例。**

## 1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

### 敘明溫室氣體減量基準年及其數據、策量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。

#### (1) 溫室氣體減量基準年及其數據：

為有效管理氣候風險帶來的威脅並強化志聖因應氣候變遷能力，志聖已設定氣候相關管理目標以提升氣候韌性，並將各項目標落實於廠區與部門營運管理中。志聖個體於2022年已依據國際標準完成溫室氣體盤查，未來將以此作為基準年進行減碳目標設定。目前志聖針對氣候變遷已設定相應目標，並透過永續經營委員會監督各據點年度達成情況，滾動式修正氣候目標並每年至報董事會，逐年確認其有效性與適宜性。短中長期目標：

1. 逐步推動集團完成合併溫室氣體盤查，並訂定溫室氣體減量目標。
2. 評估成本效益，考量透過太陽能自發自用或對外採購，逐年提升再生能源使用比例。
3. 2050年達成淨零排放。

執行範圍		2022 年度(基準年)		2023 年度		2024 年度	
		排放量 (噸 CO <sub>2</sub> e)	密集度 (噸 CO <sub>2</sub> e/營業額 新台幣百萬元)	排放量 (噸 CO <sub>2</sub> e)	密集度 (噸 CO <sub>2</sub> e/營業額 新台幣百萬元)	排放量 (噸 CO <sub>2</sub> e)	密集度 (噸 CO <sub>2</sub> e/營業額 新台幣百萬元)
本公司	範疇一	443.09	485.18			487.31	
	範疇二	1,438.19	1,297.51			1,471.65	
	範疇三	384.49	413.05			550.53	
<b>總計(範疇一～三)</b>		<b>2,265.77</b>	<b>0.42</b>	<b>2,195.74</b>	<b>0.61</b>	<b>2,509.49</b>	<b>0.52</b>

\* 註 1：資料涵蓋範圍為本公司總部、台北廠、台中廠、南區辦公室彙總資訊。

\* 註 2：2024 年度資訊尚待確認機構審核中，詳細及確信後資訊將於本年度永續報告書中揭露。

#### (2) 行動計畫：

1. 依循 TCFD 架構，定期執行關鍵氣候機會評估，並訂定因應措施及管理目標。
2. 計畫逐步擴大溫室氣體盤查範圍，評估導入 ISO 14067 產品碳足跡標準。
3. 進行設備汰舊換新及優化生產組裝之流程及技術，減少能源浪費。
4. 鼓勵員工提出節能減碳研發方案，投入低碳產品服務開發。

註 1：應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理。

註 2：基準年應為以合併財務報告邊界完成盤查之年度，例如依本準則第 10 條第 2 項規定之令，資本額 100 億元以上之公司應於 114 年完成 113 年度合併財務報告之盤查，故基準年為 113 年；倘公司已提前完成合併財務報告之盤查，得以該較早年度為基準年，另基準年之數據得以單一年度或數年平均值計算之。

表 1

風險 / 機會 風險說明	風險 / 機會 期程	潛在財務影響	因應策略與管控措施
實體風險 立即使性	颱風、野火、暴雪等極端天氣事件嚴重程度提高	營業成本增加 營業收入減少	<p>1. 供應鏈多元化：採取多元化供應鏈策略，以減少對單一地區或供應商的依賴。可降低單一極端天氣事件對供應鏈造成風險影響。</p> <p>2. 應急計劃：</p> <p>3. 氣候風險評估和監測，以評估公司面臨的風險情況，及時調整應對策略和措施，以確保業務 / 產線持續運營和發展。</p>
市場	利害關係人 及客戶對環保 / 低碳要求提升	中期 (3 - 10 年內) 營業成本增加 營業收入減少	<p>1. 舊設備：增加設備節能改造方案，舊線激活</p> <p>2. 新設備：設計上進行節能規劃</p> <p>3. 公司通過 ISO14001 管理系統，設備設計採用可回收再利用即無毒性材料。</p>
技術	以低碳商品 替換現有產品 和服務	中期 (3 - 10 年內) 生產成本及研發支出增加 營業收入減少	<p>1. 訂定廠內低碳項目及作法，利用定期研發季會討論或定力研發策略和目標。</p> <p>2. 優化研發流程：公司應該對研發流程進行優化，確保其高效率和高質量。這可能包括引入專案管理工具和方法，確保項目進度可控，並及時檢測和解決可能的問題。</p> <p>3. 資源分配和預算管理：公司應該合理分配研發資源，包括人力、財務和技術資源，以確保項目的順利進行。財務、生管、專案 LEADER 各研發預算進行有效管理，監控和控制開支，防止超支或資源浪費。</p> <p>4. 技術和知識管理：研發過程中產生的技術和知識資產，進行專利申請及管理、技術文檔轉 PAC 等。</p>
市場	開發 / 增加 低碳產品 服務	中期 (3 - 10 年內) 營業收入增加	<p>1. 舊設備：增加設備節能改造方案，舊線激活</p> <p>2. 新設備：設計上進行節能規劃</p> <p>3. 參加 ASE 以大帶小專案，開發節能低碳設備。</p> <p>4. 針對客戶其他設備商的機台進行熱回收節電改造。</p>

(七) 公司履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營情形差異情形及原因：

評估項目	執行情形(註)		與上市上櫃公司誠信經營情形差異情形及原因 摘要說明
	是	否	
一、訂定誠信經營政策及方案	(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理層積極落實經營政策之承諾？	V	本公司訂有「誠信經營守則」及「檢舉非法與不道德或不誠信行為為案件之處理辦法」，藉以規範此所需遵循之企業員工行為為準則，並不定期向公司員工進行宣導，其執行及處理情形揭露於本公司網站。
	(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	V	本公司「誠信經營守則」，載明不誠信行為之防範措施，如：本公行賄、提供非法定利益、侵害營業秘密及智慧財產權等款待或其他不正當利益、侵權行為。
二、落實誠信經營	(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V	本公司除訂定「誠信經營守則」外，尚訂有「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「關係人交易作業程序」等辦法。
	(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	V	本公司以公平與透明之方式從事商業活動，並於從事商業活動前，審慎評估來對象，以避免與不誠信之對象進行交易。另與交易對象簽訂商業契約時，由法務單位審查立之合約條款，以避免與有不誠信行為為紀錄者進行交易。

評估項目	執行情形（註）			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因															
	是	否	摘要說明																
			<p>本公司成立「永續經營委員會」，每年定期向董事會報告執行情形。委員會建立企業誠信與倫理規範，維持清廉秩序，落實營運及財務管理，維護公司利益，保障股東權益，恪守商業行為及道德準則規範，使公司穩健成長。</p> <p>(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期（至少一年一次）向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p>	<p>本公司由經營團隊所組成之企業永續委員會為推動企業社會責任之權責單位，負責推動各項企業社會責任計畫及統籌擬定全公司社會責任目標和永續發展方向相關政策，並向董事會報告執行情形，最近一次於2024年10月31日向董事會報告執行情形。</p> <p>本公司於2024年4月24日邀請新北市調查局調查處副主任及其調查員向公司同仁宣導，宣導課程內容「企業防弊與反詐暨資安宣導」，確保公司內部同仁皆具備反貪腐意識，並可將反貪腐具體落實於日常營運工作中，參與人次178人，時數178小時。</p> <p>本公司新進員工入職時皆簽署誠信廉潔承諾書，並加強宣導公司誠信經營的重點，2024全年度共簽署105份。</p> <p>本公司宣導單位不定時於廠區聯合月會宣導同仁對於遵循誠信經營規範的堅定承諾，以求落實，宣導情形如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>日期</th> <th>教育訓練名稱</th> <th>對象</th> <th>人次</th> <th>時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024/8/31</td> <td>反貪腐、禁賄賂</td> <td>全體員工</td> <td>371</td> <td>93</td> </tr> <tr> <td>2024/8/31</td> <td>公司治理與企業文化的核心要素誠信廉潔</td> <td>全體員工</td> <td>371</td> <td>93</td> </tr> </tbody> </table>	日期	教育訓練名稱	對象	人次	時數	2024/8/31	反貪腐、禁賄賂	全體員工	371	93	2024/8/31	公司治理與企業文化的核心要素誠信廉潔	全體員工	371	93
日期	教育訓練名稱	對象	人次	時數															
2024/8/31	反貪腐、禁賄賂	全體員工	371	93															
2024/8/31	公司治理與企業文化的核心要素誠信廉潔	全體員工	371	93															
			<p>(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？</p>	<p>本公司對內相關內部規章與員工公司工作守則均公佈於公司內部網站，並於修訂時函知全體同仁。對外於公司網站設置利害關係人事區（網址：<a href="https://www.csun.com.tw/investor-relations/">https://www.csun.com.tw/investor-relations/</a> 利害關係人）。</p>															

評估項目	執行情形（註）		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核並製成稽核報告，定期於董事會報告稽核結果為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？		本公司已訂有內部控制制度、內部稽核實施細則、會計制度及各項管理制度，且運作情形正常並落實誠信經營之要求，本公司內部稽核依稽核計畫進行查核並製成稽核報告，定期於董事會報告稽核結果無差異	
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？		公司定期辦理與誠信經營相關之教育訓練，並已將相關規範之作業程序及辦法置於本公司內部網站，以供員工隨時查閱。	無差異
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？		本公司對違反法令規章或道德行為為準則之行為，訂有「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，設有檢舉及申訴管道，如電子郵件、員工意見箱及相關懲戒措施，並不定期檢討修正，以達有效及充分意見溝通之管道，使問題發生時，得以快速及有效溝通解決，及針對檢舉對象指派適當之受理專責人員。	無差異
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？		本公司設有檢舉辦法，且於公司設置檢舉信箱，對檢舉人身分及檢舉內容將絕對以保密。	無差異
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？		本公司對於檢舉人負責保密之責，避免檢舉人因檢舉而遭受不當之處置之措施。	無差異

評估項目	執行情形(註)		
	是	否	摘要說明
四、加強資訊揭露	公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？		本公司誠信經營守則已上傳至公開資訊觀測站，並揭露於本公司網站 <a href="https://www.csun.com.tw/category">https://www.csun.com.tw/category</a>
<b>五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無。</b>			
<b>六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）：</b>			
1. 本公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法、上市上櫃相關規章或其自身或其代表之法人有利害關係，致有害公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論或表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。			
3. 本公司訂有「防範內線交易管理作業」，明訂董事、監察人、經理人及受僱人不得洩漏所知悉之內部重大資訊與他人，不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊，對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向其他人洩漏。			
4. 本公司簽證會計師事務所為資誠聯合會計師事務所，該會計師並未擔任本公司董事，兼具專業及獨立性，本公司每年皆會審查會計師之獨立性；會計師定期查核各大循環及內部控制，對本公司內部控制及會計處理事項建議。			

**(八)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：**

本公司於公司網站投資人專區揭露。

**(九)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：**

志聖致力於營運資訊透明化、即時化，進而為股東創造最大投資利益，且一直是志聖基本經營理念，本公司公司治理情形如下：

1. 董事會成員包含三位具多年產業經驗之獨立董事。
2. 專業獨立董事定期參與決策機制(每三個月例行召開一～兩次董事會)
3. 定期委託會計師查核兩岸營運機制。
4. 會計師定期參與董事會，扮演監督及諮詢的角色。
5. 公司網站設立投資人專區並定期更新，讓公司之所有股東有統一且公平的管道獲取公司即時資訊。
6. 建立專業董事諮詢制度。

## (十) 內部控制制度執行狀況：

1. 內部控制聲明書：

志聖工業股份有限公司  
內部控制制度聲明書

日期：民國 114 年 2 月 25 日

本公司民國 113 年度之內部控制制度，依據自行檢查的結果，謹聲明如下：

一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率（含獲利、績效及保障資產安全等）、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成，提供合理的確保。

二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。

三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環境，2 風險評估及回應，3. 控制作業，4. 資訊及溝通，及 5. 監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。

四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。

五、本公司基於前項檢查結果，認為本公司於民國 113 年 12 月 31 日的內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。

六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。

七、本聲明書業經本公司民國 114 年 2 月 25 日董事會通過，出席董事七人中均同意本聲明書之內容，併此聲明。

志聖工業股份有限公司

董事長：梁茂生



總經理：梁又文



2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

### (十一) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

#### (1) 董事會之重要決議：

日期	會議名稱	內容
113.03.05	第十八屆第十二次董事會	<ol style="list-style-type: none"><li>擬通過民國 112 年度財務報告及合併報表暨會計師與公司治理單位溝通事項。</li><li>擬提請通過 113 年簽證會計師委任及報酬案。</li><li>本公司截至 112 年 12 月 31 日止之逾期應收帳款非屬資金貸與性質案，提請審議。</li><li>擬通過民國 112 內部控制制度有效性考核及聲明書。</li><li>擬通過民國 112 年營業報告書。</li><li>擬通過民國 112 年度盈餘分配案。</li><li>擬通過民國 112 年度盈餘轉增資發行新股票案。</li><li>擬與銀行及票券金融公司，取得融資及從事與資產、利率、匯率、指數或其他利益等商品所衍生之交易契約。</li><li>本公司民國 112 年度董事酬勞及員工酬勞總數案。</li><li>修訂「112 年第 1 次買回股份轉讓員工辦法」案。</li><li>擬提請通過本公司庫藏股轉讓經理人及員工案，提請公決。</li><li>擬發行限制員工權利新股予員工案。</li><li>擬通過民國 113 年股東會時間、地點、議程、受理股東提案期限。</li></ol>
113.05.09	第十八屆第十三次董事會	<ol style="list-style-type: none"><li>擬通過民國 113 年度第一季財務報告及合併報表暨會計師與公司治理單位溝通事項。</li><li>本公司截至 113 年 3 月 31 日止之逾期應收帳款非屬資金貸與性質案，提請審議。</li><li>擬與銀行及票券金融公司，取得融資及從事與資產、利率、匯率、指數或其他利益等商品所衍生之交易契約。</li><li>擬提請通過訂定本公司 112 年度現金配息基準日相關事宜。</li><li>投資宏騰實業（股）公司案。</li><li>本公司 2023 年董事酬勞分配內容案</li><li>本公司 2024 年調薪擬議案，提請審議。</li></ol>
113.08.01	第十八屆第十四次董事會	<ol style="list-style-type: none"><li>擬通過民國 113 年度第二季財務報告及合併報表暨會計師與公司治理單位溝通事項。</li><li>本公司截至 113 年 6 月 30 日止之逾期應收帳款非屬資金貸與性質案，提請 審議。</li><li>本公司訂定「永續報告書編制與申報管理辦法」案。</li><li>本公司 2024 永續報告書執行成果，報請核備。</li><li>擬與銀行及票券金融公司，取得融資及從事與資產、利率、匯率、指數或其他利益等商品所衍生之交易契約。</li><li>擬請同意捐贈予國立台灣大學案，提請 討論。</li><li>擬請同意捐贈予國立臺灣大學醫學院附設醫院案，提請 討論。</li><li>擬請同意支持（捐贈）國內文化產業活動案，提請 討論。</li><li>擬請同意泰國子公司購置辦公室案，提請 討論。</li><li>修訂「112 年第 1 次買回股份轉讓員工辦法」案。</li><li>本公司 2024 年經理人調薪擬議案，提請審議。</li><li>本公司 2024 年經理人獎酬擬議案，提請審議。</li><li>擬提請通過本公司庫藏股轉讓經理人及員工案，提請 公決。</li></ol>

日期	會議名稱	內容
113.10.31	第十八屆第十五次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>擬通過民國 113 年度第三季財務報告及合併報表暨會計師與公司治理單位溝通事項。</li> <li>本公司截至 113 年 9 月 30 日止之逾期應收帳款非屬資金貸與性質案。</li> <li>擬與銀行及票券金融公司，取得融資及從事與資產、利率、匯率、指數或其他利益等商品所衍生之交易契約。</li> <li>修訂本公司「關係人交易作業程序」案。</li> <li>修訂本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」案。</li> <li>訂定本公司「風險管理政策與程序」案。</li> <li>投資案。</li> <li>擬請同意授權購買工一工業區土地案。</li> <li>本公司 113 年第一次買回本公司股份案。</li> <li>本公司 2024 年經理人獎酬擬議案。</li> <li>擬提請通過本公司庫藏股轉讓經理人及員工案。</li> </ol>
113.12.17	第十八屆第十六次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>2025 年年度稽核計畫，提請通過。</li> <li>2025 年年度計畫，提請通過。</li> <li>背書保證案。</li> <li>現任會計師獨立性及適任性評估案。</li> <li>擬與銀行及票券金融公司，取得融資及從事與資產、利率、匯率、指數或其他利益等商品所衍生之交易契約。</li> <li>訂定本公司「永續資訊管理作業辦法」案。</li> <li>修訂本公司「112 年第 1 次買回股份轉讓員工辦法」案。</li> <li>訂定本公司「113 年第 1 次買回股份轉讓員工辦法」案。</li> <li>定義本公司基層員工案。</li> <li>修訂「公司章程」案</li> <li>本公司經理人 2024 年績效評估結果及年終總所得內容案。</li> <li>擬提請通過本公司庫藏股轉讓經理人及員工案。</li> </ol>
114.1.12	第十八屆第十七次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>本公司擬解除經理人競業禁止之限制案</li> </ol>
114.2.25	第十八屆第十八次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>擬通過民國 113 年度財務報告及合併報表暨會計師與公司治理單位溝通事項。</li> <li>本公司截至 112 年 12 月 31 日止之逾期應收帳款非屬資金貸與性質案，提請審議。</li> <li>擬通過民國 113 內部控制制度有效性考核及聲明書。</li> <li>擬通過民國 113 年營業報告書。</li> <li>擬通過民國 113 年度盈餘分配案。</li> <li>擬通過民國 112 年度盈餘轉增資發行新股票。</li> <li>取得不動產案。</li> <li>子公司志聖科技廣州有限公司取得不動產案</li> <li>擬與銀行及票券金融公司，取得融資及從事與資產、利率、匯率、指數或其他利益等商品所衍生之交易契約。</li> <li>投資案</li> <li>本公司民國 113 年度董事酬勞及員工酬勞總數案。</li> <li>擬提請通過本公司庫藏股轉讓經理人及員工案，提請公決。</li> <li>擬發行限制員工權利新股予員工案。</li> <li>第十九屆董事、獨董選舉案</li> <li>擬通過民國 113 年股東會時間、地點、議程、受理股東提案期限。</li> </ol>

(2) 民國 113 年 5 月 21 日股東常會重要決議內容及執行情形：

重要決議：

1. 通過民國一一二年度決算表冊。
2. 通過民國一一二年度盈餘分配案。
3. 通過發行限制員工權利新股予員工案。
4. 解除董事競業禁止之限制案

執行情形：

113 年 5 月 9 日董事會訂定 113 年 6 月 5 日為除息除權基準日，發放現金（每股 3 元），於 113 年 6 月 21 日發放現金予股東，分派金額與股東常會決議無差異。

（十二）最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者，其主要內容：無。

### 三、簽證會計師公費資訊：

單位：新臺幣 / 仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
資誠聯合會計師事務所	李典易 吳偉豪	113.1.1 ~ 113.12.31	2,500	330	2,830	合併及個體財務報表 英文財報翻譯 移轉訂價

請具體敘明非審計公費服務內容：(例如稅務簽證、確信或其他財務諮詢顧問服務)

註：本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者，應請分別列示查核期間，及於備註欄說明更換原因，並依序揭露所支付之審計與非審計公費等資訊。非審計公費並應附註說明其服務內容。

- (一) 給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費占審計公費之比例達四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容：不適用。
- (二) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：不適用。
- (三) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：不適用。

### 四、更換會計師資訊：無此情形。

五、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無。

六、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形：請詳公開資訊觀測站內之『董事、監察人、經理人及大股東持股餘額彙總表』。

**七、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：**

114年3月29日(停止過戶日)

單位：股；%

姓名 (註1)	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。 (註3)		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱	關係	
均豪精密工業股份有限公司	19,957,082	12.73%	—	—	—	—	—	—	—
海杏投資(股)公司 代表人：傅梁秀鴻	17,727,743	11.31%	—	—	—	—	梁茂生 梁茂忠	負責人 為姊弟	—
	843,714	0.54%	—	—	—	—	梁茂生 梁茂忠	負責人 為姊弟	—
品志投資(股)公司 代表人：梁碧茹	12,300,560	7.85%	—	—	—	—	梁茂生	負責人 為子女	—
	1,348,393	0.86%	—	—	—	—	梁茂生	負責人 為子女	—
梁茂忠	7,292,949	4.65%	1,137,260	0.73%	—	—	梁茂生 海杏投資 (股)公司	兄弟	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
志聖工業股份有限公司庫藏股專戶	5,981,549	3.82%	—	—	—	—	—	負責人 為姊弟	—
梁茂生	4,577,866	2.92%	346,222	0.22%	—	—	梁茂忠 海杏投資 (股)公司	兄弟 負責人 為兄妹	—
							品志投資 (股)公司	負責人 為子女	—
花旗託管挪威中央銀行投資專戶	3,669,000	2.34%	—	—	—	—	—	—	—
簡進土	2,800,155	1.79%	—	—	—	—	—	—	—
朕昇(股)公司 代表人：梁碧真	1,928,237	1.23%	—	—	—	—	梁茂忠	負責人 為子女	—
	—	—	—	—	—	—	梁茂忠	負責人 為子女	—
梁又文	1,922,647	1.23%	—	—	—	—	梁茂生	子女	—
渣打託管 SPDR 組合 新興市場 ETF 專戶	1,619,139	1.03%	—	—	—	—	—	—	—

註1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

註2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。

註3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

**八、公司、公司董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例：**

**綜合持股比例**

113 年 12 月 31 日

單位：股；%

轉投資事業（註 1）	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
C SUN(B.V.I.) LTD.	18,081,750	100.00%	—	—	18,081,750	100.00%
志聖科技（廣州）有限公司（註 2）	—	100.00%	—	—	—	100.00%
蘇州創峰光電科技有限公司（註 2）	—	77.47%	—	—	—	77.47%
K SUN (SAMOA) LTD.	2,312,160	100.00%	—	—	2,312,160	100.00%
宏騰實業股份有限公司	700,000	70.00%	—	—	700,000	70.00%
樂林科技股份有限公司	1,000,000	50.00%	—	—	1,000,000	50.00%
CSUN EQUIPCARE & TRADE (THAILAND) CO., LTD.	10,000	100.00%	—	—	10,000	100.00%

註 1：係公司採用權益法之長期投資。

註 2：透過第三地區投資設立公司，再投資大陸公司。

## 參、募資情形

### 一、公司資本及股份

#### (一) 股本與來源：

#### 股本來源

114年3月29日(停止過戶日)

單位：股

年月	發行價格	核定股本		實收股本		股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	備註
		股數	金額	股數	金額			
67.04	10	300,000	3,000,000	300,000	3,000,000	創立	無	—
73.05	10	600,000	6,000,000	600,000	6,000,000	現金增資 3,000 仟元	無	—
74.07	10	1,500,000	15,000,000	1,500,000	15,000,000	現金增資 9,000 仟元	無	—
83.10	10	4,000,000	40,000,000	4,000,000	40,000,000	現金增資 25,000 仟元	無	—
84.10	10	6,000,000	60,000,000	6,000,000	60,000,000	現金增資 20,000 仟元	無	—
85.11	10	8,500,000	85,000,000	8,500,000	85,000,000	現金增資 25,000 仟元	無	—
86.07	10	30,000,000	300,000,000	17,300,000	173,000,000	現金增資 33,000 仟元 盈餘轉增資 25,000 仟元 資本公積轉增資 30,000 仟元	無	86.11.4(86) 台 財 證 (一) 第 79879 號函
87.07	10	30,000,000	300,000,000	25,900,000	259,000,000	現金增資 49,260 仟元 盈餘轉增資 36,740 仟元	無	87.6.5(87) 台 財 證 (一) 第 48830 號函
88.06	10	30,600,000	306,000,000	30,600,000	306,000,000	盈餘轉增資 47,000 仟元	無	88.6.10(88) 台 財 證 (一) 第 53483 號函
89.05	10	88,600,000	886,000,000	46,700,000	467,000,000	現金增資 91,000 仟元 盈餘轉增資 70,000 仟元	無	89.5.23(89) 台 財 證 (一) 第 42313 號函、 89.5.16(89) 台 財 證 (一) 第 42314 號函
90.05	10	101,300,000	1,013,000,000	60,280,000	602,800,000	盈餘轉增資 135,800 仟元	無	90.5.25(90) 台 財 證 (一) 第 132351 號函
91.06	10	101,300,000	1,013,000,000	76,493,000	764,930,000	盈餘轉增資 101,850 仟元 資本公積轉增資 60,280 仟元	無	91.6.18(91) 台 財 證 (一) 第 0910132850 號函
92.08	10	101,300,000	1,013,000,000	81,395,500	813,955,000	盈餘轉增資 33,726.4 仟元 資本公積轉增資 15,298.6 仟元	無	92.8.2.8(92) 台 財 證 (一) 第 09201253670 號函
93.07	10	121,300,000	1,213,000,000	89,915,000	899,150,000	盈餘轉增資 52,636.8 仟元 資本公積轉增資 32,558.2 仟元	無	93.7.14(93) 金 管 證 (一) 第 0930131353 號函
94.07	10	121,300,000	1,213,000,000	93,729,908	937,299,080	合併現金增資 38,149.08 仟元	無	94.7.21(94) 金 管 證 (一) 第 0940125887 號函
94.09	10	134,700,000	1,347,000,000	102,482,700	1,024,827,000	盈餘轉增資 81,271 仟元 資本公積轉增資 6,256.92 仟元	無	94.9.9(94) 金 管 證 (一) 第 0940137840 號函
95.01	10	134,700,000	1,347,000,000	103,292,700	1,032,927,000	員工認股權憑證換發新股 8,100 仟元	無	95.1.25 經 授 商 字 第 09501012510 號函
95.05	10	134,700,000	1,347,000,000	103,627,700	1,036,277,000	員工認股權憑證換發新股 3,350 仟元	無	95.5.17 經 授 商 字 第 09501089280 號函
95.08	10	200,000,000	2,000,000,000	115,959,700	1,159,597,000	盈餘轉增資 107,670 仟元 資本公積轉增資 14,000 仟元 員工認股權憑證換發新股 1,650 仟元	無	95.8.18 經 授 商 字 第 09501176280 號函

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額		以現金以外之財產抵充股款者	
95.11	10	200,000,000	2,000,000,000	116,124,700	1,161,247,000	員工認股權憑證換發新股 1,650仟元	無	95.11.13 經授商字第 09501251590號函
96.03	10	200,000,000	2,000,000,000	129,106,561	1,291,065,610	合併現金增資 129,268.61 仟 元暨員工認股權憑證換發新股 550仟元	無	96.03.06 經授商字第 09601035250號函
96.05	10	200,000,000	2,000,000,000	129,106,561	1,291,715,610	員工認股權憑證換發新股 650仟元	無	96.05.09 經授商字第 09601100380號函
96.09	10	200,000,000	2,000,000,000	134,998,361	1,349,983,610	資本公積轉增資 58,268 仟元	無	96.09.03 經授商字第 09601215250號函
96.11	10	200,000,000	2,000,000,000	135,123,361	1,351,233,610	員工認股權憑證換發新股 1,250仟元	無	96.11.16 經授商字第 09601280890號函
97.03	10	200,000,000	2,000,000,000	135,128,361	1,351,283,610	員工認股權憑證換發新 50 仟 元	無	97.03.06 經授商字第 09701055510號函
97.07	10	200,000,000	2,000,000,000	135,287,361	1,352,873,610	員工認股權憑證換發新 1,590 仟元	無	97.07.02 經授商字第 09701156110號函
97.09	10	200,000,000	2,000,000,000	139,762,861	1,397,628,610	盈餘轉增資 44,755 仟元	無	97.09.24 經授商字第 09701246900號函
98.07	10	200,000,000	2,000,000,000	139,792,861	1,397,928,610	員工認股權憑證換發新股 300仟元	無	98.07.13 經授商字第 09801140360號函
98.08	10	200,000,000	2,000,000,000	143,661,610	1,436,616,100	盈餘轉增資 38,687 仟元	無	98.08.20 經授商字第 09801189850號
99.02	10	200,000,000	2,000,000,000	143,707,610	1,437,076,100	員工認股權憑證換發新股 460仟元	無	99.02.05 經授商字第 09901026100號
99.05	10	200,000,000	2,000,000,000	146,711,620	1,467,116,200	員工認股權憑證換發新股 8,450仟元：公司債轉換股份 21,590.1 仟元	無	99.05.07 經授商字第 09901092890號
99.09	10	200,000,000	2,000,000,000	150,107,558	1,501,075,580	員工認股權憑證換發新股 7,640 仟元：公司債轉換股份 26,319.38 仟元	無	99.09.02 經授商字第 09901199890號
99.11	10	200,000,000	2,000,000,000	151,184,208	1,511,842,080	員工認股權憑證換發新股 4,510 仟元：公司債轉換股份 32,986.5 仟元；註銷庫藏 26,730 股仟元	無	99.11.09 經授商字第 09901251530號
100.03	10	200,000,000	2,000,000,000	152,338,304	1,523,383,040	員工認股權憑證換發新股 4,855 仟元：公司債轉換股份 6,685.96 仟元	無	100.03.08 經授商字第 10001044350號
100.05	10	200,000,000	2,000,000,000	153,056,510	1,530,565,100	員工認股權憑證換發新股 3,185 仟元：公司債轉換股份 3,997.06 仟元	無	100.05.13 經授商字第 10001096720號
100.09	10	200,000,000	2,000,000,000	155,152,820	1,551,528,200	員工認股權憑證換發新股 905 仟元：公司債轉換股份 20,058.10 仟元	無	100.09.08 經授商字第 10001208720號
100.11	10	200,000,000	2,000,000,000	156,045,219	1,560,452,190	員工認股權憑證換發新股 2,200 仟元：公司債轉換股份 6,723.99 仟元	無	100.11.02 經授商字第 10001252220號
101.03	10	200,000,000	2,000,000,000	156,129,130	1,561,291,300	員工認股權憑證換發新股 370 仟元：公司債轉換股份 469.11 仟元	無	101.03.21 經授商字第 10101048670號
101.06	10	200,000,000	2,000,000,000	158,224,515	1,582,245,150	公司債轉換股份 20,953.85 仟 元	無	101.6.08 經授商字第 10101105390號

年月	發行價格	核定股本		實收股本		股本來源	備註	
		股數	金額	股數	金額		以現金以外之財產抵充股款者	其他
101.10	10	200,000,000	2,000,000,000	158,744,548	1,587,445,480	公司債轉換股份 5,200.33 仟元	無	101.10.31 經授商字第 10101226550 號
108.04	10	200,000,000	2,000,000,000	149,205,548	1,492,055,480	公司庫藏股註銷 95,390 仟元	無	108.4.23 經授商字第 10801042370 號
110.08	10	200,000,000	2,000,000,000	152,189,659	1,521,896,590	盈餘轉增資 29,841 仟元	無	110.8.30 經授商字第 11001149340 號
111.08	10	200,000,000	2,000,000,000	156,755,348	1,567,553,480	盈餘轉增資 45,657 仟元	無	111.8.02 經授商字第 11101144060 號

## (二) 資本及股份

114 年 3 月 29 日 (停止過戶日)

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
記名式普通股	156,755,348 股	43,244,652 股	200,000,000 股	

## (三) 總括申報制度相關資訊：不適用。

## (四) 主要股東名單

### 主要股東名單

114 年 3 月 29 日 (停止過戶日)

主要 股東名稱	股份	持有股數	持股比例 (%)
均豪精密工業股份有限公司		19,957,082	12.73%
海杏投資股份有限公司		17,727,743	11.31%
品志投資股份有限公司		12,300,560	7.85%
梁茂忠		7,292,949	4.65%
志聖工業股份有限公司庫藏股專戶		5,981,549	3.82%
梁茂生		4,577,866	2.92%
花旗託管挪威中央銀行投資專戶		3,669,000	2.34%
簡進土		2,800,155	1.79%
朕昇(股)有限公司		1,928,237	1.23%
梁又文		1,922,647	1.23%
渣打託管 SPDR 組合新興市場 ETF 專戶		1,619,139	1.03%

## (五)公司股利政策及執行狀況：

### (1) 股利政策：

- 公司章程第三十一條：

本公司年度如有獲利，應提撥 1%~9% 為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不超過 2.25% 為董監酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

本公司年度決算如有盈餘：

- 一、依法繳納稅捐，
- 二、彌補累積虧損後，

三、再提 10% 為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，

四、其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；

如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會視公司營運情況酌予保留部份後擬具分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。並依公司章程第三十一條之一本公司股利政策。

本公司依法授權董事會得以特別決議，將應分派股息及紅利之全部或一部以發放現金之方式為之，並報告股東會，不適用前項應經股東會決議之規定。

本公司得依法令規定分派法定盈餘公積及資本公積，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議分派之；以現金方式為之時，應經董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過二分之一決議，並報告股東會。

- 公司章程第三十一條之一：股利政策

本公司考量公司所處環境及成長情形，因應未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金之需求，就前條股東股利中現金股利不低於百分之 20。

本公司章程未明訂股東股息紅利之分派比率，考量公司資金需求、長期財務規劃等因素及兼顧股東利益，本公司對股東股息紅利之提撥以不低於當年度本期稅後淨利之百分之二十為基礎。

(2) 本次董事會決議股利分配之情形：

本公司民國 114 年 2 月 25 日董事會中決議 113 年度盈餘分配案如下表所示。

**志聖工業股份有限公司**  
**盈餘分配表**  
**中華民國 113 年度**

單位：新台幣 元

	金額	
	小計	合計
<b>期初未分配盈餘</b>		<b>348,646,504</b>
本年度稅後淨利		<b>719,159,532</b>
<b>未經損益項目之保留盈餘調整項：</b>		<b>4,881,813</b>
精算損益列入保留盈餘	14,136,228	
處分透過其他綜合損益按公允價值逢良知權益工具	47,033,106	
採用權益法認列之關聯企業之變動數	(56,287,521)	
<b>本年度稅後淨利加計本期淨利以外項目計入當年度 未分配之數額</b>		<b>724,041,345</b>
<b>減：提列法定盈餘公積 10%</b>		<b>72,404,135</b>
<b>可供分配盈餘</b>		<b>1,000,283,714</b>
<b>分配項目：</b>		
股東紅利—現金（每股配發 5 元）		<b>753,868,995</b>
<b>期末未分配盈餘</b>		<b>246,414,719</b>

**(六) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：**  
無此情形。

**(七) 員工酬勞及董事酬勞**

1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

本公司年度如有獲利，應提撥 1%~9% 為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不超過 2.25% 為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。

2. 本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

本年度以當年度獲利狀況(即稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)扣除累積虧損為基礎，依公司章程所定之成數範圍內，估列員工酬勞及董事酬勞，並列報為營業成本或營業費用，其中員工酬勞以股票發放者，係依董事會決議前一日之普通股收盤價計算配發股數。如上述估列金額與實際發放金額有差異時，則依會計估計變動處理，並於發放年度調整入帳。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

(1) 以現金或股票分派之員工現酬勞及董事、監察人酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

本公司自 113 年度盈餘中，提撥員工酬勞 1% 計新台幣 8,674,754 元及董事酬勞 2.25% 計新台幣 19,518,196 元；於民國 114 年 2 月 25 日經董事會決議通過，並以現金方式發放，其與 113 年度認列費用無差異。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：

無。

4. 前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

項目	實際發放數	估計數	差異數
員工酬勞	5,191,150	5,191,150	0
董事酬勞	11,680,087	11,680,087	0
合計	16,871,237	16,871,237	0

(八) 公司買回本公司股份情形：

114 年 3 月 29 日 (停止過戶日)

買回期次	第十一次
買回目的	轉讓股份予員工
買回期間	113/11/04~113/12/16
買回區間價格	146.00~331.00
已買回股份種類及數量	普通股 803,000 股
已買回股份金額	184,634,115 元
已買回數量占預定買回數量之比率	80.30%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	普通股 0 股
累積持有本公司股份數量	5,981,549 股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率	3.82%

## **二、公司債 / 特別股 / 海外存託憑證辦理情形：**

- (一) 公司債辦理情形：無。
- (二) 特別股 / 海外存託憑證辦理情形：無。

## **三、員工認股權憑證辦理情形：**

- (一) 尚未屆期之員工認股權憑證辦理情形及對股東權益之影響：無。
- (二) 取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大且得認購金額達新臺幣三仟萬元以上員工之姓名、取得及認購情形：無。

## **四、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形**

- (一) 最近年度及截至年報刊印日止已完成併購或受讓他公司股份發行新股者：無。
- (二) 最近年度及截至年報刊印日止已經董事會決議通過併購或受讓他公司股份發行新股者：無。

## **五、資金運用計劃執行情形**

- (一) 計畫內容：  
前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現，應詳細說明前開各次發行或私募有價證券計畫內容：無。
- (二) 執行情形：  
前款各次計畫之用途，逐項分析截至年報刊印日之前一季止，其執行情形及與原預計效益之比較：無。

## 肆、營運概況

### 一、業務內容

#### 1. 業務範圍：

##### (1) 所營業務之主要內容：

- A. AI 相關電子印刷電路板產業供應鏈相關之去水、烘乾、固化、成型、除泡、退火、測試燒機解熱、貼膜、壓合、整平，相關製程設備之製造。銷售水平與垂直除膠渣、化學銅設備，及水平顯像、蝕刻、光阻剝離等各類水平濕製程設備。
- B. 提供 AI 晶片所需之半導體先進封裝 (2D, 2.1D, 2.3D, 2.5D, FoPLP, CPO 與 SoIC 3D) 領域、HBM 所需之關鍵設備及配件，包括但不限於：暫時貼合機、晶圓壓膜機、混合鍵結製程設備、各類製程烤箱、測試燒機爐、紫外線乾燥機。紫外線表面清潔機。
- C. 代理國內外廠商前項有關產品之報價投標經銷業務。
- D. E604010 機械安裝業。
- E. CB01990 其他機械製造業（自動化設備）。
- F. CE01030 光學儀器製造。
- G. CB01010 機械製造業。
- H. CC01101 電信管制射頻器材製造業。
- I. F401021 電信管制射頻器材輸入業。
- J. F401010 國際貿易業。
- K. I199990 其他顧問服務業。
- L. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

##### (2) 營業比重：

產品種類	112 年銷貨比例	113 年銷貨比例
半導體製程設備	17%	35%
印刷電路板製程設備	61%	50%
前瞻製程與其他電子應用設備	22%	15%
總計	100%	100%

##### (3) 目前之商品（服務項目）：

志聖工業目前生產之製程設備應用領域主要包括半導體業先進封裝製程、印刷電路板業 (PCB) 與載板前瞻先進製程、其他製程設備三大產業分類，針對各產業製程發展之產品分述如下：

###### a. 半導體先進封裝製程與相關製程設備應用

- 晶圓級乾膜貼合設備、暫時貼合設備、混合鍵結製程設備；

- 自動化烤箱、壓力烤箱、真空烤箱、測試燒機爐、高潔淨度 / 無氧 / 熱風烘烤設備；
- 面板級封裝 (FoPLP) 製程設備系統
- 表面清潔電漿處理設備；電漿深度蝕刻設備 (DRIE、ETCHER)
  
- b. **印刷電路板業 (PCB) 製程、IC 載板製程設備應用**
- 光阻 (乾、濕膜) 製程設備：自動 / 手動壓膜系統、真空壓膜系統、濕膜塗佈系統、剝膜機 (Dry film/ABF)。
- 光固化 / 曝光製程設備：紫外線乾燥設備、內外層 / 乾溼膜 / 防焊製程之手動、半自動及全自動曝光設備、新世代曝光機。
- 热固化製程設備：熱風烘烤設備、連續式乾燥設備、板彎壓平設備、預熱設備、烤箱節能器。
- 濕製程設備：電鍍前處理領域，水平除膠渣化學銅設備、水平化學錫設備。
- 其他：表面改質設備及耗材
  
- c. **前瞻先進製程與其他製程設備**
- 平面顯示器業 (FPD)
  - \* TFT-LCD 製程：Array 段退火烘烤設備、檢查治具、PI 固烤 / 預烤設備、UV 固化設備、熱風烘烤設備、IR 乾燥爐
  - \* TFT-LCM 製程：老化試驗設備、電漿清潔及表面改質設備
  - \* 其他 FPD (Touch Panel / TN / STN)：曝光設備、UV 清洗設備、UV 改質系統、PI 固烤 / 預烤設備、無塵烘烤設備、光阻塗佈設備、大尺寸 Touch Panel 固烤設備
  - \* Mini LED、MicroLED 製程：真空貼合設備、無塵烘烤設備。
  - \* 自動化系統整合軟體
- 其他電子組裝與印刷塗裝業 (Printing & Coating)
  - \* 紫外線乾燥系統、熱風烘烤設備及耗材
  - \* 高頻元件製程設備、AR/VR 製程相關設備、LEO 製程相關設備、鏡頭 Lens 製程相關設備。

#### (4) 計畫開發之新商品（服務）：

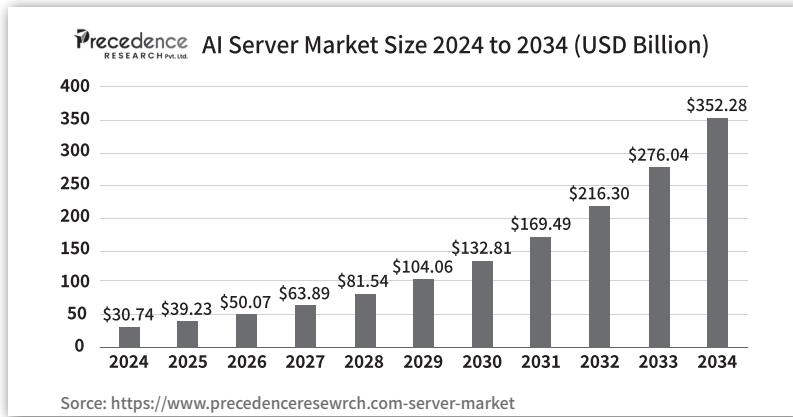
志聖專注 AI 產業供應鏈的技術發展與趨勢前景，延伸在印刷電路板壓膜製程之核心技術，持續發展先進封裝製程中晶圓真空壓膜系統、SoIC 混合鍵合的 3D 封裝製程設備、2.5D 封裝相關如 FoPLP 與 CPO 製程設備、半導體矽晶圓深蝕刻系統及 HBM 相關半導體高階烤箱與壓膜製程設備。因應 HPC、AI 伺服器主板與網路通訊印刷電路板新製程演進、良率提升需求、及大陸勞動成本上升趨勢，志聖積極開發高自動化、高對位精度、高解析度及高節能之黃光室製程設備，包括防焊曝光機、對準機、真空壓膜機、壓膜預熱機、貼片機、軟板 R/R 曝光機、軟板壓膜機等。

#### 2. 產業概況：

##### (1) 產業現況與發展：

過去數十年，半導體製程技術已將電晶體的線寬從數十微米逐步縮小到

納米級別。然而，設計和製造成本的增加、臨界餘裕度的縮小以及其他挑戰，限制了製程技術的進一步發展。同時，隨著晶片內電晶體密度的增加，I/O 接腳數量和晶片間的互連速度面臨限制，使得單純依靠製程微縮難以滿足摩爾定律預期的效能提升，效果有限。因此，半導體行業轉向超越摩爾定律的策略，不再只關注電晶體尺寸和數量，而是包括效能、功耗、晶片面積和成本在內的多個方面。透過 2.5D 和 3D 的異質整合先進封裝製程，多種不同功能的晶片（如邏輯電路、射頻電路、微機電系統、感測器、神經運算單元等）被整合到同一封裝中。這種整合不僅延續了摩爾定律的經濟效益，也推動了半導體產業的持續發展，特別是在與 AI 應用、物聯網和 5G 等技術結合時。在消費電子產品追求更小、更輕、更薄的趨勢下，異質整合技術成為新常態。而隨著 5G、物聯網 (IoT) 與人工智慧 (AI) 時代的到來，高效能與 AI 晶片成為資料中心、深度學習訓練與推理等關鍵技術的硬體架構需求大幅度增加，用以推動重要的應用市場發展。根據研調機構 Precedence 預測全球 AI 伺服器市場規模預計將從 2024 年的 307.4 億美元增長至 2034 年約 3,522.8 億美元，2025 年至 2034 年的年均複合成長率 (CAGR) 達 27.62%。隨著 AI 應用需求的增加、AI 技術的進步、雲端與邊緣運算的發展，以及大數據分析的應用加上具成本效益的解決方案，AI 伺服器的使用日益廣泛，推動市場持續成長。



然而，台灣主要客戶在先進封裝技術領域持續引領業界，致力於推動半導體技術創新，以滿足人工智慧 (AI)、高效能運算 (HPC)、5G 和物聯網 (IoT) 等領域對高效能晶片的需求。隨著傳統單晶片系統 (SoC) 在晶片間傳輸效率與運算性能方面遭遇瓶頸，台灣主要客戶積極推動各類先進封裝技術，透過製程技術與異質整合技術，使不同功能的晶片能夠高效集成，進一步提升系統靈活性、擴展性及晶片間的傳輸效率，以應對市場對高效能與低功耗解決方案的需求。

在 AI 訓練與推理應用日益廣泛的趨勢下，台灣主要客戶的 CoWoS (Chip on Wafer on Substrate) 和 SoIC (System on Integrated Chips) 甚至未來的

FoPLP 製程等先進封裝技術已成為 AI 晶片的首選方案。CoWoS 透過高頻寬記憶體 (HBM) 與 AI 晶片的緊密整合，使數據傳輸效率顯著提升，同時保持低功耗特性，成為現今 AI 晶片的關鍵技術之一。而 SoIC 則進一步推動 3D 堆疊技術的發展，使不同晶片能以極高密度整合，實現更高效能的異質運算架構，為未來 AI 與 HPC 的發展奠定基礎。

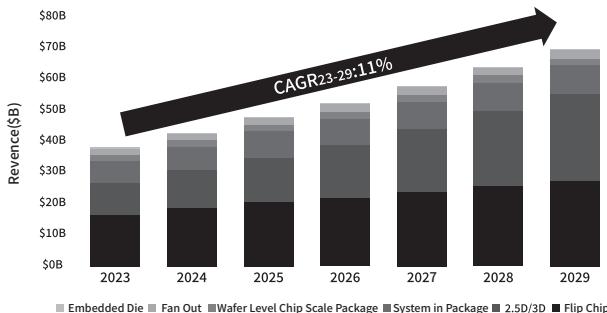
隨著生成式 AI (如 ChatGPT) 的崛起，市場對高效能 AI 晶片的需求激增，直接推動 CoWoS 和 SoIC 相關封裝技術的應用與產能擴張。根據台灣主要客戶近期的法說會說明，為了應對 AI 晶片市場的強勁需求，台灣主要客戶已大幅增加先進封裝的投資，並計劃擴建新產線，以提升 CoWoS 產能，確保能滿足 AI 產業對高效能晶片的需求。此外，客戶也積極發展 N3、N2 製程與先進封裝的協同設計，進一步優化晶片性能與功耗效率。

目前，台灣主要客戶已經宣布擴建 CoWoS 產線，市場預期在 2025 年底，台積電將可能把產能提升至 2024 年的倍數以上，確保 AI 晶片設計公司與雲端服務供應商 (CSP) 能夠獲得足夠的先進封裝產能支持。由於 AI 伺服器市場需求爆發，主要客戶持續投資數十億美元於先進封裝產能擴建，並預計在 2025 年將 CoWoS 產能進一步提升，以支援如 NVIDIA、AMD、Broadcom 等主要 AI 晶片客戶。為此，主要客戶也積極與供應鏈夥伴合作，確保先進封裝材料與設備的穩定供應，以因應市場對 CoWoS 產能的迫切需求。

2024 年 AI 伺服器在 CSP 廠商中的軍備競賽般的佈建與強力需求，驅動 HPC 晶片市場迎來爆發性成長，帶動半導體產業擺脫 2023 年的衰退陰霾，先進封裝市場正經歷重大變革。受美國半導體禁令的影響與新工廠建設、新興 OSAT (封測廠) 崛起及產業聯盟影響，供應鏈動態正在重塑。預計 2023 至 2029 年間，先進封裝市場的年均複合成長率 (CAGR) 達 11%，並於 2029 年達到 695 億美元 (如下圖)。台積電、英特爾與三星等龍頭企業積極推動 Chiplet (小晶片) 與異質整合 (Heterogeneous Integration) 技術，而 ASE (日月光)、Amkor、台積電、英特爾與 JCET (長電科技) 則持續領先市場。2023 年先進封裝產業占全球 IC 封裝市場的 44%，隨著 AI、高效能運算 (HPC)、汽車電子及 AI PC 等需求驅動，其市場占比持續提升。特別是 2.5D/3D 封裝技術的高速成長，帶動 AI 伺服器與 HPC 晶片發展，成為產業競爭的關鍵。成為推動市場增長的主要動力之一。

主要客戶憑藉其完整的晶圓製造與先進封裝解決方案，定義 Foundry 2.0 概念，提供客戶一站式服務，從先進製程技術到先進封裝，全方位滿足 AI、高速運算及數據中心市場的需求。隨著晶片異質整合技術的進步，主要客戶的 CoWoS、SoIC、InFO (Integrated Fan-Out) 等技術將進一步發展，為 AI、HPC 與 5G 市場提供更強大的硬體支撐。此外，主要客戶也正積極開發 2.5D/3D 封裝衍伸技術，如 FoPLP 與 CPO 技術，並透過與全球 AI 晶片設計公司合作，共同推動高效能運算架構的創新。

## 2023-2029 ADVANCED PACKAGING REVENUE FORECAST BY PACKAGING PLATFORM (\$B)

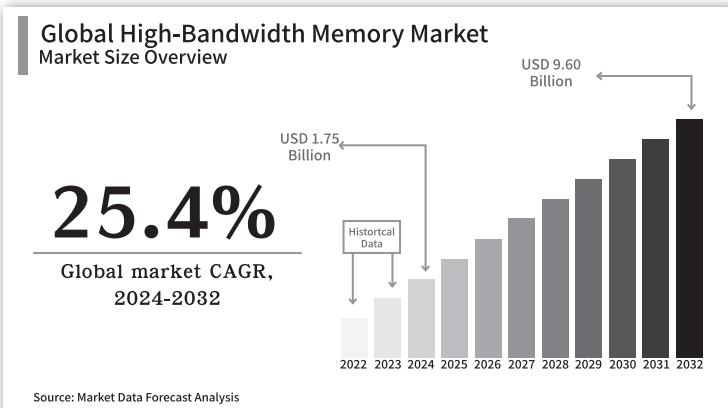


Source: Status of the Advanced Packaging report, Yole Intelligence, 2024

展望未來，隨著主要客戶與 OSAT 廠主導的產業發展進程，不斷優化先進封裝技術並擴展產能，其在全球 AI 晶片供應鏈中的戰略地位將進一步鞏固。未來數年，主要客戶預計將持續擴大 CoWoS 和 SoIC 產能，以應對市場對高效能 AI 晶片的龐大需求，進一步鞏固其在 AI 時代的核心地位。

除此之外，隨著 AI 晶片對高頻寬記憶體（HBM）和半導體先進封裝技術的需求日益增加，我們作為記憶體製造的設備供應商，也面臨前所未有的商機。HBM 技術因其能在較小體積內提供更高的數據傳輸速率和更低的功耗而成為 AI 數據中心的關鍵技術。同時，先進的半導體封裝技術，如美光（Micron）近期與台積電在 HBM4e 產品上展開合作，採用台積電的先進邏輯代工製程技術，為特定客戶客製化基礎晶片，以提升性能與功能。這種客製化方案允許美光在 HBM4e 中整合更多緩存和邏輯，進一步增強 AI、高效能運算（HPC）等應用的數據處理能力。隨著美光與多家客戶共同開發 HBM4e，市場對客製化記憶體解決方案的需求將持續增加，進一步鞏固美光與台積電在高頻寬記憶體市場的競爭優勢。

這種技術進步不僅對終端用戶有利，也為我們提供了巨大的機遇。作為設備供應商，我們有機會開發和銷售支持這些先進技術的製造設備。從精密的矽穿孔（TSV）相關電漿蝕刻設備到專門的 3D 堆疊和封裝製程設備，這些需求推動了對創新半導體製造解決方案的探索。依據 Market Data Forecast 的預估，全球高頻寬記憶體（HBM）市場規模（2024 至 2032 年）全球高頻寬記憶體市場在 2023 年的市場價值為 12.5 億美元，預計在 2024 年將達到 15.7 億美元，並在 2032 年成長至 96 億美元，預測期間的年均複合成長率（CAGR）為 25.4%。



隨著 Micron 與 TSMC 等半導體製造巨頭之間合作加深，我們作為全球領先的半導體設備供應商，看到了與這些企業合作的潛力，以支持他們的先進製程和封裝技術的發展進程。這樣的合規不僅能確保我們的技術符合最新製造標準，也為進一步創新奠定了基礎。在智慧時代，從 PC、智慧手機到 AI 數據中心的所有終端應用都對半導體技術提出更高要求，而 CoWoS、SoIC 等先進封裝技術的發展正是滿足這些需求的關鍵。隨著這些技術的持續進步和應用範圍的擴大，我們預期未來將見證我們製程設備產能的高成長，為公司帶來前所未有的發展機遇。我們的壓膜、貼合、混合鍵結製程設備與各式前瞻製程烤箱不僅支持現今技術需求，也為未來 AI 應用的快速發展提供堅實基礎。隨著 CoWoS 與 SoIC 製程與 HBM 記憶體製程的需求激增，特別是在雲端計算、數據中心和深度學習領域，晶片設計廠商對高效能、高頻寬記憶體的需求將進一步推動我們設備的市場擴張。

## (2) 總體經濟與產業發展趨勢：

### AI 時代的台灣半導體產業：全球經濟與產業趨勢更新

隨著 唐納·川普 (Donald Trump) 在 2024 年美國總統大選中獲勝，全球經濟和貿易政策正在進入新的調整期。川普政府預期將延續其「美國優先 (America First)」的政策，並可能強化對中國的科技限制與關稅措施，加速全球供應鏈重組。此外，減稅與基礎設施投資計畫可能推動美國經濟成長，但也可能帶來通膨壓力與財政赤字擴大。這些變化將直接影響台灣的半導體產業，特別是在中美科技戰持續升級的情況下，台灣企業將面臨更複雜的市場環境與機會。

具體來說，川普政府可能採取以下幾項政策，影響全球半導體與 AI 產業：

#### 1. 強化對中國的半導體與 AI 技術封鎖：

- 美國商務部可能擴大對中國 AI 晶片與高階運算設備的出口管制，包括更嚴格的技術轉移限制和對 NVIDIA、AMD、Intel 等美國企業對華出貨的額外審查。
- 加強對中國半導體產業的圍堵，可能阻止 ASML、台積電等企業

向中國供應最先進製程（3nm 及以下）技術。這將進一步推動中國尋求半導體自給自足，但短期內也將增加對台灣、日本、韓國晶片的依賴。

2. 促進美國本土半導體製造與供應鏈回流：

- 川普已表示，他的政府將擴大《晶片法案》(CHIPS Act) 補助，吸引更多台積電、三星、Intel 在美國建立晶圓廠。
- 可能對進口半導體與電子產品加徵額外關稅，影響台灣企業出口美國市場的成本。

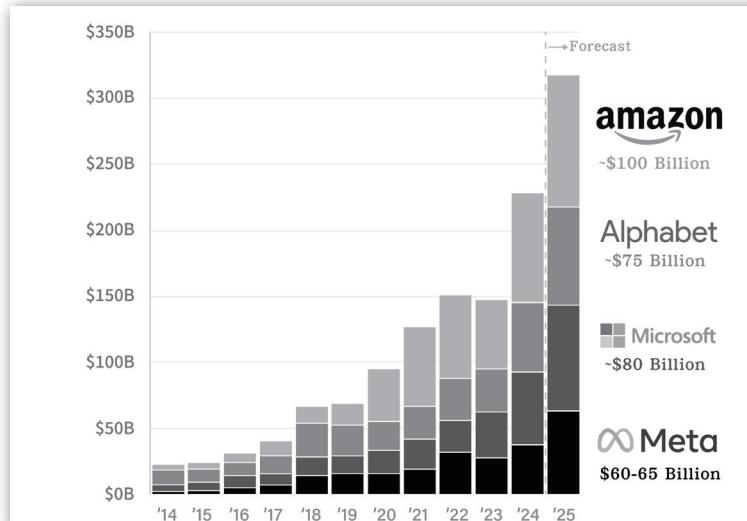
3. 推動美國科技業的大規模減稅與基礎設施投資：

- 預計將減少企業所得稅，激勵 Amazon、Google、Microsoft、Meta 等科技巨頭增加 AI 資本支出 (CapEx)，進一步拉動 AI 伺服器與半導體需求。
- 可能推動新一輪 5G/6G、雲端數據中心、軍事科技、低軌衛星 等基礎設施計畫，帶動對高效能運算 (HPC) 晶片與 AI 晶片的需求。

整體而言，川普的政策可能帶來全球科技產業的分裂，美中科技戰升級將迫使企業重新調整供應鏈，而美國 AI 產業的發展則可能進一步加速台灣半導體業的成長。

### 超大規模雲端服務商 (Hyperscalers) 資本支出激增與產業展望

如果說 2024 年是 AI 需求爆發的開端，那麼 2025 年將是全球科技巨頭全面開啟投資洪流的一年。超大規模雲端服務商 (CSPs) ——Amazon AWS、Google、Microsoft、Meta——正大幅提升資本支出 (CapEx)，擴展 AI 基礎設施。這些公司的投資計畫規模驚人，將對全球半導體產業（特別是台灣，作為關鍵硬體供應商）產生深遠影響。



根據主要 CSP 公司法說資訊報告（如上圖），這四家科技巨頭在 2025 年的 AI 數據中心與技術投資總額將達到 3,200 億美元，相比 2024 年約 2,300 億美元的支出有大幅增長，這標誌著一場激烈的「AI 軍備競賽」，各家公司都在積極部署更多伺服器、加速器與網路基礎設施，以支撐全球 AI 服務的需求。從各公司已公布的資本支出計畫來看，這波投資趨勢影響範圍極為廣泛：

- Amazon：預計 2025 年資本支出約 1,000 億美元，較 2024 年的 830 億美元增長。Amazon 表示，其 90% 的資本支出將用於 AWS 數據中心，其中大部分資金將投入 AI 設備及基礎設施建設。這意味著 Amazon 幾乎將投入 AWS 全年營收等值的資本，用於擴大雲端運算能力，包括採購數萬顆 GPU 以及建設新的區域數據中心。
- Google (Alphabet)：預計 2025 年資本支出 750 億美元，比 2024 年的 525 億美元大幅增加。Google 執行長表示，公司必須應對「需求超過現有產能」的情況，在 2024 年 AI 基礎設施供應短缺後，Google 正全力擴大產能。正在建設 11 個新的數據中心區域，並安裝高效能 AI 系統（包括 Google 自家的 TPU AI 加速器，這些晶片由台積電 (TSMC) 代工製造），以滿足 AI 運算需求。
- Microsoft：計劃在 2025 財年（主要為 2025 年）投入 800 億美元用於 AI 數據中心建設。這比 2023 年約 530 億美元的支出大幅成長，反映出 Microsoft 全面投入 AI 的策略（透過與 OpenAI 的合作以及 Azure AI 服務的擴展）。超過一半的投資將用於美國，但全球數據中心擴張也在同步進行。Microsoft 正加速擴充 AI 訓練與推理基礎設施，這意味著將訂購大量 NVIDIA GPU，並可能進一步開發自家 AI 晶片（傳聞中的 Athena GPU 以及已公布的 NPU），這些晶片同樣可能由台積電或其他晶圓代工廠生產。
- Meta (Facebook)：雖然官方未公布具體數字，但 2025 年的資本支出預計將顯著高於 2024 年的 300 億美元。這 3,200 億美元的總投資預測已包括 Meta 的支出增長。Meta 正在大規模建置 GPU 伺服器農場，用於推薦系統與 AI 研究，並開發自家 AI 晶片 MTIA (Meta Training and Inference Accelerator)，這顆推理晶片採用台積電 7nm 製程代工生產，以提升 AI 計算效率。

### AI 時代的台灣半導體產業：帶動需求激增與 NVIDIA 的影響

生成式 AI 的崛起正在深刻改變半導體需求。自從大型 AI 模型（如 ChatGPT）問世以來，全球雲端運算業者（hyperscalers）爭相部署更多 AI 伺服器，導致對高效能晶片的需求激增。台灣的晶圓代工廠正處於這波熱潮的核心——台積電 (TSMC) 2024 年來自 AI 加速器的營收已經成長三倍，並預計 2025 年將再翻倍。這波成長主要來自 NVIDIA，因為其 GPU 駕馭了全球大部分的 AI 訓練集群。事實上，NVIDIA 的最新 AI 晶片正以「台積電能生產的最快速度」銷售，這凸顯了市場需求遠超過產能，使得先進封裝成為生產瓶頸。

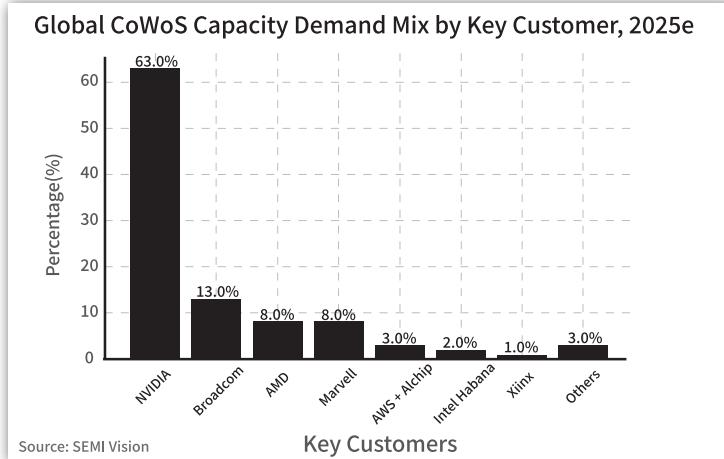
NVIDIA 在市場上的影響力幾乎無可匹敵。該公司已經預訂了台積電 2025 年超過 70% 的先進封裝產能，以滿足其下一代 Blackwell GPU 的需

求。這些 AI 晶片的出貨量預計每季增長 20%，全年總出貨量預計突破 200 萬顆。到了 2025 年中，Blackwell GPU 將取代現有的 Hopper (H100) 系列，顯示 NVIDIA 為滿足 AI 需求而保持極快的產品更新速度。每一代 GPU 都帶來指數級的效能提升——過去十年間，AI 運算能力已提升 1000 倍，這進一步刺激了新應用的發展，推動更多需求的產生。產品線的轉換將持續調整，但目前的總產能並未縮減，反而正在轉向更先進的封裝技術，如 CoWoS-L 或 CoWoS-R 演進，並積極提升整體產能，以滿足訂單需求。簡而言之，這場 AI 黃金熱潮已讓 NVIDIA 成為全球最主要的高階晶片需求方，而其龐大的訂單正在塑造台灣半導體製造商的發展藍圖與投資計畫。這波由 AI 引領的成長並非短暫的需求高峰，而是多年的結構性成長週期。台積電 (TSMC) 執行長魏哲家 (C.C. Wei) 預計，未來五年內，AI 相關需求將以約 45% 的年均複合成長率 (CAGR) 增長，遠超過整體半導體產業的增長速度。

大規模的政府與產業投資進一步支持了這波 AI 長期成長趨勢。例如，美國正在推動「Stargate 計畫」——這是一項由私人企業主導，投資高達 5,000 億美元的 AI 基礎設施計畫。這類投資案將進一步推動對高階晶片的需求。在這場 AI 革命中，台灣——特別是以台積電為首的半導體產業——正競相擴展產能，以抓住這場產業變革帶來的龐大機遇。

### 先進封裝技術創新：CoWoS 與 3D 堆疊

滿足 AI 需求不僅需要更多晶圓產能，晶片封裝技術的突破同樣至關重要。當前的 AI 加速器運算能力極高，功耗驚人，傳統封裝技術已經成為限制效能的主要因素。因此，台灣在先進封裝技術方面已取得領先地位，其中台積電的 CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) 技術是最關鍵的創新之一。CoWoS 技術允許多個大型晶片 (dies) 與高頻寬記憶體 (HBM) 堆疊於同一矽中介層 (silicon interposer) 上，這使得 NVIDIA 的 GPU 可以與 HBM 記憶體並排整合，提供 AI 訓練所需的極高記憶體頻寬。這項技術已成為高端 AI 晶片的標準配置——不僅 NVIDIA 最新的 Hopper (H100) GPU 採用 CoWoS，未來的 Blackwell GPU 也依賴此技術，此外 AMD、Google 及其他 AI 加速器也廣泛應用 CoWoS。



根據市場數據顯示（如上圖），NVIDIA 在 2025 年將占據全球 CoWoS 產能的 63%，遠遠超過其他公司。簡而言之，如果沒有 CoWoS 這類先進封裝技術，當前的 AI 硬體效能將受到嚴重限制。因此，台積電正全力擴大 CoWoS 產能，以應對市場對 AI 晶片不斷增長的需求，確保台灣在 AI 產業供應鏈中的核心地位。過去兩年，台積電每年將 CoWoS 產能翻倍，但市場需求仍持續超過供給。NVIDIA 執行長黃仁勳（Jensen Huang）在 2025 年初表示，台積電的先進封裝產能「比兩年前增長了四倍」，但客戶的需求仍然遠遠超出供應能力。因此，台積電計劃新增多條 CoWoS 產線，並預計 2025 年超過 10% 的營收將來自先進封裝服務——這對於一家長期專注於晶圓製造的公司來說，是一項重大的業務轉型。

為了加快擴產，台積電甚至開始將部分 3D 封裝業務外包，其中包括委託日月光旗下的矽品精密工業（Siliconware Precision Industries, SPIL）進行 3D CoWoS 封裝代工，並計劃於 2025 年第二季開始大規模生產 AI 晶片的 CoWoS 封裝。這種前所未有的供應鏈合作模式，顯示出台灣半導體業者正在聯手應對產能瓶頸，以確保 AI 晶片供應穩定。

在 2.5D 砂中介層（CoWoS）技術之外，半導體的下一個發展方向是 3D 堆疊技術。台積電的 SoIC（System on Integrated Chips）技術透過直接銅對銅鍵結（direct copper-to-copper bonding），以極高密度將晶片垂直堆疊。這種技術允許邏輯晶片（logic die）直接堆疊於 I/O 晶片或其他計算單元之上，等同於在三維空間內建構 CPU 或 AI 加速器，使得效能大幅提升。

SoIC 採用混合鍵結（Hybrid Bonding）技術，目前已能達到  $6\mu\text{m}$  的互連間距，並預計在 2027 年縮小至  $3\mu\text{m}$ ，能夠支援數千個晶片內部的互連點，其訊號密度遠超傳統凸塊（bump bonding）封裝技術。台積電正在積極擴充 SoIC 產能，以滿足市場需求。與 CoWoS 相比，SoIC 由於屬於前端晶圓製程（front-end wafer bonding），較少受到封裝基板與設備工具的瓶頸影響。這項大規模的產能擴張顯示，台積電認為 3D 堆疊技術將成為 AI 高效能運算（HPC）與高端消費電子產品的主流封裝方式。透過持續的技術創新與產能擴充，台積電正穩固其在全球 AI 晶片與先進封裝市場的領導地位，確保台灣在未來 AI 產業供應鏈中的關鍵角色。

未來，半導體產業將逐步進入異質整合（Heterogeneous Integration）的時代，這將結合多種封裝技術，以進一步提升 AI 晶片的效能。台積電的技術路線圖已經構想將 SoIC 3D 堆疊晶粒（chiplets）放置在更大的 CoWoS 砂中介層（interposer）之上，這種方法將 3D 堆疊與 2.5D 技術融合，形成「系統級封裝（System on Package, SoP）」。這樣的創新對於 AI 晶片來說至關重要，因為隨著摩爾定律（Moore's Law）放緩，提升運算能力的關鍵將轉向先進封裝技術。

隨著晶片架構日益複雜，封裝技術必須同步進化。未來會在封裝內部整合矽光子（Silicon Photonics）技術，讓多顆 GPU 透過光學互連，這種技

術不僅能突破傳統電子訊號的頻寬限制，還能顯著降低功耗，提高 AI 訓練與推理的效率。

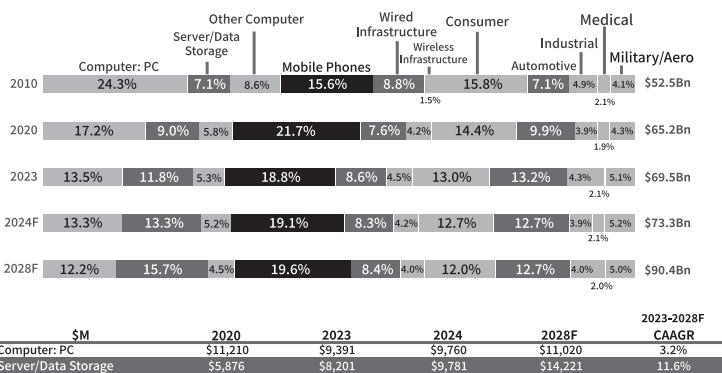
未來的先進封裝可能會加入光學連接（Optical Links）和其他創新技術，以突破電氣訊號在頻寬與功耗上的限制。這些技術創新幾乎全部圍繞台灣展開——台積電與其合作夥伴已經建立完整的 3DIC 生態系統（3DFabric Alliance），推動封裝技術的前進。

### 台灣：從晶片製造者到 AI 計算核心的設計者

這些發展顯示，台灣已經不再只是全球晶片的製造中心，更正在主導 AI 晶片的封裝與組裝技術。如今，先進封裝技術的重要性已經等同於先進製程節點的發展，因為封裝創新將直接影響 AI 晶片的效能與功耗。而台灣正在大舉投資，以確保自己能在這場 AI 革命中保持領先地位。趨勢已經十分明確：為了滿足全球對 AI 運算的「無限需求」，先進封裝技術將成為未來半導體產業競爭的關鍵，而台灣正穩步邁向 AI 晶片生態系統的核心。

### 下一代伺服器主機板與 PCB 技術

AI 的下游影響延伸到承載這些晶片的電路板本身。隨著處理器和加速器變得更加耗電和互連，伺服器印刷電路板（PCB）正在快速發展以跟上步伐。現代 AI 伺服器通常在單一主機板上搭載 8 個或更多的高階 GPU 以及專用的交換器（NVSwitch 或 NVLink），以允許加速器以巨大的頻寬進行通信。這些主機板必須支援數千條高速訊號線，並向每個 GPU 模組提供數百安培的電力——將 PCB 技術推向極限。為了滿足這些需求，製造商正在使用多層高密度互連（HDI）PCB、先進材料和新的電源供應架構。



*Prismark 2024Q2 PCB and Substrate Market Highlights and Outlook*

事實上，台灣的 PCB 產業對高層數和 HDI 伺服器主機板的需求激增。2024 年第二季，HDI 主機板是成長最快的 PCB 產品，由於 AI 伺服器的推動，產量年增 21.2%（多層伺服器主機板的增長率也不遑多讓，達到 +13%）。Prismark PCB 調研機構預測（如上圖），Server/Data Storage 相關 PCB 板將以 CAGR11.6% 的年化成長，市場應用佔比將持續增加。

台灣的 PCB 製造商正在透過優先為針對 AI 和資料中心需求的高階主機板進行資本支出來回應。這意味著投資於更精細的線路 / 間距能力、改善過孔電鍍以提高訊號完整性，以及更大的面板尺寸以適應大型伺服器外形尺寸。

其中一個主要的挑戰是電源供應。像 NVIDIA H100 這樣的單一 AI 加速器可以消耗約 700 瓦的功率，如果每塊主機板上有 4 個或 8 個，那麼 PCB 必須安全地承載數千瓦的功率，同時最大限度地減少噪音和損耗。伺服器主機板設計人員已經推出了新的解決方案，例如直接在 GPU 底板上的夾層電源連接器（取代舊的 PCIe 插槽電源供應）。例如，H100 SXM 模組使用一對新的高電流連接器供電，因為傳統的邊緣連接器被證明不足以應付。主機板還在每個 GPU 插槽周圍配備了強大的電壓調節模組 (VRM)（在上圖中可見電容器和感器的群組），以在如此極端的負載下保持穩定的功率。這些複雜的佈局需要超厚的銅層和先進的 PCB 堆疊，以有效地分配電源和接地層。因此，AI 伺服器主機板看起來與十年前的主機板截然不同——它們更重，具有更多的層數和銅重量，並且經常採用能夠處理高頻和高溫而不變形的特殊 PCB 樹脂。

台灣的 PCB 公司正在利用眼前的市場繁榮：欣興、臻鼎等公司正在提高 ABF 基板和高速背板的產量，以緩解過去幾年短暫限制 GPU 出貨量的瓶頸。產業報告指出，在 2023 年的低迷之後，在 AI 伺服器的推動下，IC 基板需求（針對 ABF 載體）在 2024 年恢復增長，供應商預計隨著更多 AI 硬體上線，2025 年將出現更強勁的增長。整個 PCB 基礎設施都在升級——從 AI 晶片下方的小型基板到承載 AI 伺服器的大型主機板——以支援這個高功率、高連接性的運算新時代。台灣在 PCB 和基板市場佔有很大的份額，正在乘著這股浪潮，提供將 AI 系統連接在一起的關鍵主機板。

### 台灣半導體生態系統：產能擴張與供應鏈韌性

台灣的半導體產業已成為 AI 革命的核心樞紐，本地供應鏈正積極擴展各個環節，以鞏固其全球領先地位。作為全球最大的晶圓代工廠，台積電 (TSMC) 正在大規模投資，擴充前端晶圓製造與後端先進封裝的產能，並確保這些擴張主要在台灣本土進行。

- 在晶圓製造方面，台積電正在加速擴建 3nm 產線，並已在台南超大規模量產，同時，2nm 製程預計在 2025-2026 年導入量產，這將確保其能夠生產最先進的 AI 處理器，滿足 NVIDIA、AMD、Amazon、Google 等客戶的需求。
- 在先進封裝方面，為了解決 CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) 產能短缺，台積電正在台灣多個地點建設新封裝廠，包括嘉義、竹南、台中等地，以滿足 AI 晶片市場的激增需求。

### 產能擴展與 AI 駕動的高成長

這種從 砂晶圓製造到先進封裝的全方位產能擴張，對於滿足 AI 晶片的高速增長需求至關重要。值得注意的是，台積電管理層已承諾，其成長

速度將超越整體產業，公司預測 2025 年營收將增長 25%，遠高於半導體產業的平均 10% 成長率。這種增長的主要驅動力來自 AI 晶片需求的爆發性增長，而為了達成這一目標，台積電必須解決 2023-2024 年 AI 晶片產能短缺期間暴露的供應鏈瓶頸。

### 解決 ABF 載板短缺，強化供應鏈韌性

其中一項關鍵瓶頸是 ABF (Ajinomoto Build-up Film) 載板的供應短缺。ABF 是 AI 晶片和高效能運算 (HPC) 封裝中不可或缺的高密度封裝基板，然而，全球 ABF 產能在 2023-2024 年間無法滿足需求，導致供應鏈緊張。為解決此問題，台灣的載板製造商，如欣興電子 (Unimicron) 正積極擴充產能配置，並提升技術水準以優化 ABF 製程。到了 2024 年底，ABF 載板供應已開始恢復。隨著 AI 加速器訂單持續攀升，這些載板製造商將受益於更有利的產品組合——相比一般 PC 晶片，AI 晶片所需的載板尺寸更大、價值更高、毛利率也更好，這進一步促使台灣供應鏈加快擴產腳步。

### 台灣的關鍵地位：從晶片製造到先進封裝的完整產業鏈

隨著 AI 晶片需求持續上升，台灣不僅在先進製程晶圓生產上擁有全球領導地位，還在先進封裝、載板供應和半導體材料供應鏈方面不斷強化其競爭力。透過持續的產能擴張與供應鏈優化，台灣正確保自己能夠在 AI 時代的半導體產業中保持核心地位，並進一步深化其全球科技產業的影響力。

在討論台灣的產業時，無法忽視其地緣政治背景。全球對台灣先進晶片（無論是 AI、智慧型手機或汽車電子）的依賴程度達到了前所未有的高度，這促使各國積極推動製造多元化，以降低對台灣的過度依賴。例如，台積電正在美國亞利桑那州和日本興建新晶圓廠。然而，這些海外晶圓廠的初期目標主要是生產一般或特定用途的晶片，最先進的 AI 晶片製造與封裝仍然主要集中在台灣，因為台灣擁有無可匹敵的技術專業與完整的產業生態系統。因此，短期內台灣仍将是 AI 供應鏈中不可或缺的關鍵角色。

產業界充分認識到這既是機遇也是責任。台積電執行長魏哲家表示，公司正「全力以赴」以滿足客戶對 AI 晶片的需求，確保產能不會成為 AI 革命的瓶頸。整體而言，台灣的半導體產業正在全面擴張——從晶圓廠無塵室、半導體載板工廠，到伺服器組裝產線——目標是抓住 AI 帶來的成長機遇，同時強化自身以應對未來的衝擊。透過擴充產能並強化供應鏈連結，台灣不僅是在滿足當前需求高峰，更是在為未來的計算時代奠定持續領先的基礎。

對於台灣的半導體產業來說，這波雲端投資浪潮既是祝福也是挑戰。祝福顯而易見：這些公司將購買大量尖端晶片——無論是 NVIDIA H100/Blackwell GPU、AMD MI300 加速器，還是客製化矽晶片 (Google TPU、Amazon 的 Trainium/Inferentia 等)——而這些晶片大多由台積電

生產或由台灣的 OSAT 封裝。同樣地，Amazon 的 Graviton3 和 Trainium 晶片、微軟即將推出的 AI 晶片以及 Google 的 TPUv5 都是內部設計，但都依賴台灣進行製造。隨著 CSP 建造更多資料中心，他們還從廣達和英業達（總部位於台灣）等 ODM 採購伺服器，這些 ODM 整合了主機板、電源和冷卻系統——進一步將台灣嵌入供應鏈。這種良性循環意味著台灣的工廠正在蓬勃發展：台積電先進製程的產能利用率正在從智慧型手機的低迷中恢復，現在由佔其晶圓收入約 50% 的 HPC 訂單驅動。在封裝和測試方面，各公司都在全力以赴，以滿足雲端客戶的交付時間表。簡而言之，超大規模業者的資本支出轉化為台灣晶片生態系統的強勁下游需求——從矽晶片到基板再到最終組裝。

然而，挑戰在於如何規劃永續性。這些資本支出的繁榮可能是週期性的；眾所周知，雲端巨頭在進行大規模建設後會經歷消化期。長期前景仍然樂觀——在超大規模業者的多年資本支出週期推動下，長期增長仍然有保障。到目前為止，跡象表明 AI 需求是持久的：雲端執行長們將 AI 視為他們必須「在未來幾年內」投資的新平台。美國的「星際之門」計劃以及歐洲和亞洲的國家 AI 計劃等政府舉措，將在商業支出的基礎上增加額外需求。因此，台灣的晶圓廠和供應商都在押注這是一個長期增長趨勢，而不是短暫的潮流。台積電計劃每年將其 AI 晶片產量增長 45%，這表明他們對訂單將持續快速增長充滿信心。

AI 催生了數十年來第一個真正的新高增長半導體市場，而台灣正處於其核心——就像它在 PC 繁榮和後來的智慧型手機革命中所做的那樣。現在的不同之處在於規模和速度：我們從未見過每年數千億美元的支出明確與一類技術（AI）相關聯，也從未見過投資如此迅速地轉化為矽晶片需求。台灣的半導體產業正在迅速適應：產能在增加，新技術正在上線，價值鏈上的合作夥伴關係正在深化。未來幾年（2025 年及以後），超大規模業者的資本支出與台灣的半導體擴張之間可能會持續緊密聯繫。如果 AI 模型部署按預期加速——為從雲端服務到自動駕駛汽車再到智慧工廠的一切提供動力——台灣很可能會經歷半導體增長的「超級週期」。這將加強其在全球科技經濟中的關鍵地位，同時也考驗其在巨大壓力下擴大規模和創新的能力。所有跡象都表明，台灣正在迎接挑戰，利用數十年的專業知識，確保 AI 時代的矽晶片心臟每年都跳動得更加強勁。

廣泛的產業展望：AI 駆動的需求、先進封裝、下一代 PCB 技術以及超大規模業者的投資的匯合，為台灣的半導體產業描繪了一個強勁的未來。我們可以預期持續的產能擴張、3D 整合的技術突破以及 IC 設計業者（如 NVIDIA 和全球雲端公司）與台灣製造商之間更深入的合作。這種良性循環可能會以驚人的速度推動半導體創新。在沒有地緣政治干擾的情況下，台灣有望在 AI 時代繼續成為半導體供應鏈的關鍵——為從大型雲端資料中心到將改變產業的 AI 賦能設備的一切提供動力。供應商和客戶雙方的賭注都很大，但如果 AI 革命實現其承諾，整個生態系統都將受益。從長遠來看，對更多 AI 運算能力的追求不僅會刺激業務增長，還會刺激超越 AI 的技術進步，影響未來所有電子產品的設計和製造方式。台灣將

卓越的製造能力與 AI 的尖端需求相結合，為產業領導的新篇章奠定了基礎，2025 年是邁向這一未來的轉折點。

### 3. 技術及研發概況：

#### (1) 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用與開發成功之技術或產品

單位：新台幣仟元

年度	研究發展支出	開發成功的技術或產品	合作對象
113 年	362,179 仟元 (佔營收 7.52%)	大尺寸自動滾輪壓膜機、高階滾輪壓膜機、多腔真空壓膜機、STR 滾輪壓膜機、二代 ABF 剝膜機開發、智慧滾輪壓膜設備研發、G8.5 PI Prebake 設備開發、Micro LED 貼膜機、車載保護膜貼合、車載壓力脫泡設備、半導體產創計畫 - 晶圓級 RDL 介電製程設備	日本設備商、國內 PCB、SEMI、FPD 領導廠商
114 年 第一季	99,219 仟元 (佔營收 7.58%)		

### 4. 長、短期業務發展計劃：

#### (1) 短期計劃：

##### A. 行銷策略

- 推展 2.5D/3D IC 製程之壓合、貼膜、混合鍵結製程設備、半導體用各式烤箱設備。
- 深耕固有市場與客戶並持續推出高階產品，並評估參與潛在客戶的前瞻製程開發案。
- 持續深耕兩岸市場並推廣至泰國、東南亞、印度與歐美日。
- 將觸角推向新能源領域及關注環境變遷的需求（循環經濟）。

##### B. 生產策略

- 精實管理，以不斷改善，降低成本，穩定品質，為研發資材因應景氣循環及微利時代之首要任務。
- 提升資材製造管理能力，致力於庫存最佳化的管理。
- 加強共用零組件模組化、標準化的設計，並留意環保減廢。
- 提升零組件，材料及粗加工外包之議價及品質控管能力。
- 進一步完備及修正調整各項產品之生產裝配工序，組裝規範，製程檢驗規範，使生產易製化及標準化、同時提升產品功能客製化的能力。

##### C. 產品發展策略

整合核心關鍵技術，擴大產品組合，延伸產業應用，並與策略夥伴技術與市場合作。

##### D. 品質策略

以 PDCA（計劃、執行、檢討、修正）的循環管理模式依據 ISO-9000 品質系統由 QC 提昇為 QA 品質保證，加強客戶滿意度，滿足客戶之品質需求。

(2) 長期計劃：

A. 行銷策略：

- a. 以自有品牌與 G2C+ 聯盟為方針。
- b. 以壓、貼、撕、烤、濕、電漿為技術基礎，成為設備領導廠商，客戶的前瞻設備研製中心為定位。
- c. 從大中華地區為市場，擴大至新興經濟體與先進國家。
- d. 以優勢產品組合及整合性服務解決方案為市場區隔訴求，與策略夥伴市場合作。

B. 生產策略

- a. 建立並發展核心供應商體系。協助提升供應商因應景氣循環之應變能力及大陸地區快速穩定供貨的能力。
- b. 深化兩岸研發能力，深耕引領產業發展的核心技術。
- c. 因應情勢調整大陸生產基地及台灣的兩岸有效分工，循環經濟產業，與策略夥伴研發合作。

C. 產品發展策略

以核心技術為基礎，配合科技產業、新興再生能源產業、環保醫療產業的技術演進及市場的需求，延伸應用領域之發展。

D. 品質策略

- a. 配合公司經營成長、堅持品質、專業踏實，循序漸進導入 QA 品質保證，提升公司競爭優勢，滿足顧客需求，使企業邁向國際化。
- b. 以顧客為導向為提升整體服務、創造整體顧客價值。

## 二、市場及產銷概況

### 1. 市場分析：

(1) 銷售地區：台灣、大陸、日本、美國、韓國、新加坡、馬來西亞、越南、泰國、印度等地。

經銷商：香港（大陸）、日本、美國、韓國、新加坡、越南、泰國、印度。

#### (2) 市場佔有率

公司專注於提供高度專業化的半導體先進封裝製程設備於客戶製程中驗證後於量產中使用。我們的產品線涵蓋了一系列前瞻專用的設備，專為滿足客戶技術要求而設計，從而支援客戶實現更小型化、更高性能和更高效率的晶片封裝製程。在這個細分市場中，公司設備不僅關鍵且獨特，部分甚至達到獨家供應，這反映了我們在技術創新和客戶需求解決方案方面的專注地位。

由於我們專注於特定且高度專業化的製程技術，傳統的市場佔有率計算方法可能難以完全捕捉我們設備的市場影響力和價值。在這種情況下，我們更重視深化技術領導地位、擴大技術影響範圍以及與客戶建立和維護長期合作關係，而非關注市場佔有率。透過這種方式，我們在先進封裝技術的細分市場中為客戶提供了無可替代的價值，並持續推動行業向前發展。僅以市場調研機構報告分別闡述各區塊潛在規模產值，對應當前公司產業區塊的產值或營收。

#### (3) 市場未來之供需狀況與成長性

志聖為台灣電子產業製程設備領導廠商，以五大核心技術整合為基礎，應用在七大產業，為大中華區之主要電子產業提供相應的製程解決方案。各主要電子產業的資本支出計畫為志聖工業產品市場主要之指標，因此以下將以主要之客群產業之資本支出作為志聖產品供需狀況及成長性的說明。

##### • 半導體市場：

半導體產業分布廣泛，大致可區分為上游 IP 設計及 IC 設計業；中游 IC 製造、晶圓製造、相關生產製程檢測設備、光罩、化學品等業，以及下游 IC 封裝測試、相關生產製程檢測設備、零組件（如基板、導線架）、IC 模組、IC 通路等業。產業中每家公司各司其職，從 IC 設計公司設計完成產品，委由專業晶圓代工廠或 IDM 廠（整合型半導體廠），從 IC 設計、製造、封裝、測試到最終銷售都一手包辦）製作成晶圓半成品，再經由前段測試，後續轉給專業封裝廠進

行切割及封裝，最後由專業測試廠進行後段測試，測試後之成品則經由銷售管道售予系統廠商裝配生產成為系統產品，銷售至全世界各處。台灣半導體產業發展較早，人才技術具有領先優勢，因此擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工。

WSTS（世界半導體貿易統計）在 2024 年秋季發布的半導體市場預測報告中，更新了對全球半導體市場的展望。該報告於 2024 年 12 月發布，強調對 2024 年和 2025 年的強勁成長的預期，其中 2024 是強勁反彈的一年。WSTS 在更新的秋季預測中，上調了對 2024 全年的預測，預計全球半導體市場將年增 19.0%，產值將達到 6,270 億美元。2024 年的市場估值現在預計為 6,270 億美元，較前一年大幅成長了 19.0%。

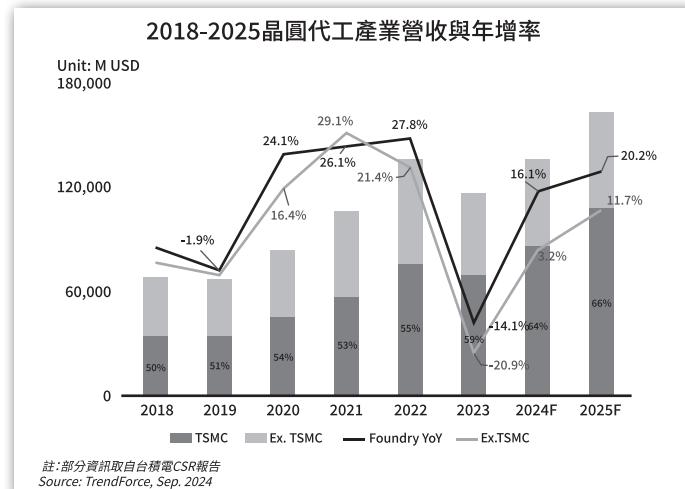
展望 2025 年，WSTS 認為全球半導體市場會延續 2024 年的強勁力道，預計年增 11.2%，全球市場估值將達到 6,970 億美元。增長主要由邏輯電路和記憶體領域帶動，這兩大領域的總價值將超過 4,000 億美元。其中，邏輯電路預計年增逾 17%，記憶體年增 13%。

Fall 2024	Amounts in US\$M			Year on Year Growth in %		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Americas	134,377	186,635	215,309	-4.8	38.9	15.4
Europe	55,763	52,031	53,736	3.5	-6.7	3.3
Japan	46,751	47,410	51,866	-2.9	1.4	9.4
Asia Pacific	289,994	340,792	376,273	-12.4	17.5	10.4
Total World - \$M	526,885	626,869	697,184	-8.2	19.0	11.2
Discrete Semiconductors	35,530	31,546	33,377	4.5	-11.2	5.8
Optoelectronics	43,184	42,092	43,705	-1.6	-2.5	3.8
Sensors	19,730	18,732	20,034	-9.4	-5.1	7.0
Integrated Circuits	428,442	534,499	600,069	-9.7	24.8	12.3
Analog	81,225	79,433	83,157	-8.7	-2.2	4.7
Micro	76,340	79,291	83,723	-3.5	3.9	5.6
Logic	178,589	208,723	243,782	1.1	16.9	16.8
Memory	92,288	167,053	189,407	-28.9	81.0	13.4
Total Products - \$M	526,885	626,869	697,184	-8.2	19.0	11.2

資料來源：WSTS.org

再細看半導體代工市場的規模，市場分析機構 TrendForce 的報告（如下圖），預計 2025 年全球晶圓代工市場將穩定增長，市場領導者台積電和台灣地區將成為受益者。全球晶圓代工市場預計在 2025 年將成長 20.2%，達到 1316.5 億美元。其中 2024 年第四季全球晶圓代工產業呈兩極化發展，先進製程受惠於 AI Server 等新興應用增長，以及新款旗艦級智慧手機 AP 和 PC 新平台備貨週期延續，帶動高價晶圓出貨增長，抵銷成熟製程需求趨緩帶來的衝擊，前十大晶圓代工業者合計營收季增近 10%，達 384.8 億美元，續創新高。2024 年第四季台積電以市占率 67% 之姿穩居龍頭。

預計台積電在前段節點製程的領先，搭配其後段先進封裝無論在2.5D, 3D的CoWoS製程與SoIC製程的強烈市場需求，持續領跑晶圓代工市場。



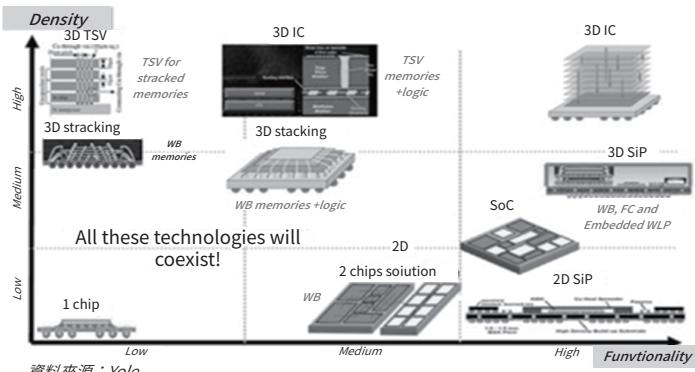
現今晶圓代工業技術發展依然以製程微縮為主，因為IC要提升效能最快的方式就是微型化，在越小的空間佈更多的線路效能越佳，下圖為半導體產業先進製程變化及新製程技術預估，其中，台積電2021年開始導入5奈米製程，並在2022年開始量產3奈米產品，其技術持續領先其他晶圓代工廠，成為這波新技術演進中的最大受惠者。

	2018前	1H'18	2H'18	1H'19	2H'19	1H'20	2H'20	1H'21	2H'21	1H'22	2H'22	1H'23	2H'23	1H'24	2H'24	1H'25	2H'25
		7nm FF OUV		7nm+ FF EUV	6nm FF EUV	5nm FF EUV	4nm FF EUV			3nm FF EUV					2nm(可能) GAA EUV		
		10nm FF		7nm FF EUV		5nm FF EUV	3nm GAA EUV			3nm(第二代) GAA EUV					2nm GAA EUV		
		14nm			10nm		Intel 7 (10nm Enhanced SuperFin)	Intel 4 FF EUV		Intel 3 FF EUV	Intel 20A RibbonFET (GAA) EUV				Intel 18A RibbonFET (GAA) EUV		
						14nm FF(from 2017)											
		28nm						14nm									

資料來源：工研院產科國際所

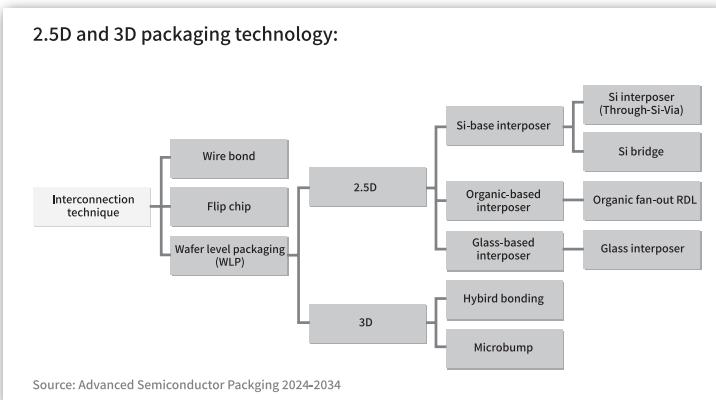
在各種不同系統封裝技術中，最有機會讓封裝遵循摩爾定律演進的互連技術，稱為3D TSV直通矽晶穿孔(Through-Silicon Via)封裝技術，其設計概念是來自於印刷電路板(PCB)多層化的設計，TSV可像三明治一樣堆疊數片晶片，是一種可以電力互相連接的三次元堆疊封裝(Stack Package)，TSV使2D平面晶片配置技術演進至3D堆

疊技術，目前晶圓代工及封測廠已積極切入 3D IC 封測。



在接下來的這幾年，3D IC 堆疊晶片技術的應用會在更多更廣泛的種類明顯增加，特別是需要強大計算能力和記憶體容量的應用，包括多核伺服器和人工智慧相關應用。另外，隨著系統內部組成越來越異質化，3D IC 堆疊技術則成為關鍵，一個異質化的系統會由各種不同的零組件構成，如記憶體、影像感測器、用於類比功能和射頻的三五族電子設備、處理器、低功耗電子設備等，以最適合的技術去設計和加工每一個零組件，然後再利用 3D IC 堆疊技術將其封裝成單元件，藉此可使電子系統的運作效能增進、成本和功耗降低。

#### 2.5D and 3D packaging technology:



3D Technology	3D-SIP			3D-SIC	3D-SOC		3D-IC
	"PoP"	"Chip last"	"Chip first"	Die stacking	Parallel W2W		Sequential FEOL
3D-Wiring level	Package I/O Interposer I/O	Chip I/O Interposer I/O	Chip I/O	Global Semi-global Chip BEOL Wiring Hierarchy	Intermediate		Local FEOL
Partitioning	Functional unit	subsystem	Embedded die	Die	Blocks of standard cells		Standard cells Transistors
Technology	Package-to-Package reflow 3D/2.5D stack	Multi-die SiP 3D/2.5D stack	FO-WLP Embedded die	3D D2D,D2W 2.5D Si-interposed	Wafer-to-Wafer bonding Hybrid bonding	Via-last	Active layer transfer or deposition
2-tier stack Schematic							
Characteristic	Solder ball Stack  • C4, Cu-pillar • Si-Orgaic • Through-Mold-vias		Bumpless • Si-RDL • Through-Package-vias	• bump • Si-to-Si • Through-Silicon-Via	BEOL between 2 FEOL layers		FEOL stack
Contact Pitch	400⇒350⇒300μm	120⇒80⇒60μm	60 ⇒40⇒20μm	40⇒20⇒10⇒5μm	5μm ⇒ 1 μm	2 μm ⇒ 0.5 μm	200nm ⇒ 100nm < 100 nm
Relative density	1/100⇒1/77⇒1/55	1/9⇒1/4⇒1/2,3	1/2,3⇒1⇒4	1⇒4⇒16⇒64	64 ⇒ 1600	400 ⇒ 6400	4·10 <sup>4</sup> ⇒ 1.6·10 <sup>5</sup> > 1.6·10 <sup>5</sup>

資料來源：愛美科技

而隨著全球半導體產業晶圓廠設備持續擴增，資本支出在創下新高的罕見紀錄邁進。SEMI 國際半導體產業協會於 SEMICON West 2024 北美國際半導體展，公布年中整體 OEM 半導體設備預測報告，預估 2024 年全球半導體製造設備銷售總額將年增 3.4%、攀上 1,090 億美元新紀錄，成長力道也將延續至 2025 年，在前、後段製程需求共同驅動之下，年度銷售總額可望再創歷史新高，來到 1,280 億美元，成長 17.4%。

其中，人工智能伺服器、資料中心、通訊等新興技術的需求成長最大，而電子裝置作為其骨幹，需求出現爆炸性的成長，也是這波設備支出來源的最大宗。台灣受惠台積電為世界晶圓代工領導廠商之一的優勢，帶領台灣其他業者與邏輯晶片製造在前段製造商投資先進製程設備，擠下韓國成為全球最大的半導體設備需求市場。

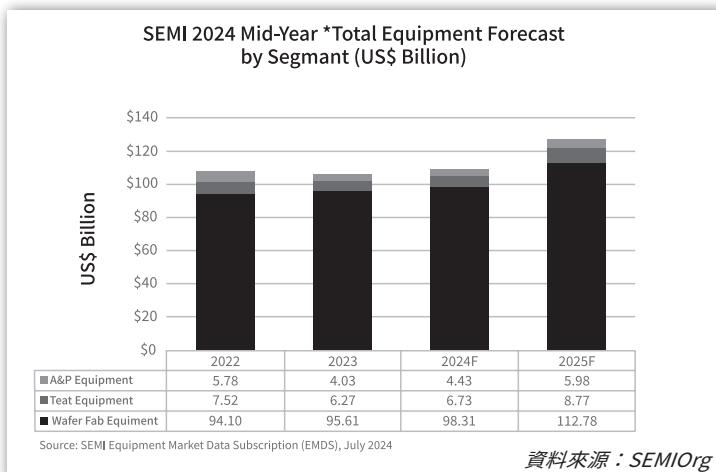
以半導體設備銷售類別來看，晶圓廠設備（含晶圓加工、晶圓廠設施和光罩設備），2024 年將繼續上升 2.8% 至 980 億美元，較 2023 年年中報告預測的 930 億美元高出許多。SEMI 指出，AI 運算效應發酵、中國設備支出持續走強以及對 DRAM 和高頻寬記憶體（HBM）的大量投資都是數字上修的主因。展望 2025 年，在先進邏輯和記憶體應用需求增加帶動下，晶圓廠設備銷售額可望更上一層樓，增幅 14.7% 至 1,130 億美元。

宏觀經濟形勢和半導體需求減弱，後段設備歷經兩年衰退後，終於將在 2024 年下半年開始回溫，其中，半導體測試設備銷售 2024 年將增長 7.4% 至 67 億美元，組裝和封裝設備則有 10% 的增幅，銷售額達 44 億美元。

SEMI 預估，後端部門成長進入 2025 年將加速飆升，測試設備和組裝 / 封裝銷售額各有 30.3% 及 34.9% 的漲幅，背後成長動能主要以日益複雜的高效能運算半導體設備，以及針對汽車、工業和消費性電子終端市場需求的預期復甦。此外，後段製程成長也將隨時序推展而增加，才能消化晶圓廠不斷往上攀升的供應量能。

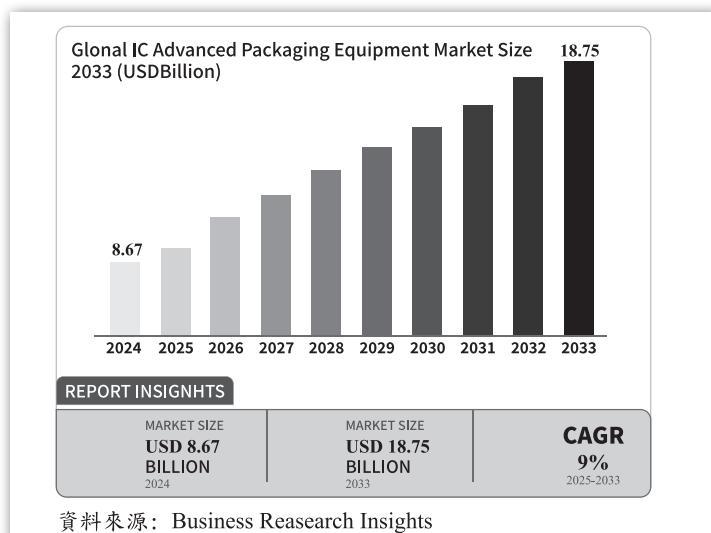
以半導體設備銷售應用別來看，2024 年晶圓代工和邏輯應用晶圓廠設備銷售額將年減 2.9% 至 572 億美元，這是由於 2023 年成熟製程需求疲軟以及先進製程銷售額高於預期；受惠於先進技術需求不斷增長、新設備架構引進以及產能擴張採購增加，預計 2025 年將出現 10.3% 的增長，來到 630 億美元。

記憶體相關資本支出在 2024 年成長最為顯著，並於 2025 年呈現持續走揚。隨著供需正常化，2024 年 NAND 設備銷售額走勢相對穩定，將成長 1.5% 至 93.5 億美元，為 2025 年一躍 55.5% 至 146 億美元的強勢漲幅奠定良好基礎。DRAM 設備銷售額則在 AI 應用元件上所需的 HBM 記憶體和持續技術遷移帶動需求激增的推波助瀾下，2024 年和 2025 年各上漲 24.1% 及 12.3%。



細分至半導體先進封裝製程設備的市場前景，根據 Business Research Insights 的預估隨著消費者對緊湊和便攜式電子設備（如智能手機、平板電腦、可穿戴設備和物聯網設備）的偏好增加，推動了對先進封裝技術的需求。IC 先進封裝使製造商能夠設計出更小、更強大的設備，從而滿足消費者期望並推動市場增長。高性能計算（HPC）

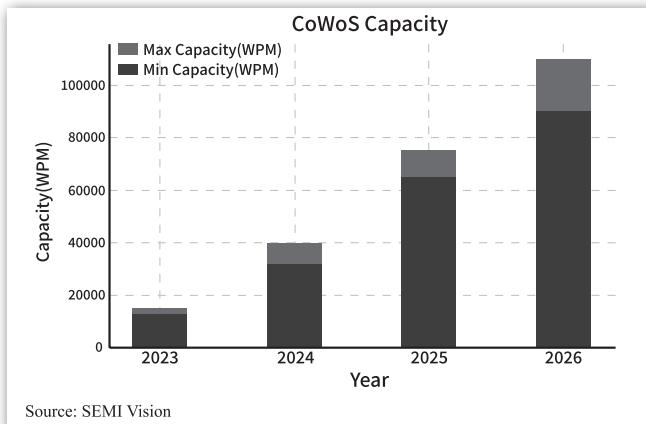
應用，包括人工智慧（AI）、機器學習、數據中心和汽車電子，需要高級封裝解決方案來滿足其特定要求。面對對 2.5D 和 3D 封裝等高級封裝技術的需求增加，這些技術使得更高的記憶體帶寬、更低的功耗和改善的熱管理成為可能，對於 HPC 和 AI 應用至關重要。IC 高級封裝設備通過使多個晶片和功能集成到單一封裝中，提供了成本效益解決方案。這種集成降低了整體系統成本，簡化了製造過程，並提高了產量率。因此，消費電子、汽車和醫療等行業正在採用高級封裝技術以實現成本效益，推動 IC 高級封裝設備市場增長。Business Research Insights 預估先進封裝設備市場規模，將自 2024 年的 86.7 億美金，以 CAGR9% 的速度成長至 2033 年的 187.5 億美金。



綜合上述產研報告預估 2025 年金額 (US\$B) 整理相對佔比

半導體總體產值	627.00	100%		
導體代工產值	131.65	21.0%	100%	
TSMC 產值	90.1	14.4%	68.4%	
半導體設備資本支出	128.0	20.4%	97.2%	100%
半導體封裝與測試設備資本支出	14.75	2.3%	11.2%	11.5%
半導體先進封裝設備規模	9.45	1.5%	7.1%	7.3%

過去一年，CoWoS 先進封裝技術已成為 AI 晶片產能提升的關鍵瓶頸。隨著 AI 運算需求爆發，NVIDIA 作為台積電 CoWoS 技術的最大客戶，其 GPU 產品的高度需求導致封裝產能持續緊張。為了解決供需失衡的問題，台積電在 2023 年宣布擴大 CoWoS 產能，並在 2024 年將該技術的產能提升至兩倍以上。然而，市場需求仍然遠超供給，促使台積電加速擴展先進封裝產能，以確保 AI 晶片供應的穩定。



根據市場最新資訊（如上圖），台積電目前的 CoWoS 產能約為 3.5~4 萬片（wafer per month, WPM），並預期於 2025 年底將年產能提升至超過 7~7.5 萬片 / 月，實現 100% 以上的年化增長目標。進一步來看，2026 年的 CoWoS 產能可能達到 10 萬片 / 月，以支撐 NVIDIA、AMD、Google 及其他 AI 晶片客戶的高速成長需求。此外，HBM（高頻寬記憶體）封裝的技術突破也是影響產能的關鍵，業界預測，2025–2026 年 HBM4 及後續版本的導入將進一步驅動台灣半導體公司在先進封裝技術的擴張。

為進一步鞏固市場領先地位，台積電在 2024 年宣布，計劃於嘉義、台南等地興建新的先進封裝廠，專注於 CoWoS 及 3D 堆疊（SoIC）技術。這些新工廠的產能將在 2025-2026 年逐步開出，預計 2025 年進入大規模量產。這一系列投資顯示，台積電不僅致力於提升現有的 2.5D CoWoS 產能，更著眼於 3D 堆疊（SoIC）及矽光子（Silicon Photonics）等異質整合技術的發展，以確保未來 AI 與高效能運算（HPC）市場需求的長期供應能力。

在台積電擴充 CoWoS 產能的過程中，志聖工業（CSUN）作為

關鍵設備供應商，持續提供關鍵的製程設備，確保產線順利擴展。此外，隨著 OSAT（Outsourced Semiconductor Assembly and Test, 封裝測試代工）廠商如日月光（ASE）和矽品（SPIL）擴建 CoWoS 或 2.5D 先進封裝產能，志聖也確保其設備能夠對應這些 OSAT 廠商的製程需求，確保台積電的 CoWoS 封裝擴張計畫能夠順利進行，並在供應鏈中維持高品質與高效能的封裝技術標準。

CoWoS 及 3D 堆疊等先進封裝技術，將在滿足當前與未來運算需求方面發揮關鍵作用，推動全球半導體行業向更高效、更整合的方向發展。隨著技術的進步與市場需求的增長，這些創新技術將帶來新的產業機會與挑戰。志聖工業作為 CoWoS 供應鏈的重要一環，透過高精度設備確保台積電及 OSAT 廠商的產線穩定擴張，並與台灣半導體生態系統共同迎接 AI 時代的挑戰與機遇。

- **印刷電路板：**

2025 年 PCB 產業的前景與趨勢分析：

整體市場展望與成長預測：

市場研究機構 Prismark 預測，2024 年全球 PCB 產值預估年增 5.5%，隨著 AI 應用快速發展，伺服器需求顯著提升，帶動 PCB 產業進入新一輪成長周期。在 AI 伺服器的強勁需求下，已成為產業升級的重要推手 2025 年將進一步成長 6.2%，全球 PCB 產值將提升至 863.3 億美元。其中，HDI 與 IC 載板的年複合成長率（CAGR）分別達 7.8% 和 7.6%。

Prismark 亦預計 2023-2028 年全球 PCB 產值的複合年增長率（CAGR）為 5.4%。中國大陸 PCB 產值預計在 2025 年達到 460.4 億美元。中信證券認為，全球 PCB 行業自 2022 下半年開始進入下行週期，並於 2023 上半年觸底，預計 2024 年將實現恢復性增長，2023-2028 年 CAGR 預計為 5.40%。

主要驅動 PCB 成長的因素：

- 雲端運算與主權 AI 需求強勁：雲端資料中心資本支出雖趨謹慎，但整體產值持續上升，伺服器出貨量預計將有高個位數成長。GB200 預計於 2025 年第一季進入爬坡放量期，加上雲端 CSP 業者自研 ASIC 需求火爆，將帶動上游原材料和 PCB 供應

鏈產能滿載。主權算力需求亦快速提升，預計 2025 年將更上一層樓。AI 算力建設和終端換機加速是推動 PCB 市場發展的重要因素。伺服器及存儲器 PCB 的產值預計在 2023-2027 年的 CAGR 為 13.47%，增速快於其他 PCB 種類。

- 800G 高速傳輸需求：國際大廠光收發模組採購陸續從 400G 升級至 800G，2025 年將是 800G 的關鍵起量年。乙太網路因具備高度佈建彈性且成本相對 IB 架構低，受國際大廠重視，將推動相關 PCB 需求。M8 材料的採用將帶動 CCL 和 PCB 廠報價提升。
- 汽車智慧化與電動化：汽車智能化趨勢下，ADAS（先進駕駛輔助系統）對 PCB 的需求量及單車 PCB 價值量拉動顯著。電動車的電驅系統、電控系統和動力電池模組對 PCB 的需求量遠高於傳統汽車。新能源車動力電池模組中 FPC（柔性電路板）的大量使用亦推升 PCB 需求。預計至 2028 年車用 PCB 用量將比 2022 年增加 50%，汽車 PCB 市場有望保持較高增速，Prismark 預測全球汽車 PCB 產值在 2023-2027 年的 CAGR 為 6.98%，快於 PCB 行業平均增速。
- 先進封裝技術發展：後摩爾時代，先進封裝成為集成電路發展的關鍵路徑，帶動封裝基板的需求高增長。預計未來先進封裝有望以約 5% 的數量支撐超過 50% 的封裝市場規模。2022-2028 年，全球先進封裝市場規模 CAGR 預計為 10.0%。封裝基板是先進封裝的關鍵材料，2023-2028 年全球封裝基板市場規模的 CAGR 有望達到 8.80%。ABF 基板因適用於線路較細、高腳數高傳輸的 IC，受益於 HPC 晶片需求，2021 年全球 ABF 基板市場規模佔封裝基板比重達 38%，亦將因 AI 雲端伺服器的規模擴大而持續成長。
- AI 終端需求：AI 升級趨勢有望加速終端消費電子產品的換機週期，例如 AI 手機和 AI PC 對電性能和信號傳輸有更高要求，可能帶動 PCB 規格升級（如 HDI 階數提高，HDI 升級至類載板，線寬線距精度提升）。
- 網通產業復甦：隨著總經環境改善及規格升級，網通應用需求預計將在 2025 年全面復甦。AI 伺服器熱潮將帶動資料中心建置及更高的傳輸速率要求，進而推動光通訊產業的發展，利好網通 IC 業者和台灣供應商。

技術趨勢：

- 高階 HDI 板需求增加：AI 計算與汽車三化驅動的高速數字信號傳輸均指向對 HDI 板的更高需求，也對 HDI 的性能提出更高要求。預計高階 HDI 的需求增量將更加顯著。Prismark 預計 2023-2028 年全球 HDI 板市場規模的 CAGR 為 6.2%。
- 軟板 (FPC) 應用擴展：FPC 在新能源汽車的動力電池模組中大規模使用，且在 Mini-LED 照明和 XR 設備中亦有廣泛應用。
- 封裝基板朝更大尺寸發展：隨著台積電 CoWoS 封裝持續變大以支援更大的 AI 晶片，對更大尺寸的封裝基板需求將會增加。
- 玻璃基板的潛力：玻璃基板在成本和性能方面具備優勢，被視為下一代封裝基板，預計 2030 年前有望實現量產。英特爾等龍頭企業積極投入玻璃基板的研發與量產。

2025 年 PCB 產業預計將在雲端運算、AI、800G 高速傳輸、汽車智能化與電動化以及先進封裝等需求的驅動下持續成長。高階 HDI 板和軟板 (FPC) 的應用將更加廣泛，封裝基板的需求將持續強勁。此外，供應鏈去風險化（脫鉤）將為中國以外的供應商，特別是東南亞地區的供應商，提供重要的機會。台灣和中國大陸的 PCB 廠商有望在這一波趨勢中受益，但仍需關注市場競爭、原材料價格波動以及新技術發展帶來的挑戰。

(4) 競爭利基：

- A. 優勢品牌：創立 59 年之品牌，榮獲 2019 年第 16 屆台灣金根獎與第 5 屆卓越中堅企業獎、2023 年榮獲台積電優良供應商獎、2023 繸鼎優良供應商獎等殊榮。
- B. 核心技術（五大核心技術）。
- C. 綿密的服務及銷售通路（七大應用產業及超過 3,000 家客戶）。
- D. 高品質之設備。
- E. 優良之售後服務及維修能力。
- F. 高效率的研發設計能力。
- G. 高度彈性的製造能力。

(5) 發展遠景之有利、不利因素與因應對策：

- **有利因素：**
  - A. 進口替代持續：本地半導體產業永續性為台積電企業社會責任的重要一環，積極輔導在地關鍵原物料供應商提升技術與品質，持續推動供應鏈在地化。
  - B. 大陸市場持續內資化；志聖已深耕大陸市場多年，通路佈局完整。
  - C. 志聖為知名 UV 光、壓合、貼膜、& 熱處理技術品牌，並持續延伸核心技術至 PCB 濕製程及 Plasma，構成堅強的商業策略基礎。
  - D. 技術經驗及研發成果之累積傳承完整、有利生產效率與品管之提升。
  - E. 通過 ISO 9001 評鑑，且關鍵技術多自行研發，品質保證與研發能力深受肯定。
  - F. 志聖為上市公司，財務穩健，自 2019 年下半年起梯隊接班，持續年輕化。
  - G. G2C+ 聯盟成立：One Stop Shopping 一站式，滿足客戶需求。
- **不利因素及其因應對策：**
  - A. 國內高科技生產設備製造業起步較晚，徵才留才易受高科技行業影響。  
**因應對策：**

本公司致力從機械製造導向轉向於解決方案供應商的導向，將材料及製程整合於本公司產品平台上，大幅增加本公司提供給客戶的附加價值，由此進而產生對跨領域知識技術整合的迫切需求，透過產學合作引進人才，人員更需用心的帶領及耐心陪伴成長，如此而成的企業文化加上同仁共同創造的終身學習環境，將持續改變本公司的人力素質，以期能更貼近本公司像台積電等一流客戶的水平，才能持續與一流的客戶在世界一流的舞台上共同合作。
  - B. 由於機械設備業係下游產業延伸性需求，且產品生命週期長，通常於下游客戶設立、擴廠、製程改變、或產品層次提升時才有相關設備之需求，故客戶需求之變動較大。  
**因應對策：**
    - a. 配合市場變化及客戶個別需求，持續研發新技術及新產品，以開發多樣化及高附加價值之產品提升競爭力，進而誘發客戶新需求。
    - b. 要求業務部門主動定期蒐集下游客戶所處產業之相關資訊，與 G2C+ 聯盟整合，並積極參與不同區域之展覽及研討會議，提高

品牌專業形象，此外亦與國、內外關聯廠商保持良好關係，尋找合適共同合作對象。

C. 材料及匯率波動影響長交期的設備獲利。

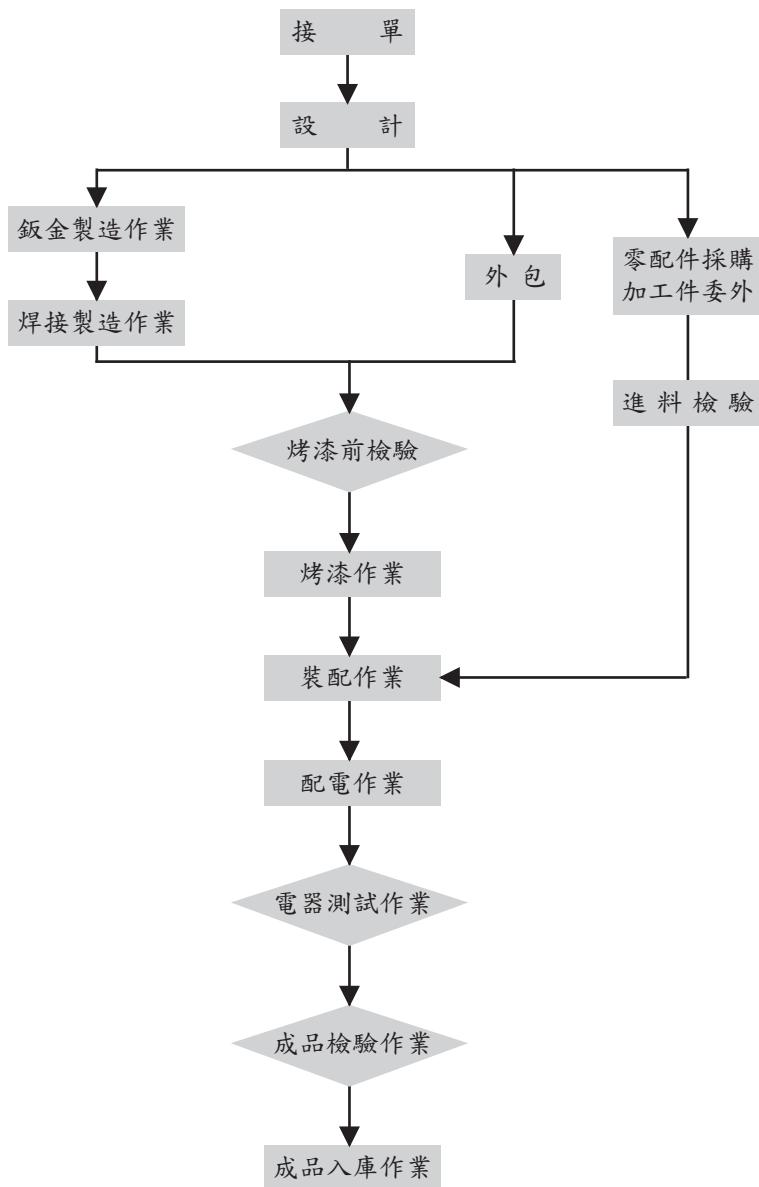
**因應對策：**匯率部份詳見風險管理內容詳本年報伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險管理之、六、風險管理及評估（二）利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施。

## 2. 主要產品重要用途及產製過程：

### （1）主要產品之重要用途：

產品類別	產品重要用途
熱製程設備	電子元件產業如半導體 /PCB/LCD/ 太陽光電 /LED/ 鏡頭 / 高頻元件及運動鞋、印刷塗裝業產品之烘烤、固化、乾燥、改質、純化、定向
UV 光製程設備	電子元件產業及運動鞋、印刷塗裝業產品、半導體封裝之乾燥、固化、影像轉移、清洗、定向
真空壓力烤箱	用於半導體封裝 underfill de void 製程、SMT de void 應用。
乾、溼膜製程設備	電子元件產業產品之上光阻、表面保護
載板壓膜機	適用於載板增層製程之 ABF/RCC & Solder mask 全自動真空壓膜、整平、精密整平需求，達到高填覆性及平坦度要求
載板剝膜機	適用於載板 ABF/RCC & Solder mask 壓膜（曝光）後之保護膜（Mylar）全自動雙面撕除，取代人工減少接觸、高穩定自動異常檢出
晶圓 Bonder	用於先進封裝製程將 Carrier 和 device wafer 作 bonding 後薄化製程或因製程需求需 transfer wafer 工作面使用

(2) 主要產品之產製過程：



3. 主要原料之供應狀況：

本公司產品主要原料零件為加熱器、尋邊機、Robot、氣壓元件、HEPA、滾珠螺桿、伺服馬達及溫控器等，取自國內外大廠如：Festo、柏堅、益民、合欣技研、近藤、興保、上銀、三菱及RKC等，由於長期配合，已建立彼此穩定之供應關係，貨源供應充足，其品質與交期均能維持一定的水準。

4. 最近二年度任一年度中佔進（銷）貨總額百分之十以上之客戶及供應商名稱：

(1) 最近二年度主要供應商資料：

項目	名稱	金額	112 年		113 年	
			占全年度進貨淨額比率 %	與發行人之關係	名稱	金額
佔進貨總額 10% 以下之供應商	其他	1,629,524	100%		其他	2,824,794
進貨淨額		1,629,524	100%			2,824,794

註 1：列明最近二年度進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，但因契約約定不得揭露供應商名稱或交易對象為個人且非關係人者，得代號為之。  
 註 2：無佔進貨額 10% 以上之供應商。

(2) 最近二年度主要銷貨客戶資料：

項目	名稱	金額	112 年		113 年	
			占全年度進貨淨額比率 %	與發行人之關係	名稱	金額
佔銷貨總額 10% 以上之客戶	—	—	—	—	甲公司	986,956
佔進貨總額 10% 以下之供應商	其他	3,625,801	100%		其他	3,831,253
進貨淨額		3,625,801	100%			4,818,209

註 1：列明最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象為個人且非關係人者，得代號為之。  
 註 2：最近二年度任一年度佔銷貨總額 10% 以上之客戶其銷貨金額增減變動原因：因應客戶年度擴線需求增加所致。

### 三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

#### (一) 從業員工結構：

年度		112 年度	113 年度	當年度截至 114 年 3 月 31 日
員工人數	職員	285	313	316
	技術員	602	674	691
	合計	887	987	1,007
平均年歲		37.32	37.29	37.21
平均服務年資		9.56	9.09	9.02
學歷分布比率	博士	3	4	4
	碩士	91	105	110
	大學	578	663	669
	高中	173	175	185
	高中以下	42	40	39

#### (二) 員工行為或倫理守則：

為提高工作環境及員工人身安全保護措施，本公司編制有員工作規則手冊（計十四章節），針對紀律與守則、僱用與訓練、工作時間與休息、請假規範、獎懲與考核、資遣與考核、退休、職業災害補償與撫卹、安全衛生、福利措施、勞資溝通等進行規範。並另訂『獎懲管理辦法』作為員工獎懲之依據。

#### (三) 工作環境與人身安全健康的保護措施：

項目	內容
政策、承諾及重要性	志聖導入 ISO 45001 職業安全衛生管理系統，遵守勞安衛要求持續改善工作環境、預防工安事件發生降低職災風險，藉由工作環境、人員組成及作業活動等之危害辨識評估，預防減少職場不法侵害，企業留任率提高；發生職安事故未良好處理，導致員工流失與媒體報導企業聲譽下降。
權責單位	職業安全衛生委員會
申訴機制	人資單位電話：886-2-26010706 申訴信箱： <a href="mailto:csunzskhr@csun.com.tw">csunzskhr@csun.com.tw</a>
短中長期目標	<p><b>短中期：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>強化意外事故及虛驚事件管理，降低事故發生率。</li><li>培育各級人員在職業安全衛生管理系統上，均能接受安全衛生管理教育訓練，具備必須之安全衛生意識與建立危害預知能力。</li><li>5S 現場環境整頓，有效執行安全衛生管理規定確保工作環境安全與健康。</li><li>2024 年完成企業運動認證與綠色環保標籤認證。</li></ul>

項目	內容
	<p><b>長期：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2027 年失能傷害頻率 (FR) 0.22。</li> <li>• 降低化學品風險，精進化學品分級與危害預防管理。</li> <li>• 促進身心平衡發展，營造健康友善職場。</li> </ul>
行動計畫	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 以每月與特約醫護人員共同施行健康風險預測、風險管理及健康環境營造，關懷同仁健康。</li> <li>• 北中南各區工程案，皆保持稽查制度，每月至少 1 次以上。</li> <li>• 實踐環安衛政策：遵守法令要求、落實教育訓練、有效利用資源、防範意外事件、持續推動改善、全員諮詢參與。</li> </ul>
2024 年績效	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 獲得 ISO45001/14001 認證系統。</li> <li>• 定期每月一次執行職安衛稽核，2024 年共舉行 42 次稽核；缺失 38 項，缺失改善率 100%。</li> <li>• 2024 年辦理員工職業安全衛生訓練課程，總計舉辦 2 場，總受訓人次 233 人，總受訓時數 6 小時(3 小時 / 場)。</li> <li>• 廠區迄今未發生任何職業病案例。</li> <li>• 2024 年職災案件計 2 件 (交通意外事故 1 件、工作意外 1 件)，影響職業災害人數為 2 人。</li> <li>• 參與員工健康檢查服務的員工共計 381 人次，投入員工健康健康檢查金額達新臺幣 2 萬元；主管補助共計 14 人次，健康檢查金額 36.5 萬元。</li> <li>• 2024 承攬商職安衛教育訓練總計舉行 6 場，共有承攬商計 133 人受訓、受訓時數達 5 小時 / 場。</li> <li>• 廠區自 106 年 7 月 1 日起已完成 AED 自動體外心臟除顫器裝設，並委請廠商每年到廠實施 AED 操作教學訓練。</li> <li>• 兩廠每月四次委請專業護理師駐廠實施 2 小時 / 次衛教輔導。</li> </ul>

## ■ 職業安全衛生管理系統

志聖依循 ISO45001：2018 職業安全衛生管理系統，訂有《環安衛管理手冊》、《環境作業管制程序書》與《職安衛自動檢查管理程序書》等作業辦法，適用範圍涵蓋台灣各廠區（台北廠區、台中廠區）之所有工作者（員工、承攬商與訪客），整體場域覆蓋率 100%。而為評估管理系統的有效性，志聖依據 ISO 45001 每年定期對各廠區進行內部稽核，2024 年已對各生產基地進行各一次的職業安全衛生外部稽核，並已取得 ISO45001：2018 第三方認證。志聖建立環安衛管理系統各項要求事項，以有效管理其對環安衛上造成之任何負面衝擊或不符合規定事項，並對整體環安衛績效進行

持續改善。目前，公司所取得的 ISO 14001 與 ISO 45001 證書有效期限為 2023 年 12 月 23 日至 2026 年 12 月 22 日。

在未來三年中，我們將以「零工安事故」為目標，持續強化管理系統，努力提升公司整體安全管理水準，提升員工安全意識，優化工作環境，並與所有合作夥伴共同打造可持續發展的安全與健康職場。

為落實職業健康與安全各項計畫執行與推動，志聖各廠區設立職業安全衛生委員會，並依《職業安全衛生管理辦法法規》規定設置委員七人以上，其三分之一委員為職安衛勞工代表。委員會每三個月定期召開會議，會議主要討論上下班通勤同仁安全議題、封裝作業工作安全、防疫及健康安全等議題。一般員工亦可透過電話、電子郵件，向單位主管、職安衛勞工代表提出建議，以於委員會中進行討論；而相關職安衛法令與規範布達，全體員工可透過廠內海報、部門宣導等方式瞭解安全衛生資訊。

### ■ 職業安全衛生管理系統

為確保全體工作者之安全，志聖訂有《事故通報與調查管理程序書》，藉由完整的調查程序以使災害事故調查更有效率，確認事故發生原因和決定改善對策，藉以降低事故再發生之機率，此規範適用員工、承攬人以及公司、工廠內外所引起之災害事故。如作業同仁於工作場所發現危險情況，可自行停止作業並退避至安全場所，並得向上級呈報以採取適當之應變措施，並得免於遭受處分。

如有志聖之工作者發生職業災害，事故發現者應於災害事故發生後，應對傷患進行緊急救治，並進行災害事故現場處理，隨即通報行政單位，行政單位接獲通報後將隨即通報行政單位主管及廠區最高主管，公司將召集相關人員組成調查小組（需包含勞工代表），共同進行調查，並提出事故調查報告與防止再發生對策提出建議，做成會議紀錄，必要時透過「矯正處理管理程序書」督導事故單位進行改善。

### ● 志聖災害事故調查及矯正流程

事故單位於事故發生起三日內將「事故災害通報及調查表（含虛驚事件）」送至行政單位。

行政單位召集相關人員組成調查小組（需包含勞工代表），共同進行

調查。

事故單位擬定防止再發生對策與執行改善措施送至行政單位，並提出事故調查報告與防止再發生對策提出建議，做成會議紀錄。

若預防再發生處理對策涉及廠內其他單位，行政單位得召集相關單位召開會議，做成會議記錄，並由行政單位追蹤防止再發生處理措施執行進度，必要時透過「環安矯正處理單」督導管理單位進行改善。

事故發生後適當的審查現有職業安全衛生風險及其他風險，必要時予以更新及修正。

單位相關人員應負責追蹤改善措施之執行情況，並記錄查核結果，待改善措施完成後，將環安矯正處理單送交行政單位審核，經行政單位審核通過後，結案歸檔。

行政單位應每季彙整虛驚事件及事故調查分析等結果，於職安委員會會議中提報檢討，做為日後職業安全衛生管理系統持續改善之參考。

各相關單位及發生事故之單位對於事故調查結果得加以宣導或是納入職業安全教育訓練教材之中，以強化員工對於安全的認知。

## ● 災害預防與應變提升

1. 設備新增：自 2023 年起，新增化學物品儲存防爆櫃並配備漏液探測器；2024 年底增購化學品緊急應變桶及消防應變逃生器材，以強化緊急應變能力。
2. 案例宣導：為增強員工風險意識，透過月會分享實際案例，由當事人講解經驗以加深印象。

志聖公司將持續以系統化管理及創新手段，深化環安衛管理成效，致力於打造安全、健康、永續的工作環境，實現零工安事故的目標。

## ● 公安查核及設備安全管理

志聖落實廠區環境監測及相關定期安檢作業，由總經理擔任總召集人，定期執行相關程序：

### 勞工作業環境檢測

為保障勞工免於作業場所中有害物的危害，提供勞工健康舒適的工作環境，每年定期執行作業環境監測，了解現場同仁工作環境態樣。

### **工安查核**

各項查核報告由行政單位依每年規劃查核作業執行，並將改善建議及具體改善情形提供予廠區各單位參考，同時每月根據查核改善事項於例行廠區會議檢討缺失。

### **設備安全管理**

本公司對於危險性機械及設備均有列管，並定期進行詳盡檢查，確保設備能安全操作，無安全疑慮。

項目	頻率
滅火器設備自檢	每月定期檢查
高低壓電氣設備	
客貨梯檢查	
環境品質檢測	每半年
廠區消毒	
緊急應變演練(含消防演習)	
緊急發電機	每年巡檢
天車保養	
電力大檢	
消防設備檢查	

### **■ 職安衛教育訓練**

為確保全體員工瞭解職業安全衛生法規，並熟知公司安全衛生管理機制，志聖依法規及職務需求，提供員工安全衛生教育訓練，包含：一般安全衛生教育訓練、職安衛人員複訓、衛生教育宣導與訓練、防火自衛編組演練、承攬商入場暨安全衛生教育訓練、新進人員職業安全衛生教育訓練。2024年志聖職業安全衛生教育訓練，總受訓時數 7,612 小時。

### **■ 2024 年職安教育訓練一覽**

課程類別	A 受訓時數	B 受訓人次	C 舉行場次	總訓練時數 (A*B*C)
一般安全衛生教育訓練	3	265	2	1590
甲種業務主管	6	3	1	18
衛生教育宣導與訓練	2	147	3	882
防火自衛編組演練	4	191	4	3056
承攬商入場暨安全衛生教育訓練	1.5	123	8	1476
新進人員職業安全衛生教育訓練	3	28	2	168
總計	19.5	757	20	7190

## ■ 職業健康服務與促進活動

志聖致力於打造一個安全舒適的工作環境，全方位照護員工健康、並根據工作者的健康狀況調整工作以適應工作者的能力，志聖持續推動多項健康服務與促進方案，例如：每年至少辦理一次以上的全體員工健康檢查、加碼補助員工健康檢查項目、補助同仁參與地方辦理之運動賽事…等，讓員工身、心、靈都能獲得完善的照護，進而提升員工認同感與向心力，持續為志聖站穩業界領先之地位。

項目	內容說明	2024 年績效
員工健康檢查	志聖重視員工身心健康，安排醫療院所每年進行全體同仁健檢，並加碼補助員工健康檢查項目，以完善的檢查項目讓員工了解自身健康狀況，做好自我照護或及時就醫。	2024 年共 381 人完成健檢，占總員工人數約 100 %。
運動認證推廣活動	為維護同仁健康，志聖特舉辦運動認證推廣「健康生活動起來」活動，活動項目包含「降低體脂肪」、「健康向前走」及「健康跑起來」三階段，致力於養成同仁運動習慣。鼓勵同仁進行建步步數達平均每日 8 千步，藉活動預期達成減重目的，減低三高風險。	2024 年共 80 位同仁參與運動認證推廣活動。
參與運動賽事補助	為提倡企業內良好運動風氣，志聖補助同仁參與地方辦理之運動賽事，如林口竹林山寺祈福路跑活動、台中舒跑盃。	2024 年共補助 60 位同仁參與運動賽事
護理師每月入廠服務	為照護同仁的健康，志聖安排護理師每月入廠 8 小時，提供同仁護理諮詢服務。	2024 年護理師駐廠，兩廠總時數共 192 小時。
醫師每季入廠服務	志聖為照護同仁的健康，醫師每季入廠 2 小時，提供同仁醫療上的專業諮詢服務。	2024 年醫師駐廠，兩廠總時數共 16 小時。
護理健康講座	護理師每季舉辦健康講座鼓勵同仁參加吸收相關知識	2024 年共進行了 3 場護理健康講座。
環境教育研習	外聘講師講述生活與健康，及如何從自我管理中達到健康人生	2024 年共有 26 位同仁參加，課程時數 2 小時。

## ■ 職災（職業傷害與職業病）與火災統計及相關改善措施：

### • 職災統計及改善措施

為了確保職業安全與衛生管理措施的有效性，志聖公司採用了職業傷害和職業病的統計數據作為重要的指標，來評估管理績效和追蹤問題根源。志聖工業 2024 年度發生職業災害人數為 3 位，職業災害比例（註）為 0.7%，未有嚴重的職業災害事故、失能傷害事件或因職業災害死亡之事件發生。針對這些已經辨識出的問題，志聖公司迅速制定了相應的管理措施，這些措施包括加強交通安全和行進過程中的安全宣導，以確保員工在上下班途中和出差過程中的安全。展望未來，志聖公司將持續完善與職業傷病相關的配套措施，並做到定期檢討和動態優化。同時，公司也將加強與員工的溝通，聽取他們的意見和建議，確保每一個人的聲音都能被聽到和尊重。通過這些努力，志聖公司致力於維持一個零職災的安全工作環境，讓每一位員工都能安心工作，健康回家。

註：職業災害比例為可記錄職災人數除以年底總員工數。

### 2024 年職業傷病數據

可記錄職業傷害數 註 1	可記錄職業傷害比率 註 2	嚴重的職業傷害數及比率	職業傷害所造成死亡數及比率	職業病數	失能傷害頻率 (FR) 註 3
3	3.2	0	0	0	0

註 1：2024 年之職業傷害為一件交通事件。

註 2：可記錄職業傷害比率 = 可記錄職業傷害人數  $\times 1,000,000 /$  總經歷工時。

2024 年之總經歷工時為 951,081 小時。

註 3：FR = 失能傷害人數  $\times 1,000,000 /$  總經歷工時。失能傷害的總人次數

計算為：包含死亡、永久全失能、永久部分失能及暫時全失能之總計人次數。2024 年之總經歷工時為 951,081 小時。

### • 事故統計與改善措施

1. 傷害事件：2024 年共發生 3 起失能傷害事件（2 起通勤交通意外、1 起廚房工作意外），總傷害指數為 3.2。
2. 重大事故：全年未發生重大工安事故，但公司將持續透過安全教育與風險評估提升員工自我保護意識。

• **火災統計及改善措施**

當年度火災之件數、死傷人數及死傷人數占員工總人數比率

火災件數	死傷人數	佔員工總人數比率
0	0	0

為達成環境與職業安全衛生（環安衛）績效目標，並符合法規與公司環安衛政策要求，公司建立並推行環安衛管理系統，參考 ISO 14001:2015 環境管理系統與 ISO 45001:2018 職業安全衛生管理系統的架構與原則。

在實際運作中，將此系統與公司既有的減廢、污染預防及預防傷害與疾病風險等措施相結合，整合至整體管理流程中，確保系統的實效性。公司成立環安委員會，由總經理擔任總召集人，各部門主管分組負責，勞安室統籌廠區行政課稽核事宜，並每季於職安委員會檢討改善稽核缺失。

**四、環保支出資訊：**

1. 說明最近年度及截至年報刊印日止公司因污染環境所受損失(包括賠償)，處分之總額，並揭露其未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出(包括未採取因應對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實)：無。
2. 因應對策：本公司製造過程並不會對環境造成污染，估計未來不會有環境污染情形。

**五、勞資關係：**

1. 公司員工福利措施、進修、訓練、退休制度與實施情形及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：
  - (1) 員工福利措施
    - 依據職工福利金條例成立職工福利委員會，提供職工福利金辦理各項福利事項，如：婚喪、年節禮品、生育、住院、重大災害等補助，並舉辦員工旅遊活動。
    - 依規定提撥勞工退休準備金，並成立勞工退休準備金監督委員會，以便管理勞工退休準備金各項事宜。
    - 本公司亦按政府相關法令投保勞工及全民健康保險，更為了員工安全著想，為員工加保團體保險以保障員工，提供員工更多福利。

- 員工現金增資入股及員工紅利制度：
  - a. 入股：本公司辦理現金增資時，依法保留 10% ~ 15% 由員工認股。
  - b. 分紅：依公司章程第三十一條規定辦理。本公司年度如有獲利，應提撥 1%~9% 為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不超過 2.25% 為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。
- 勞保、健保、團保、人身意外保險
- 完善退休制度及退休金提撥
- 職業災害補償及撫卹
- 退職酬勞金
- 員工在職進修補助
- 結婚、生育、喪葬、交通費、行動電話、伙食津貼
- 職災或重大災害補助及貸款
- 國內外團體旅遊
- 節慶活動及致贈慰勞禮品
- 子女獎助學金
- 遠道同仁提供宿舍
- 圖書館及金石堂好書共賞
- 西雅圖咖啡免費品嚐

(2) 進修及教育訓練：

- A. 本公司 113 年度全公司員工實際訓練工時為 12,522 小時，訓練費支出為新台幣 2,815 仟元。
- B. 針對同仁之需求及配合政府法令規定，舉辦新進人員訓練、專業技術訓練、品質管制訓練、員工成長相關訓練及勞工安全衛生等各類教育訓練，提供員工完整的專業技能養成及自我成長。
- C. 本公司為提高人力素質，增進員工工作知識、技能，得依員工本身之條件及工作之需要配合實施下列有關之訓練：

(一) 安全衛生教育及預防災害之訓練。

(二) 職前訓練：新進人員進入本公司必須接受「一般性職前訓練」及該職務之「專業性訓練」。

(三) 在職訓練：依據員工執行職務所須之各項專業職能，規劃一系列訓練課程。

(四) 其他專長訓練。

本公司員工訓練之實施方式如下：

一、內訓部份：集中公司內或其他地點訓練，由內部講師或聘任國內外專業講師講授課程。

二、外訓部份：派送國內外專業訓練機構受訓。

(3) 退休制度與實施情形：

本公司依勞工退休金條例之勞退新制，本公司員工每月按薪資總額提撥 6% 退休金並存入勞保局所設立之員工退休金個人專戶內。

公司員工有下列情形之一者，得自請退休：

1. 在公司工作滿十五年以上（含），且年滿五十五歲以上者。

2. 在公司工作滿十年以上（含），且年滿六十歲者。

3. 在公司工作滿二十五年以上者。

4. 在公司工作滿十五年以上（含），且經勞資雙方協商同意者。

5. 在公司工作年資，併計關係企業『志勝儀器股份有限公司』之服務年資。

退休金制度	舊制	新制
適用法源	勞動基準法	勞工退休金條例
提撥方式	<ul style="list-style-type: none"><li>目前現況：本公司已提足額，目前每年固定申請暫停；</li><li>正常提撥：按員工每月薪資總額 2% 提撥，以本公司名義存入台灣銀行（原中央信託局）之專戶；</li></ul>	依員工投保等級提撥 6% 至勞工保險局個人專戶；
提撥金額	截至累計至當年度提撥金額為 NT\$166,265 仟元	當年度提撥 NT\$18,879 仟元

(4) 勞資間之協議與簽訂團體協約情形：無；本公司雖有成立企業工會，惟因工會迄今未曾向公司提出團體協約之協商要求，爰並未簽訂團體協約。

(5) 形塑友善育兒環境措施：

項目	內容
彈性工作時間	允許員工特案申請彈性上下班工作時間，以更好地配合他們的育兒需求。
家庭支援服務	提供特約托兒所資訊，以幫助員工多方的選擇。
生育獎勵津貼	在特定的年資下，公司提供生育獎勵津貼，用於支付員工的育兒費用。（年資滿 3 年，生第二胎 8 萬、第三胎（含）以上 20 萬。）

- **育嬰假**

為鼓勵並支持員工安心培育下一代，志聖讓員工享有育嬰留職停薪的權利。公司依據勞基法之規定，協助同仁依循《性別工作平等法》及《育嬰留職停薪實施辦法》辦理育嬰留職停薪。2024年，志聖共有4位同仁申請育嬰留職停薪，預計育嬰留停復職4位、實際復職2位，復職率達50%。

志聖重視性別平等，除提供育嬰留停，志聖也為同仁提供產後育嬰之保障。志聖為女性員工設置哺乳室，營造舒適的工作環境，讓志聖同仁在工作同時也能兼顧家庭。

2. 最近年度及截至年報刊印日止公司因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：

本公司勞資關係和諧，並未發生勞資糾紛。本公司對員工之福利非常重視，隨時注重主、客觀環境之變動，訂定各項福利措施，以滿足員工之需求。

## 六、資通安全管理：

### 1. 資安目標及政策

為保障公司資訊資產的安全與確保資訊作業的順暢，本公司設有資訊安全政策。此政策旨在保護公司的數據、資訊、設備、人員及網路等關鍵資訊資產，確保其機密性、完整性和可用性，從而減少營運風險並維護公司的良好商譽。多年來，我們不斷改進內部資訊安全管理機制，並定期進行資訊安全宣導、員工教育訓練，以強化員工對於資訊安全的認識和責任感。

### 2. 資安執行及風險管理

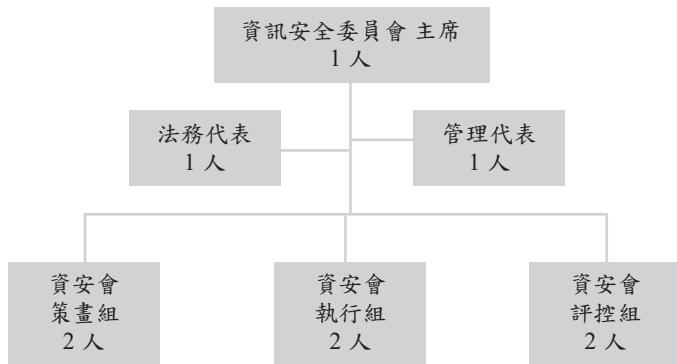
資訊安全管理與執行是透過控管的方法，把資訊風險降低到可控管的程度。因此，為了保障重大機密資料不外流，志聖採用的方式為：執行各單位資訊資產清點、風險評鑑作業，資安權限分級授權管理；內部資訊流通透過資訊部門自建內部伺服器（包含電子郵件、部門機密資料、客戶個資等）搭配定期防毒軟體進行監控；外部資訊流通透過加密軟體保障資料安全性，確保情報不落地。

### 3. 資安檢視及教育訓練

IT部門貫徹執行資安事件通報及協助應變處置，並辦理各單位同仁接受資訊安全訓練。除新進人員入職時進行基本資訊安全相關訓練外，本公司亦有相關資安議題課程，如電子郵件收發須知、加密軟體使用流程、部門機密資料管理等，並與外部專業講師協助員工培訓，提高各單位資安管理

的應變能力。關於資訊部門則有相關系統的配套控管平台，透過系統化工具達到即時性通報，加速突發狀況的處理，確保資訊安全落實並融入日常營運作業。

#### 4. 資訊安全委員會架構



##### 資訊政策管理

訂定公司資安政策

訂定公司資訊管理政策

##### 資訊安全管理

依資安政策：透過各項資安產品對

電腦設備進行規範、限制

##### 協助策劃組評估資安政策可行性並控

管執行組資料紀錄及主管通報的內容  
是否相符

紀錄回報

紀錄回報提供各部處主管、資安委員

主席、總經理

##### 策畫組

##### 執行組

##### 評控組

定期將資訊紀錄提供主管  
如右異常行為通知策畫組、控評  
與主席

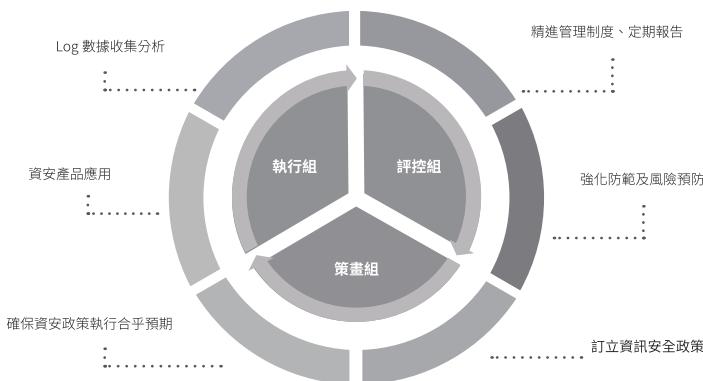
#### 5. 資訊安全宣言

- 本公司致力於加強資訊安全管理，推行「資訊安全，人人有責」的理念。
- 我們確保處理客戶和同仁資料時的機密性、完整性和可用性，以確保資料處理過程的全面安全。
- 提供安全、穩定及高效的資訊服務，以維護志聖工業市場競爭力，及保障客戶與合作伙伴之利益。

## 6. 資訊安全治理流程



## 7. 資安策略



## 8. 資訊安全教育訓練

- 本公司每年均會執行全公司規模的資訊安全社交工程演練以及資訊安全教育訓練。
- 每月公司內部月會上宣導、提供近期資安新聞與資安事件於公司內部入口網站，以加深員工資安意識與對資訊安全的重視，2024年共舉行12次月會資安宣導。
- 每年會執行為期一個月的資訊安全月，2024年11月為志聖資訊安全月，執行內部釣魚信演練、資訊安全宣導及相關試題演練；演練與宣導雙重作用下，能夠減少風險，並隨時隨地保障公司權益。
- 演練與宣導雙重作用下，能夠減少風險，並隨時隨地保障公司權益。

## 9. 資訊安全維護

- 公司電腦佈署資安防護軟體。
- 公司電腦佈署防毒軟體。
- 公司內、外部流量監控軟體。
- 外部郵件過濾機制。
- 網路防火牆機制。
- 資訊系統緊急應變計畫作業不定期演練。
- 2024年志聖工業\_資安健診報告

針對上述資訊安全維護投入項目，列示如下表：

單位：新台幣 / 元

資訊安全維護	投入項目	金額
資安防護軟體	TrustView	\$475 萬
	Sentinel	
防毒軟體	TrendMirco Apex One	
內、外部流量監控軟體	L7 Traffice Controller	
總部機房及相關機制建立	含防火牆及郵件過濾機制	

10. 列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：  
無此情形；

## 七、社會責任：

志聖自 1966 年成立以來，致力於成為世界級的半導體、電路板、平面顯示器、觸摸屏、印刷塗裝等產業設備領導廠商，透過「永續經營委員會」，追求員工、股東、客戶、供應商等關係利益人最大權益，善盡企業公民責任，達到企業永續。

### 員工人權保障

志聖為善盡企業社會責任、保障全體同仁及利害關係人基本人權、杜絕任何侵犯及違反人權的行為，也遵守國內外之勞動、性別平等工作法相關法規並制定有關人權保障、勞動政策及執行相關措施。志聖遵循「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」、「聯合國企業與人權指導原則」、「聯合國國際勞動組織」等國際公認之人權標準訂定工作規則及相關人事管理規章，以保障員工之權益，並依法召開勞資會議，除提供員工多元溝通管道讓員工與管理階層間能夠公開直接進行溝通討論，同時宣導公司政策、福利措施及各項活動，使員工能意見得以充分表達，並適時給予回應和協助。並於不定期新人教育訓練及每月全公司月會進行人權政策宣導。

#### • 2024 年實績

健康安全職場：志聖於 2024 年召開 4 次職業安全衛委員會，檢討和改善員工的健康與安全風險，目標是建設零職災工作環境。

員工自主性社團：尊重員工自由結社，並設立愛心社、羽球社、瑜珈社等

社團，為員工提供多元學習機會。

勞資協商：2024 年，北中廠區共舉行 8 次勞資會議，加強員工與管理層的有效溝通，並宣導公司政策、福利及活動。

多元包容與平等機會：志聖致力於提供性別平等和多元化工作環境，並強調公平僱用、薪酬及升遷機制，加入友善家庭職場企業聯盟，打造友善家職場，將家庭教育帶入職場，以多元議題講座，方便員工在職場就近學習，兼顧員工在工作與家庭的需要，協助員工平衡工作與家庭生活。

不雇用童工：公司 2024 年未僱用童工，並遵守當地法律，反對任何形式的童工雇用。

符合基本薪資與合理工時：2024 年，公司全體員工的薪資均高於勞基法所訂的薪酬標準，並提供合理的工時。

- 2024 年員工數據

員工總數：423 人，其中正職員工占 95%。

性別比例：男性占 76%，女性占 24%。

年齡分布：31 至 50 歲的員工占比 63%，30 歲以下占比 23%，50 歲以上占比 14%。

多元化員工：2024 年，志聖共有 4 位身心障礙員工、1 位原住民員工、7 位外籍員工，平均服務年資為 2 年以上。

## 人才吸引與留任

志聖以維護舒適便利的工作環境及能滿足員工兼顧家庭、工作生活平衡為理念，提供各項福利活動、完善且優於法規的保險制度（包含壽險、傷害及意外保險、醫療保險、職災給付保險等）及育兒服務給予同仁，依據職工福利金條例成立職工福利委員會，為員工制定更周全完善的福利措施，重視每一位志聖的家庭成員。以職工福利金辦理各項福利事項，如：婚喪、年節禮品、生育、住院、重大災害等補助，並舉辦員工旅遊活動。

- 志聖 2024 年度員工福利項目實績

項目	福利內容	2024 年實際 使用人次數	投入金額 (新台幣元)
員工暨子女在學 獎學金補助	員工或子女成績具優良表現者，依學制給予補助 500-2500 元不等之獎學金。	328	364,500
結婚補助	員工本人結婚時可申請(8,000 元)。	4	32,000
生育補助	員工本人或其配偶生育時可申請(每胎 3,600 元，第三胎含以上 7,200 元)	6	32,400
喪葬補助	員工本人、父母、配偶或子女死亡時，可提出申請(本人 3 萬，其他 15,000)	7	105,000
傷病慰問補助	員工本人住院，購 800 元之禮品。	7	5,600
傷殘慰問補助	員工本人因公務而致傷殘者，補助金額 1,000-5,000 元。	0	0
急難救助補助	員工受意外重大損失，補助金額最高 30,000 元	0	0
生日禮券	員工生日給予 1,200 元禮券。	405	486,000
生育獎勵津貼	年資滿 3 年，生第二胎 8 萬、第三胎(含)以上 20 萬。	1	200,000

- 志聖友善育兒措施

為鼓勵並支持員工安心培育下一代，志聖讓員工享有育嬰留職停薪的權利。公司依據勞基法之規定，協助同仁依循《性別工作平等法》及《育嬰留職停薪實施辦法》辦理育嬰留職停薪。

- \* 2024 年，志聖共有 4 位同仁申請育嬰留職停薪，預計育嬰留停復職 4 位、實際復職 2 位，復職率達 50%。
- \* 志聖重視性別平等，除提供育嬰留停，志聖也為同仁提供產後育嬰之保障。
- \* 志聖為女性員工設置哺乳室，營造舒適的工作環境，讓志聖同仁在工作同時也能兼顧家庭。
- \* 彈性工作時間：允許員工特案申請彈性上下班工作時間，以更好地配合他們的育兒需求。
- \* 家庭支援服務：提供特約托兒所資訊，以幫助員工多方的選擇。
- \* 生育獎勵津貼：在特定的年資下，公司提供生育獎勵津貼，用於支付員工的育兒費用。(年資滿 3 年，生第二胎 8 萬、第三胎(含)以上 20 萬。)

## **人才培育與發展**

我們相信人才就是公司最重要的資產，公司致力於打造每一個同仁發揮的舞台，並與同仁本人共同規畫成長的職涯路徑。

- 我們的政策與承諾
  - \* 雙軌晉升制度：提供專業職與管理職雙軌晉升制度，並提供相關培訓與進修補助。
  - \* 訓練經費支持：公司提供專業培訓及發展計畫經費，提升員工專業能力。
  - \* 高階主管進修：公司提供 EMBA 等進修補助，幫助高階主管提升管理視野。
- 我們的目標與績效
  - \* 短中期目標：每年培訓 30% 員工，提升 80% 員工滿意度，每年至少培育 10 位中層管理人才，舉辦至少 2 場大型培訓活動。
  - \* 長期目標：每年至少 50% 員工由內部晉升。
  - \* 2023 年績效：總訓練時數 8064 小時，70% 職位由內部員工晉升。平均訓練時數 17.85 小時，總計 383 名員工參與。
- 2024 年訓練與發展統計
  - \* 訓練時數：男性平均訓練時數 17.85 小時，女性 24.55 小時。三年來訓練時數逐年增加。
  - \* 主要培訓項目：新人訓練、主管培訓、專案管理及壓力紓解課程等。

## **社會參與**

志聖多年來秉持著「取之社會，用之社會」飲水思源的感恩心，定期回饋社會團體及學界，贊助的團體包括了罕見疾病基金會、家扶中心、向上基金會、人安基金會、樂山教養院、八里愛心教養院等，也參與慈善機構後援會；除了弱勢捐助之外，在疫情嚴峻的 2021 年，我們亦加入防疫團隊，與友好鄰居樂榮貿易共同捐贈護帽及鞋套共 30,000 套、護目鏡 6,000 支、護目面罩 5,000 個到台北市政府警察局，協助警消單位；提供台灣癌症基金會防疫隔離衣 200 件、認捐台北醫學大學附設醫院架設檢測站，並與 SEMI（國際半導體產業協會）、台積電慈善基金會合作，參與零接觸採檢站募資計畫，在產官學各界盡已所能。

對產業人才培育我們也不遺餘力，多年來持續與台灣大學、清華大學、逢甲大學、明志科大、中興大學等大學合作，包含「建教與實習合作」、「學術研究合作」、「獎助學金」以及「校園巡迴講座」四大面向，以培育產業優秀

人才為己任，同時公司高階主管擔任各大學講師，發揮業師精神，傳承產業經驗，縮小學用落差。

我們關心品格教育，贊助桃園中平國小棒球隊，把關運動少年的學習環境與資源，鼓勵台灣青年邁向國際，孕育未來國際賽場上的明日之星；此外，企業內部亦以行動支持文藝活動，推廣志工文化，提供公司全體同仁參與社會公益活動各項資訊與管道，培養同仁感恩、互助的優質企業文化。

2024 年我們的投入實績：

- 持續參與 ESG 世界公民數位治理基金會，以「普世善念共傳吟 世界公民共齊行」為精神，推動世界公民理念、學童素養教育，加強台灣人對世界公民的認同感，進而達到各國共好、世界共好。
- 捐贈溪水旁關懷單親家庭協會，安慰單親受傷的心靈、幫助他們面對困難、適應新的生活、重建自尊自信。同時關心暨扶持單親者及其子女，協助建立健康的家庭生活，讓他們遇到家庭變故，不致於失去倚靠。
- 捐助夢想之家教育基金會，共營「給孩子家一般的溫暖，幫助他找到夢想和人生方向。」的初衷，投入都會區弱勢青少年課業輔導。
- 回饋台灣癌症臨床研究發展基金會，支持該基金會落實癌症防治生活化、在地化，以降低癌症的發生率；並提供最便捷的癌病醫療與諮詢服務。
- 贊助台灣電路板協會 (TPCA) 舉辦之減碳綠活益起行活動，推動環境公益及健康普及活動。
- 捐助電路板環境公益基金會 (TPCF) 日本考察參訪 2024 SDGs Week EXPO，了解下一代環境技術、產品、服務、企業社會責任活動、環境保護活動、環境政策以及產學官合作的最新趨勢。
- 贊助中華民國力學學會年會暨第 48 屆全國力學會議與第 3 屆國際力學會議 (CTAM 2024)，促進學術界和產業界的交流合作。
- 捐助清大 DIT 團隊，支持在地學子參加歐洲機器人大賽，並與其合辦「G2C+ 聯盟 x 清華大學機器人夢想體驗營」，使學生與企業員工子女教學相長，創造科普教育價值。
- 捐助台灣大學工學院學術勵進獎，以鼓勵學院現職專任教師精進學術生涯成就。
- 捐助台灣大學工學院研究生院長獎，表揚院內師生致力投入研究，產出優秀研發成果，且能縮短學校與企業界人才需求的距離，有助學生銜接職場就業。

- 回饋 100 萬元 / 年，共計 5 年，協助台大化工系老舊系館修復，讓舊屋再生，繼續服務校園學子。
- 志聖與逢甲大學簽立團隊創新激勵方案，自 2022 年起，以 5 年 5 百萬元的發展基金協助逢甲進行碳中和調查及節能裝置開發等研究，從學校開始建構團隊，透過多樣的創新活動落實產業人才的培養，成為淨零排放的力量。
- 舉辦志聖 x 逢甲盃運動賽事，包含捐助活動費用、競賽獎金，提供校園學子與業界人士維繫健康習慣的舞台。
- 捐贈中平國小棒球隊接駁車，使品格棒球精神不滅，讓下一代學子能赴各項賽事，實現運動夢想。
- 與愛無國界關懷協會攜手認養西非霖恩國小 6 名學童，每年捐贈援助金 36,000 元。

## 國內文化發展

本公司積極參與文化創意產業的佈局，大力支持國內藝文組織舉辦之表演與活動，體認任何主要由人類組成的社會，都需要修養，經由品格的陶冶、心態的淨化、知見的正確，即可免於各自或群體的物化或沈淪，進而開通各自或群體的正向出路與素養提昇。

- 支持國內藝文組織活動

《勸世三姊妹》由躍演劇團創作，在台灣受到市場及專業人士的肯定，讓世界看見台灣的文化樣貌，更為國內音樂劇環境貢獻一份心力。為此 2024 年本公司捐助新台幣 3,000,000 元，期能透過音樂劇媒介，呈現「什麼是台灣」，讓文化輸出突破國界限制，更讓台灣在地藝文組織獲得肯定和資源，充分將國內文化發揚光大。

中華音樂人交流協會，成立於 1996 年 5 月 4 日，是一個由台灣音樂工作者成立的民間組織。本公司共鳴於該協會長期鼓勵流行音樂界的優秀作品，積極贊助其預計於 2025 年 02 月 14 日至 16 日，台北小巨蛋舉辦的《民歌五十演唱會》，共計新台幣 500,000 元。從文化與歷史的角度，民歌創作風氣帶動了後續整個華語流行樂壇百花齊放的年代，希望能透過支持國內藝文組織活動，善盡企業社會責任，傳承文化瑰寶。

- 鼓勵閱讀 提升社會文化內涵

為鼓勵閱讀風氣，支持文藝出版，本公司致力於大量認購書籍及捐贈，同時，本公司有感於傳統文化「生命的學問」推行不易，與德簡書院文教基金會共同合作，認購捐贈《中道今來》十六套，合計新台幣 127,000 元。

《WAVES 生活潮藝文誌》以為文化的遞延盡一點棉薄之力、堅持媒體的社會責任、重新整頓被忽略的媒體良心、定義全新的時代價值、延續傳統的固有美德與信念等創刊，本公司購入《生活潮藝文誌春季號 /2024》50 本致贈扶輪社社友，共同推廣針對胸懷世界的宏觀目標文青們編纂的讀物，合計新台幣 11,200 元。

- 支持文化藝術創作者

臺靜農先生任教於臺灣大學中文系，自三十七年八月起掌理系務長達二十年，中文系規模聲名，為之宏著，本公司特購入臺靜農先生・百廿誕辰紀念專輯增訂版 10 本，合計新台幣 26,650 元。

本公司支持在地創作者林中斌出版之《劍與花的歲月（增修版）林中斌凡塵隨筆》，捐贈於扶輪社例會，合計新台幣 20,280 元。

本公司支持時尚攝影圈名聞遐邇的知名攝影師張智銘，其進入宜蘭神木山區，在這片全亞洲最大的神木區裡進行拍攝，本公司冠名贊助神境攝影集新台幣 95,238 元，讓世界看見台灣山林的美好。

## 八、重要契約：無。

## 伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險管理

### 一、財務狀況比較分析

項目	年度	113 年度	112 年度	差異	
				金額	%
流動資產		6,251,277	4,746,933	1,504,344	32
不動產、廠房及設備		1,059,732	776,634	283,098	36
其他資產		3,461,485	2,480,661	980,824	40
資產總額		10,772,494	8,004,228	2,768,266	35
流動負債		3,145,172	2,950,489	194,683	7
長期負債		2,376,534	1,639,160	737,374	45
負債總額		5,521,706	4,589,649	932,057	20
股 本		1,567,553	1,567,553	-	-
資本公積		408,334	274,026	134,308	49
保留盈餘		1,587,739	1,312,925	274,814	21
其他權益		1,818,107	360,209	1,457,898	405
庫藏股		(524,329)	(425,511)	(98,818)	23
股東權益總額		5,250,788	3,414,579	1,836,209	54

最近二年度增減比例變動分析說明：

1. 流動資產增加：係現金及約當現金、透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動及存貨增加所致。
2. 其他資產增加：係採用權益法之投資增加所致。
3. 不動產、廠房及設備增加：係購置不動產、廠房及設備所致。
4. 長期負債增加：係長期借款增加所致。
5. 資本公積增加：係庫藏股票交易所致。
6. 保留盈餘增加：係本期淨利轉入所致。
7. 其他權益增加：係因透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益增加所致。
8. 庫藏股增加：係本期新增買回本公司股份所致。

### 二、經營結果分析

#### (一) 經營結果比較分析表

單位：新台幣仟元

項目	年度	113 年度	112 年度	增(減)金額	變動比例%
營業收入淨額		4,818,209	3,625,801	1,192,408	33
營業成本		(2,835,109)	(2,119,643)	(715,466)	34
營業費用		(1,347,104)	(1,103,502)	(243,602)	22
營業利益		635,996	402,656	233,340	58
營業外收支		343,568	181,376	162,192	89
稅前淨利		979,564	584,032	395,532	68
所得稅費用		(222,989)	(53,911)	(169,078)	314
本期淨利		756,575	530,121	226,454	43

最近二年度增減比例變動分析說明：

1. 營業外收支增加：係因透過損益按公允價值衡量之金融資產利益、處分投資利益、外幣兌換利益增加所致。
2. 其餘各項增加：係因 113 年度營業收入增加致營業利益、稅前淨利、所得稅費用及稅後淨利均增加。

## (二) 經營結果比較分析表

本公司在我們的核心關鍵技術下，擴大產品組合，並考量各事業處規劃及過去經營績效為依據，訂定年度銷售目標。

## (三) 對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

本公司將視未來產業變動狀況，加強產品組合，擴大市場佔有率，提升公司獲利，未來業務應可持續成長，財務狀況亦良好。

## 三、現金流量

現金流量之檢討與分析表

現金流量分析

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額(1)	全年來自營業 活動淨現金流 量(2)	全年來自投資 及籌資活動淨 現金流量(3)	現金剩餘數額 (1)+(2)+(3)	預計現金不足額之 補救措施	
				投資計畫	融資計畫
1,432,549	873,953	(375,799)	1,930,703	—	—

### (一) 113 年度現金流量變動情形分析：

本公司 113 年度較 112 年度現金淨增加 498,154 仟元，各項營運活動現金流量變動情形如下：

- (1) 營業活動淨流入減少 114,135 仟元
- (2) 投資活動淨流出增加 20,207 仟元
- (3) 筹資活動淨流出減少 472,735 仟元

### (二) 最近二年度現金流量之流動性分析

項目	年度	113 年度	112 年度	增(減)比例
現金流量比率		27.79%	33.49%	(17.03)%
現金流量允當比率		115.48%	125.95%	(8.31)%
現金再投資比率		5.36%	7.94%	(32.52)%

增減比例變動分析說明：

1. 增減比例變動情形分析說明：主係 113 年營運活動之淨現金流入減少所致。
2. 流動性不足之改善計畫：不適用。

### (三) 未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額(1)	預計全年來自 營業活動淨現 金流量(2)	全年來自投資 及籌資活動淨 現金流量(3)	預計現金剩餘 數額 (1)+(2)+(3)	預計現金不足額之 補救措施	
				投資計畫	融資計畫
1,930,703	484,500	(460,186)	1,955,017	—	—

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無此情形，不適用。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計劃

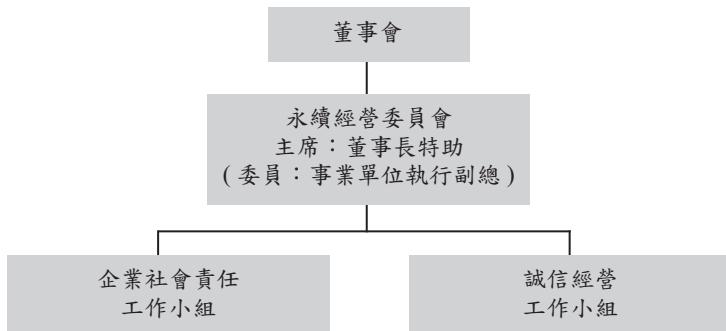
項目說明	本期損益金額(註)	政策	獲利或虧損之主要原因	改善計劃	未來其他投資計劃
C SUN (B.V.I.)	新台幣 238,806 仟元	深耕大陸市場及建立策略聯盟關係。	主要係來自於志聖子公司 -志聖科技(廣州)有限公司 -蘇州創峰光電科技有限公司	無	視投資標的公司之資金需求而定

註：以上係本年度投資金額超過實收資本額百分之五者。

## 六、風險管理及評估

### (一) 風險管理之組織架構：

為提升企業社會責任及使公司永續經營發產，本公司於 106 年成立企業永續委員會，負責推動企業社會責任、公司治理及誠信經營相關事宜，每年向董事會報告執行情形及結果。本公司永續委員會組織圖如下：



### (二) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

#### 1. 利率變動：

本公司定期評估銀行借款利率，並與銀行密切聯繫以取得較優惠的借款利率。

項目	113 年度金額(仟元)	佔 113 年度營收比重(%)
利息支出	52,208	1.08%

2. 匯率變動：

本公司的因應措施為，採用先預估未來現金流量，然後針對淨部位做出預售／購遠匯或直接於現貨市場出脫／買進外幣以避險為主。

3. 通貨膨脹：

本公司並無因受通貨膨脹而有重大影響之情形，且本公司對客戶及供應商之報價，以市場之機動調整者居多，故對本公司損益影響有限。本公司隨時注意市場價格之波動，目前尚未因通貨膨脹而產生立即重大影響。

(三) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

1. 本公司各項投資皆經謹慎評估，並且依據「取得或處分資產處理程序」暨核決權限規定辦理，並無從事高風險、高槓桿投資事宜。本公司今年度並無從事高風險、高槓桿投資且各項投資案皆需經審慎評估後送至董事會表決通過。
2. 在資金貸與及背書保證方面，對象以本公司之子、孫公司為對象，並且依據本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證辦法」規定辦理。
3. 從事衍生性商品交易皆依本公司「從事衍生性商品交易處理程序」之規定處理。本公司買賣遠期外匯合約係為規避外幣債權債務之匯率變動風險，並未從事投資性目的之衍生性商品。

(四) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

有關研發情形詳本年報肆、營運概況一、業務內容 3. 技術及研發概況之內容，本公司預計 114 年度之研發費用計 NT\$303,907 仟元，影響未來研發成功之主要因素為研發團隊能力與對市場資訊之掌握度，因本公司設有技術委員會，負責統籌公司未來產品的研發策略且近年來亦不斷提昇研發人力之素質，故對未來產業變化之新產品開發會持續不斷發展。

(五) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

因應主管機關針對公司治理、公司法、證交法等重要政策及相關法律之修訂，本公司均配合之；此外，本公司管理階層隨時觀察注意國內外重要政策及法律變動，並適時主動提出因應措施，故對本公司財務業務尚無重大影響。

(六) 科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

近年來本公司除積極參與經濟部等科專研究計畫，致力發展高階技術之研發及創新並隨時掌握產業發展方向，故目前對公司及業務並無重大影響。

(七) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司一向堅持誠實經營原則及社會責任之參與，多年來皆保持良好的企業形象和風險控管，目前並無可預見之危機可能性。

目前志聖工業在台灣證券交易所上市，同時受到主管機關監督、恪守法令，因此企業形象良好。

(八) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：截至年報刊印日止本公司並無任何併購計畫。

(九) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

為因應未來產業發展，本公司已於華東區購土地、建廠替代長期租用的廠房，對於資金需求及運用已做好計畫及控制，評估應無太大風險存在。

(十) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司銷售產業範圍擴及電子、半導體、LCD、PCB、印刷塗裝等產業，本公司除持續耕耘舊客戶外，並積極拓展新客戶。

(十一) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：

截至年報刊印日止，本公司無此情形。

(十二) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

截至目前為止，公司經營權並無發生重大改變。

(十三) 訴訟或非訟事件處理情形：截至年報刊印日止，本公司無此情形。

(十四) 資安風險評估分析及其因應措施等重要風險評估之事項：

請參閱本年報肆、營運概況六、資通安全管理之內容；

(十五) 其他重要風險及因應措施：：截至年報刊印日止，本公司無此情形。

七、其他重要事項：截至年報刊印日止，本公司無此情形。

## 陸、特別記載事項

- 一、關係企業相關資料：請詳見公開資訊觀測站—『關係企業三書表專區』；
- 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。
- 三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形：無。
- 四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響事項：無。
- 五、其他必要補充說明事項：無。

1

## 主動積極

主動創造打破障礙與限制

2

## 以終為始

確立目標、建立使命宣言，克服困難徹底執行

3

## 要事第一

訂定優先次序，在關鍵任務與瑣碎事務中追求平衡

## 雙贏思維

他人知得，不必爲自己之失，大家都 可以是贏家

4

## 知彼解己

傾聽並給予有效回應有效溝通，做個雙向傳播的聆聽者

5

## 統合綜效

尊重差異，藉由不同觀點共創最佳解決方法

6

## 不斷更新

不斷學習、持續進步，身心平衡發展

7

志聖工業股份有限公司



負責人：梁 茂 生



## 經營理念- 皆大歡喜 All Win 宣言

1. 志聖關鍵創新產品、服務與 Total Solution 能使顧客滿意，成為致勝關鍵。
2. 志聖的工作伙伴能彼此學習與學研機構往來，深化核心能力，形成高效能團體。
3. 志聖不斷精進經營與誠信治理，使投資大眾與集團同仁分享利益。
4. 與供應商共同提昇，與志聖形成有競爭力的伙伴關係。
5. 我們身體力行，不斷造福員工家庭、社區與整個社會。
6. 與同業形成良性競合關係，系統整合，提昇產業整體競爭力。

新北市林口區工二工業區工八路2-1號  
TEL: (02) 2601-7706 FAX: (02) 2601-8854

**c sun志聖**